

力成科技股份有限公司

中華民國113年度年報

2024 ANNUAL REPORT



Powertech
TECHNOLOGY

刊印日期：中華民國114年4月22日

本年報查詢網址：

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

本公司網站：<https://www.pti.com.tw>

一、公司發言人及代理發言人

發 言 人

姓 名：沈俊宏

職 稱：財務長暨副總經理

電 話：(03) 5980300

電子郵件信箱：huckshen@pti.com.tw

代理發言人

姓 名：林宥翰

職 稱：人力資源暨法務副總經理

電 話：(03) 5980300

電子郵件信箱：yohan@pti.com.tw

二、總公司、分公司、工廠之地址及電話

總 公 司地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 10 號

電 話：(03) 5980300

第一廠區地址：新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段 879 號

第二廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區三民路 7 號、7-1 號

第三廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 10、15、26 號

第九廠區地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 4 號

竹科分公司地址：新竹市新竹科學園區力行三路 15 號

竹科二廠地址：新竹市新竹科學園區力行四路 9 號

竹科三廠地址：新竹市新竹科學園區力行四路 29 號

三、股票過戶機構

名 稱：康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

地 址：台北市信義區基隆路一段 176 號 B1

網 址：<https://www.concords.com.tw>

電 話：(02) 8787-1118

四、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林政治、方蘇立會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

地 址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

網 址：<https://www2.deloitte.com>

電 話：(02) 2725-9988

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢方式：不適用。

六、公司網址：<https://www.pti.com.tw>

目 錄

壹、致股東報告書	1
營業報告書	3
貳、公司治理報告	7
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金.....	14
三、公司治理運作情形.....	19
四、簽證會計師公費資訊.....	61
伍、更換會計師資訊.....	62
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職 於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊.....	62
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股 東股權移轉及股權質押變動情形.....	63
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊.....	64
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業 之持股數資訊.....	65
參、募資情形	66
一、資本及股份.....	66
二、公司債辦理情形.....	68
三、特別股辦理情形.....	68
四、海外存託憑證辦理情形.....	68
五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形.....	68
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	68
七、資金運用計畫執行情形.....	68
肆、營運概況	69
一、業務內容.....	69
二、市場及產銷概況.....	76
三、從業員工資訊.....	81

四、環保支出資訊.....	82
五、勞資關係.....	82
六、資通安全管理.....	86
七、重要契約.....	89
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項	90
一、財務狀況.....	90
二、財務績效.....	91
三、現金流量.....	91
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	92
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	92
六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估.....	93
七、其他重要事項.....	95
陸、特別記載事項	96
一、關係企業相關資料.....	96
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	96
三、其他必要補充說明.....	96
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項.....	96

壹、致股東報告書

於民國 114 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

【前一年度營業結果】

經歷 2023 年半導體產業需求大幅衰退後，儘管出售中國大陸西安廠予美光公司已於 2024 年 7 月 1 日生效，我們 2024 年度的營業額仍穩健成長至新台幣 733 億元，每股盈餘（EPS）達到 9.09 元。

【受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響】

回顧 2024 年，在客戶持續進行庫存調整的壓力下，除了與人工智慧（AI）相關的產品供應鏈外，整體半導體產業的復甦態勢仍不明朗，預計此情況可能延續至 2025 年上半年。

美國政府於 2025 年 4 月 2 日宣布對世界各國徵收對等關稅，為全球經濟的未來走向增添了極大的不確定性，原先產業界對今年下半年經濟回溫的期盼頓時充滿變數。這項關稅政策對全球貿易及經濟發展造成的影響範圍廣泛且複雜，目前難以精確估計。面對如此動盪的全球經貿環境，我仍將聚焦於公司內部發展，向各位股東報告力成科技在先進封測技術開發上的進程。

由於 NVIDIA 及台積電在 AI 市場的領先地位，我們擴建先進 2.5D/3D 封裝解決方案所需的精密設備，也面臨設備商交貨延遲的挑戰。此外，為配合新客戶客製化及更具競爭力 AI 解決方案的需求，我們在先進技術的開發過程中遭遇了一些困難。然而，在我們工程團隊的努力下，這些挑戰與困難已逐一克服並取得進展。

【本年度營業計畫概要】及【未來公司發展策略】

目前，我們的工作重點在於提升生產良率、縮短開發時程，以及提供客戶更具成本效益的解決方案。我們將力成科技的願景重新定位為「成為系統應用、模組及 IC 元件先進封裝技術解決方案的最佳供應商」，而達成此目標的關鍵，在於員工的投入、供應商的合作，以及策略客戶的支持。

1. 應用矽穿孔(Through Silicon Via, TSV)連接技術：

- ◆ 後通孔 (Via-last)技術：我們已成功應用於影像感測器 (CIS CSP)、醫療及穿戴式裝置。
- ◆ 中通孔 (Via-middle)技術：我們完成部署後段矽穿孔露出 (Via-reveal) 技術，Via-reveal CMP 設備已完成安裝並試產，可用於高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory, HBM) 晶圓及矽中介層 (Si Interposer)。

2. HBM 製造：

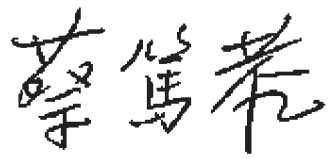
- ◆ 我們量產設備已建置完成，晶粒黏著 (die attachment) 及連接技術已成功突破。
- ◆ 目前正致力於提升良率，我們是唯一具備 HBM 封裝能力的委外封裝測試廠商 (OSAT)。

3. 2.5D 及 3D 封裝技術：

- ◆ 除現有的面板級扇出型封裝 (FOPLP) 能力外，為因應業界對 12 吋晶圓矽中介層的需求，我們加速開發 Chip-on-Wafer (CoW) 製程能力，目前已具備 CoW 及 Chip-on-Panel (CoP) 解決方案。

我很開心的向各位股東報告，我們已準備好先進封裝技術，迎接新一波的成長機會。

感謝各位股東對力成科技一直以來的信任與支持。

董事長： 
蔡篤恭

力成科技股份有限公司

民國一一三年度營業報告書

一、113 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(IMF, International Monetary Fund) 114 年 1 月發布之「114 年世界經濟形勢與展望」報告指出，113 年全球經濟成長率為 3.2%，114 年和 115 年將保持穩定，預計維持在 3.3%，低於 3.7% 的歷史平均水準(89-108 年)。113 年全球平均通膨率為 5.8%，IMF 預測 114 年將降到 4.2%，115 年為 3.5%，與新興市場和發展中經濟體相比，預期已發展經濟體的通膨率將更快回歸到目標水準。

目前全球已經普遍進入降息周期，隨著美國前總統川普回歸，美國內外政策將迎來又一次重大轉向，地緣衝突熱點又不斷，全球經濟與政治不確定性與不穩定性加劇。儘管全球通膨正在緩解、世界經濟並未進入衰退，但下行風險顯著上升，未來可能陷入低成長、高債務的困境。

根據資訊科技研究及顧問機構顧能(Gartner)報告指出，由於市場對生成式 AI 及高效能運算的強勁需求，推動 113 年全球半導體市場收入成長近 18.1%，達 6,260 億美元，成為僅次於智慧型手機的第二大市場；並預測 114 年全球半導體市場收入將達到 7,050 億美元。在台灣半導體產業表現方面，根據工研院產科國際所 113 年 10 月報告：估計 113 年台灣 IC 產業產值達新台幣 5 兆 3,001 億元，年成長率達 22%，其中 IC 封裝業產值為新台幣 4,270 億元，較 112 年成長 8.6%，IC 測試業產值為新台幣 2,005 億元，較 112 年成長 5.2%。

面對 113 年全球政經局勢動盪不安，力成受惠於伺服器、車用電子、高速運算及人工智慧(AI)等客戶端的需求持續成長之下，今年整體獲利及營收仍較去年小幅成長。未來仍將維持在技術研發的優勢，積極擴張 HBM 產能，以因應未來客戶及市場需求，推動公司達到永續經營的目標。

茲將本公司 113 年度的營運成果報告如下：

(一) 113 年度營業實施情形

本公司 113 年度合併營收為新台幣 733 億 1 仟 5 佰萬元，較 112 年度的新台幣 704 億 4 仟 1 佰萬元增加約 4.08%；在盈餘方面，113 年度合併稅後純益中歸屬於母公司股東的金額為新台幣 67 億 8 仟 8 佰萬元，較 112 年度之淨利新台幣 80 億零 9 佰萬元減少約 15.25%。

(二) 預算執行情形：本公司並未公布財務預測。

(三) 財務收支情形

113 年度合併現金流量狀況：(單位：新台幣)

1.營業活動之現金淨流入	21,565,826 仟元
2.投資活動之現金淨流出	9,864,644 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
3.籌資活動之現金淨流出	11,351,315 仟元
主要係償還銀行借款	

(四) 獲利能力分析

分析項目 \ 年度		113 年度	112 年度
獲利能力	營業利益 / 實收資本比率	123.59%	107.40%
	稅前純益 / 實收資本比率	140.65%	158.64%
	資產報酬率	7.90%	8.49%
	股東權益報酬率	12.07%	14.04%
	純益率	9.26%	11.37%
	每股純益	9.09 元	10.72 元

(五) 研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新，113 年度研究及發展費用約為新台幣 28.09 億元，約占全年合併營收的 3.83%。在現有的記憶體及邏輯產品封測技術的基礎下，積極開發先進封測及異質產品整合技術，包含銅柱凸塊(CPB, Copper Pillar Bump)、晶片級覆晶封裝(FCCSP, Flip Chip CSP)、大尺寸多晶片覆晶封裝(Large MCM FCBGA)、小晶片覆晶封裝(Chiplet FCBGA)、系統/模組級封裝(SiP/SiM)、內嵌天線封裝/天線模組(Antenna in Package / Antenna in Module, AiP/AiM)、高頻寬封裝堆疊(HBPOP, High Band Package on Package)、內嵌散熱片晶片級覆晶封裝(Embedded Heat Sink FCCSP)、晶圓級封裝(WLP, Wafer Level Package)、CMOS 影像感測器(CIS CSP, CMOS Image Sensor Chip Scale Package)、2.5D/3D TSV 及扇外型晶圓級/面板級封裝(FOPLP, Fan-Out Wafer/Panel Level Package)等封裝技術，為客戶提供全方位的解決方案。藉由 5G 天線封裝(AiP, 5G Antenna in Package)技術及 5G 射頻(5G RF)實驗室，能提供客戶 5G 天線封裝產品之效能驗證；在 CMOS 影像感測器(CIS)方面，則運用矽穿孔(TSV)連接技術，提升影像顯示之讀取速度，積極發展其應用於醫療、監控及車用的晶圓級晶片尺寸封裝；在高頻寬記憶體(HBM, High Bandwidth Memory)產品方面，也運用矽穿孔(TSV)之連接技術，提升記憶體產品之頻寬與速度，應用於高效能運算(HPC, High Performance Computing)產品與雲端伺服器；扇外型晶圓級/面板級封裝(FOWLP/FOPLP)方面，更因應後摩爾定律時代在晶片微縮化(Chip Scaling)製程上所面臨的困難，積極密切的與客戶進行相關產品的開發及驗證。

二、114 年度營業計劃概要

(一)經營方針

- 1.重承諾(Promise)、創新技術(Technology)及提供整合(Integration)服務為公司的核心價值。
- 2.專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。
- 3.致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。
- 4.以穩定的品質及精湛的技術提供客戶全方位的服務。
- 5.整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
- 6.培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

(二)預期銷售數量

依據世界半導體貿易統計(WSTS, The World Semiconductor Trade Statistics)於114年1月發布的114年半導體銷售預測，114年全球半導體市場將年成長11.2%，銷售額達創紀錄的6,971.8億美元。就產品類別而言，作為電子裝置大腦的邏輯晶片預期將增加16.8%，達2,437.8億美元；記憶體晶片將成長13.4%，達1,894.1億美元。WSTS 預期，114年全球晶片市場以美洲地區成長最快，將增加15.4%，達2,153.1億美元；其次是亞太地區，成長10.4%，達3,762.7億美元。

展望114年，隨著各類型新興應用持續發展，包含AI人工智慧、電動車與自駕車、資料中心、低軌道衛星、電子醫療、家用電子產品，及各式行動裝置的創新功能推陳出新，半導體將持續帶領ICT產業往前成長。

需要持續留意的是，全球供應鏈重組趨勢，朝向區域化，短鏈化發展，全球貿易前景不確定性依然高漲。此外，地緣政治隱憂，區域戰爭依然戰火頻仍，衝擊能源供應，影響產業民生。儘管主要歐美國家通膨壓力略有降溫，惟仍偏高，牽動經濟與金融情勢。中國大陸，經濟持續停滯，通貨緊縮問題日益惡化，影響全球經濟復甦，同樣需要進一步密切觀察。

預估114年各式產品的生產量，邏輯晶片封測將持續成長，記憶體晶片封測則穩健中見到回升的契機，114年各類產品的生產數量預測如下表。

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 126 億顆
測試	約 68 億顆
晶圓級封裝	約 88 萬片
晶圓測試	約 193 萬片
固態硬碟(SSD)+ 薄型固態硬碟系統整合封裝(SiP)	約 1.32 億顆

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)的客戶服務以縮短產品交期及降低運送成本。
- 2.維持記憶體產品封裝及測試服務的產業龍頭地位。
- 3.持續拓展邏輯產品(Logic)業務，並積極拓展覆晶封裝(FC, Flip Chip)、固態硬碟(SSD)、晶圓級封裝(WLP, Wafer Level Package)、晶圓級測試(CP, Chip Probing)、矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝(TSV CIS)、以矽穿孔為導通技術的多晶片記憶體堆疊(3D-IC memory stacking)、系統級封裝(SiP, System in Package)及扇外型封裝(Fan-Out Package)的業務成長。
- 4.進一步維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於產品的產品成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司整體的競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：



貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事資料

董事資料(一)

114年3月29日

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別 年齡	選(純)任 日期	任期	初次選 任日期	還任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女 現在持有股份		利用他人名義 持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主 管、董事或監察人			備註 (註2)
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	蔡篤恭	男性 71~80 歲	112.05.31	三年	88.06.23	4,400,000	0.58%	3,360,000	0.44%	0	0.00%	0	0.00%	台北工專工業工程科 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	本公司董事長 起豐電子(股)公司法人董事代表人 Powertech Holding (B.V.) Inc.董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe, Inc.取締役 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 財團法人力成科技教育基金會董事長	-	-	-	-
董事	中華民國	呂肇祥	男性 61~70 歲	112.05.31	三年	109.05.28	62,356	0.01%	62,356	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	達成大學機械系學士 力晶半導體封裝生產副處長	本公司總經理 元成科技(蘇州)有限公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事長 起豐電子(股)公司法人董事代表人 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.董事	-	-	-	-
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口繁男 (Shigeo Koguchi)	男性 71~80 歲	112.05.31	三年	106.05.26	29,875,000 0	3.94% 0.00%	29,875,000 0	3.94% 0.00%	-	0.00%	-	0.00%	美國佛羅里達大學工程碩士 日本北海道大學工程碩士 Toshiba Corp. 資深執行副總經理 Toshiba Corp. 董事、資深顧問	無	-	-	-	-
董事	美國	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	女性 51~60 歲	112.05.31	三年	106.05.26	29,875,000 22,000	3.94% 0.00%	29,875,000 15,000	3.94% 0.00%	-	0.00%	-	0.00%	政治大學會計系學士 遠東金士頓科技(股)公司財務長	遠東金士頓科技(股)公司財務長 金士頓電子(股)公司監察人	-	-	-	-
董事	中華民國	起豐電子(股)公司 代表人：謝永達	男性 61~70 歲	112.05.31	三年	109.5.28	11,800,000 0	1.55% 0.00%	14,748,000 18,000	1.94% 0.00%	-	0.00%	-	0.00%	交通大學高階管理碩士 遠東金士頓科技(股)公司總經理 晶茂精密工業(股)公司副總經理 力成科技(股)公司集團資深副總裁 聚成科技(股)公司總經理 起豐電子(股)公司執行長	本公司執行長 起豐電子(股)公司法人董事代表人暨董事長 晶茂精密工業(股)公司法人董事代表人暨董事長 力成科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc.取締役 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-

董事屬法人股東代表者，其法人股東之主要股東(持有股權比例占前十名之股東)：

114 年 3 月 29 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)	杜紀川 (50%)、孫大衛 (50%)
起豐電子(股)公司	力成科技股份有限公司(42.91%)、臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動 E T F 證券投資信託基金專戶(3.41%)、長庚醫療財團法人(2.31%)、吳素瑜(1.14%)、長華電材股份有限公司(1.06%)、鴻威創業投資股份有限公司(1.02%)、楊秋霞(1.01%)、偉詮電子股份有限公司(0.81%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶(0.72%)、黃麗雲(0.72%)
台灣矽保先進半導體(股)公司	Kioxia Corporation (100%)

上表中法人股東之主要股東為法人者其其主要股東：

114 年 3 月 29 日

法人名稱	法人之主要股東
力成科技(股)公司	群益台灣精選高息 E T F 基金專戶(9.42%)、元大台灣高股息基金專戶(4.79%)、美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(3.94%)、國泰人壽保險股份有限公司(3.88%)、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶(3.65%)、華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶(2.95%)、南山人壽保險股份有限公司(2.44%)、中華郵政股份有限公司(2.04%)、超豐電子股份有限公司(1.94%)、美商 K T C - S U N 公司(1.81%)
長庚醫療財團法人	南亞塑膠工業(股)公司(17.98%)、台灣化學纖維(股)公司(13.84%)、台灣塑膠工業(股)公司(13.28%)、王永在(已歿，11.24%)、王永慶(已歿，7.35%)
長華電材(股)公司	華立企業(股)公司(28.70%)、新欣投資(股)公司(8.29%)、元耀能源科技(股)公司(6.28%)、長華科技(股)公司(5.11%)、富邦人壽保險(股)公司(4.67%)、倍斯捷投資(股)公司(3.15%)、花旗銀行託管新加坡政府基金專戶(2.61%)、易華電子(股)公司(2.09%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶(0.85%)、大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶(0.83%)
鴻威創業投資(股)公司	瑞昱半導體(股)公司(100%)
偉詮電子(股)公司	福豐投資(股)公司(2.69%)、林錫銘(2.48%)、周宜國(1.37%)、大通託管先進星光先進總合國際股票指數(1.17%)、崇佑投資(股)公司(1.08%)、劉建成(1.02%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶(0.95%)、郭幸容(0.71%)、廖伯照(0.61%)、林崇熹(0.58%)
Kioxia Corporation	Kioxia Holdings Corporation (100%)

董事資料(二)

一、董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 3 月 29 日

姓 名	條 件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
蔡篤恭		具有商務及經營策略之工作經驗。 歷任金士頓集團亞太區總經理及遠東金士頓科技(股)公司董事長。 現任本公司董事長暨策略長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	2 家，群光電能科技(股)公司及仁寶電腦工業(股)公司。
呂肇祥		具有商務及製造業務之工作經驗。 歷任力晶半導體封裝生產副處長。 現任本公司總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	無。
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 (Shigeo Koguchi)		具有商務、研發及製造業務之工作經驗。 歷任 Toshiba Corp. 資深執行副總經理、董事及資深顧問。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	無。
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿		具有商務及財務會計之工作經驗。 歷任品安科技(股)公司監察人。 現任遠東金士頓科技(股)公司財務長及金士頓電子(股)公司監察人。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	無。
超豐電子(股)公司 代表人：謝永達		具有商務及製造業務之工作經驗。 歷任遠東金士頓科技(股)公司總經理、鴻海精密工業(股)公司副總經理、本集團資深副總裁及聚成科技(股)公司總經理。 現任本公司執行長及超豐電子(股)公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	無。
台灣鎧俠先進半導體(股)公司 代表人：淺田順一 (Junichi Asada)		具有商務及經營策略之工作經驗。 歷任鎧俠株式會社資深顧問。 現任台灣鎧俠先進半導體(股)公司董事長暨總經理。 未有公司法第 30 條各款情事。	不適用。	無。
張光瑤		具有商務及經營策略之工作經驗。 創辦光纖電腦科技(股)公司逾 40 年。 歷任台中市副市長、扶輪社地區總監、台中工業區廠協會理事長及總統府國策顧問。 現任光纖電腦科技(股)公司總裁。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事；本人及配偶或以他人名義持有本公司發行股票 2,000 股，持股比重 0.00%；未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。	2 家，鈺鎧科技(股)公司及達方電子(股)公司。
李培瑛		具有商務、製造業務及經營策略之工作經驗。 深耕半導體及 DRAM 產業約 40 年，歷任美國 IBM 公司研發資深主管、南亞科技(股)公司資深副總經理及華亞科技(股)公司董事長。 現任南亞科技(股)公司董事暨總經理及福懋科技(股)公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事；本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票；未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。	無。

姓 名	條 件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
陳瑞聰		具有商務及經營策略之工作經驗。 歷任華寶通訊(股)公司董事長及仁寶電腦工業(股)公司總經理、副董事長暨策略長。 現任仁寶電腦工業(股)公司董事長。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事；本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票；未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。	無。
童兆勤		具有商務及經營策略之工作經驗。 歷任中華開發工業銀行(股)公司董事長、中國信託商業銀行(股)公司董事長、財團法人台灣經濟研究院董事、台灣力森諾科技股份有限公司副董事長。 現任中嘉數位股份有限公司董事。 未有公司法第 30 條各款情事。	未有配偶或二親等以內之親屬擔任本公司董事；本人及配偶或以他人名義皆未持有本公司發行股票；未向本公司提供審計、商務、法務、財務、會計等服務且未取得相關報酬，並符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 3 條之規定。	1 家，東元電機(股)公司。

二、董事會多元化及獨立性：

1. 本公司第十屆董事會 10 名董事成員，整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀及領導決策等能力，且有專業資格及半導體產業經驗；其中擁有前瞻經營決策能力者為蔡篤恭董事長、呂肇祥董事、謝永達董事、淺田順一董事、陳瑞聰獨立董事及張光瑤獨立董事；具備會計及財務專業能力者為吳麗卿董事及童兆勤獨立董事；具備研發能力者為古口榮男董事及李培瑛獨立董事。
2. 本公司第十屆董事會 10 名董事成員中，有 8 名本國籍及 2 名日本籍，組成結構為 6 名董事占 60% 及 4 名獨立董事占 40%，而本公司章程明定獨立董事人數至少 4 人，且不得少於董事席次 1/3，優於證券交易法之規定。董事成員年齡分布區間計有 1 名董事為 51-60 歲、4 名董事為 61-70 歲、5 名董事為 71-80 歲。另外，董事成員中有 1 名董事代表人為女性。
3. 本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一之原因及規劃提升董事性別多元化採行措施：
原因：因目前本公司女性高層管理人才較為缺乏，導致董事女性性別比例未達三分之一。
採行措施：積極推動並鼓勵女性參與高層管理培訓，以提供女性更多的領導與管理機會，進而培養董事人才。
4. 董事多元化面向、互補及落實情形已包括且優於「公司治理守則」第 20 條載明之標準；未來仍視董事會運作、營運型態及發展需求適時增修多元化政策，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
5. 董事會之獨立性情形：本公司 4 名獨立董事任期均未逾三屆。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年3月29日；股

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日 期	持有股份 (註1)		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學) 歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
策略長	中 華 民 國	蔡篤恭	男性	107.11.02	3,360,000	0.44%	-	-	-	-	台北工專工業工程科 金士頓集團亞太區總經理 遠東金士頓科技(股)公司董事長	本公司董事長 起豐電子(股)公司法人董事代表人 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 董事 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 力成科技日本合同會社業務執行代表 Tera Probe, Inc. 取締役 群光電能科技(股)公司獨立董事 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 財團法人力成科技教育基金會董事長	-	-	-	-
執行長	中 華 民 國	謝永達	男性	109.10.01	18,000	0.00%	2,000	0.00%	-	-	交通大學高階管理碩士 遠東金士頓科技(股)公司總經理 鴻海精密工業(股)公司副總經理 力成科技(股)公司集團資深副總裁 聚成科技(股)公司總經理 起豐電子(股)公司執行長	本公司法人董事代表人 起豐電子(股)公司法人董事代表人暨董事長 晶兆成科技(股)公司法人董事代表人暨董事長 得祥科技(股)公司董事長 Tera Probe, Inc. 取締役 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
總經理	中 華 民 國	呂肇祥	男性	109.10.01	62,356	0.01%	-	-	-	-	逢甲大學機械系學士 力晶半導體封装生產副處長	本公司董事 元成科技(蘇州)有限公司董事 力成半導體(西安)有限公司董事長 起豐電子(股)公司法人董事代表人 PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事	-	-	-	-
營運長暨 資深副總經理	中 華 民 國	陳玉欽	男性	110.11.05	0	0.00%	-	-	-	-	中原大學工業工程學士 力晶半導體(股)公司製造部經理	財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
測試暨模組營運 營運長暨 資深副總經理	中 華 民 國	吳文雄	男性	112.03.10	10,786	0.00%	-	-	-	-	中原大學工業工程碩士 力晶半導體(股)公司部經理	晶兆成科技(股)公司法人董事代表人 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
前財務長暨 資深副總經理	中 華 民 國	曾炫章	男性	104.05.01	0	0.00%	-	-	-	-	東吳大學會計碩士 前力成科技(股)公司財務長暨資深 副總經理	無	-	-	-	註2
財務長暨 副總經理	中 華 民 國	沈俊宏	男性	113.11.08	0	0.00%	-	-	-	-	政治大學經營管理研究所碩士 力成蘇州財務總監 龍邦國際興業(股)公司協理	Tera Probe, Inc. 取締役 力成半導體(西安)有限公司 董事 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 董事	-	-	-	註3

職 稱	國 籍	姓 名	性 別	選(就)任 日 期	持有股份 (註1)		配偶、未成年 子女持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之經理人			備 註
					股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率	股 數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
前品質暨 資深副總經理	中 華 民 國	王文忠	男性	91.12.12	20,056	0.00%	-	-	-	-	交通大學企管碩士 勝開科技 R&D 工程協理	無	-	-	-	註4
業 務 副 總 經 理	中 華 民 國	喬廣文	男性	109.10.01	0	0.00%	-	-	-	-	交通大學工業工程與管理碩士 摩托羅拉系統(股)公司經理 旺宏電子(股)公司經理	無	-	-	-	-
經 營 副 總 經 理	中 華 民 國	巫勤達	男性	99.03.09	0	0.00%	-	-	-	-	淡江大學機械學士 美商艾克爾(上賓)處長	無	-	-	-	-
先進技術暨 晶圓級封裝營運 副總經理	中 華 民 國	林基正	男性	112.01.01	5,000	0.00%	-	-	-	-	清華大學動力機械研究所博士 台積電研發經理	起豐電子(股)公司法人董事代表人 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	註5
廠務工程 副總經理	中 華 民 國	林賢鳳	男性	108.01.11	11,715	0.00%	-	-	-	-	明新工專機械工程學士 遠東金士頓科技經理	無	-	-	-	-
人力資源暨法務 副總經理	中 華 民 國	林宥翰	男性	108.01.11	150,000	0.02%	-	-	-	-	Golden Gate University 法學博士 普華商務法律事務所律師	力成半導體(西安)有限公司監事 晶兆成科技(股)公司監察人 財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-
測試研發 協理	中 華 民 國	陳世恭	男性	101.05.10	0	0.00%	-	-	-	-	台灣科技大學電機碩士 新加坡商惠瑞捷科技協理 美商安捷倫科技協理	無	-	-	-	-
晶圓級封裝營運 協理	中 華 民 國	董定鑫	男性	105.03.01	0	0.00%	-	-	-	-	元智大學工業工程碩士 美商艾克爾科技資深處長	無	-	-	-	-
前生產企劃 協理	中 華 民 國	朱肇信	男性	109.11.06	0	0.00%	-	-	-	-	逢甲大學企業管理學士 美商安可電子經理	無	-	-	-	註6
邏輯封裝研發 協理	中 華 民 國	徐宏欣	男性	112.01.01	0	0.00%	-	-	-	-	清華大學原子科學研究所碩士 美商艾克爾科技部經理	財團法人力成科技教育基金會董事	-	-	-	-

註1：截至本次股東常會停止過戶日114年3月29日止之實際持股數。

註2：前財務長暨資深副總經理曾煊章先生於113年11月8日退休，其持有股數揭露至退休日止。

註3：財務長暨副總經理沈俊宏先生於113年11月8日經董事會任命，其持有股數揭露自接任日起至本次股東常會停止過戶日114年3月29日止。

註4：前品質長暨資深副總經理王文忠先生於113年2月29日退休，其持有股數揭露至退休日止。

註5：林基正先生原為協理，經114年2月21日董事會通過晉升為副總經理，自114年3月1日生效。

註6：前生產企劃協理朱肇信先生於113年2月29日退休，其持有股數揭露至退休日止。

註7：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事兼任員工或經理人等方式)之相關資訊；無此情形。

二、最近年度給付董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金				兼任員工領取相關酬金				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		薪資、獎金及特支費等(E)(註5)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)(註6)		A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例(%) (註10)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(註11)	
		報酬(A)(註2)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)(註3)		業務執行費用(D)(註4)		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司(註10)			
		本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)	本公司	財務報告內所有公司(註7)										現金金額		股票金額
董事長	蔡篤恭																			無	
	呂肇祥																				
	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)																				
	代表人：古口榮男																				
	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)	0	0	0	0	91,646	120,923	720	1,164	92,366 1.36%	122,087 1.80%	38,854	311	13,747	0	145,278 2.14%	174,999 2.58%				
	代表人：吳麗卿																				
董事	起豐電子(股)公司																			無	
	代表人：謝永達																				
	台灣鎰依先進半導體(股)公司																				
	代表人：淺田順一																				
	張光瑤																				
	李培瑛	9,120	9,120	0	0	0	0	480	480	9,600 0.14%	9,600 0.14%	0	0	0	0	9,600 0.14%	9,600 0.14%				
獨立董事	陳瑞聰																			無	
	童兆勤																				
1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性； 依本公司章程規定，獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞之分配。依獨立董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準後，經董事會通過議定之。 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。																					

1.獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

依本公司章程規定，獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞之分配。依獨立董事對本公司營運參與程度及貢獻價值，並參酌國內外業界通常支給水準後，經董事會通過議定之。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事 酬金級距	董 事 姓 名				
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)		
	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)H	本公司(註8)	財務報告內所有公司(註9)I	
低於1,000,000元	—	—	—	—	—
1,000,000元(含)～ 2,000,000元(不含)	—	—	—	—	—
2,000,000元(含)～ 3,500,000元(不含)	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤	張光瑤、李培瑛、陳瑞聰、童兆勤
3,500,000元(含)～ 5,000,000元(不含)	—	—	—	—	—
5,000,000元(含)～ 10,000,000元(不含)	—	—	—	—	—
10,000,000元(含)～ 15,000,000元(不含)	呂肇祥、 超豐電子(股)公司(代表人：謝永達)、 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰依先進半導體(代表人：淺田順一)	呂肇祥、 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰依先進半導體(代表人：淺田順一)	呂肇祥、 美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰依先進半導體(代表人：淺田順一)	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰依先進半導體(代表人：淺田順一)	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (代表人：古口榮男、吳麗卿)、 台灣鎰依先進半導體(代表人：淺田順一)
15,000,000元(含)～ 30,000,000元(不含)	蔡篤恭	—	呂肇祥	呂肇祥	呂肇祥
30,000,000元(含)～ 50,000,000元(不含)	—	蔡篤恭、 超豐電子(股)公司(代表人：謝永達)	蔡篤恭、 超豐電子(股)公司(代表人：謝永達)	超豐電子(股)公司(代表人：謝永達)	超豐電子(股)公司(代表人：謝永達)
50,000,000元(含)～ 100,000,000元(不含)	—	—	—	—	蔡篤恭
100,000,000元以上	—	—	—	—	—
總 計	10 名	10 名	10 名	10 名	10 名

註1：董事姓名係分別列示(法人股東將法人股東名稱及代表人分別列示)，因其中有董事或代表人有兼任執行長、策略長及總經理之情形，另亦填列下表3。

註2：係指113年度董事之薪資報酬。依本公司章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。

註3：係指113年度董事之薪資報酬。依本公司章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。

註4：係指113年度董事之薪資報酬。依本公司章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。

註5：係指113年度董事之薪資報酬。依本公司章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。

註6：係指113年度董事之薪資報酬。依本公司章程規定，獨立董事為按月支領報酬，不參與年度盈餘分配之董事酬勞。

註7：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司董事各項酬金之總額。

註8：本公司給付每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註9：應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位董事各項酬金總額，於所歸屬級距中揭露董事姓名。

註10：稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註11：a.本欄應填列公司董事領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

b.公司董事如有領取來自子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，應將公司董事於子公司以外轉投資事業或母公司相關酬金者，併入酬金級距表之I欄，並將欄位名稱改為「母公司及所有轉投資事業」。

c.酬金係指本公司董事擔任子公司以外轉投資事業或母公司之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。

2.總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D) (註2)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%)		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
策略長	蔡篤恭													
執行長	謝永達													
總經理	呂肇祥													
營運長暨資深副總經理	陳玉欽													
測試暨模組營運營運長暨資深副總經理	吳文維													
財務長暨副總經理	沈俊宏(註1)	39,366	39,366	1,489	1,489	52,541	53,189	22,093	0	22,093	0	115,489 1.70%	116,137 1.71%	無
前財務長暨資深副總經理	曾炫章(註1)													
業務副總經理	喬廣文													
經營管理資深副總經理	巫勤達													
廠務工程副總經理	林賢鳳													
前品質長暨資深副總經理	王文忠(註2)													
人力資源暨法務副總經理	林宥翰													

註1：前財務長曾炫章先生於113年11月8日退休，經董事會通過任命由沈俊宏先生接任。

註2：前品質長暨資深副總經理王文忠先生於113年2月29日退休。

總經理及副總經理酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	—	—
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	—	—
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	王文忠(註 1)	王文忠(註 1)
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	沈俊宏	沈俊宏
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	喬廣文、巫勤達、吳文維 林賢鳳、林宥翰、 曾炫章(註 2)	喬廣文、巫勤達、吳文維 林賢鳳、林宥翰、 曾炫章(註 2)
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	陳玉欽	陳玉欽
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	蔡篤恭、謝永達、呂肇祥	蔡篤恭、謝永達、呂肇祥
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	—	—
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	12 名	12 名

註 1：王文忠先生於 113 年 2 月 29 日退休，其酬金揭露至退休日止。

註 2：曾炫章先生於 113 年 11 月 8 日退休，其酬金揭露至退休日止。

註 3：係填列 113 年度經董事會通過分派之員工酬勞金額(全部以現金發放)，因目前尚無法預估，故按去年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額，並另填列表 3。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日

	職 稱	姓 名	股票金額 (仟元)	現金金額 (仟元)	總計 (仟元)	總額占稅後純益之 比例 (%)
經 理 人	策略長	蔡篤恭	0	26,436	26,436	0.39%
	執行長	謝永達				
	總經理	呂肇祥				
	營運長暨資深副總經理	陳玉欽				
	測試暨模組營運營運長 暨資深副總經理	吳文維				
	財務長暨副總經理	沈俊宏				
	業務副總經理	喬廣文				
	經營管理資深副總經理	巫勤達				
	廠務工程副總經理	林賢鳳				
	人力資源暨法務副總經理	林宥翰				
	測試研發協理	陳世恭				
	晶圓級封裝協理	董定鑫				
	先進技術暨晶圓級封裝協理	林基正				
	邏輯封裝研發協理	徐宏欣				
	會計主管	紅立勝				

註 1：係填列 113 年度經董事會通過分配經理人之員工酬勞金額 (全部以現金發放)，因目前尚無法預估，故按去年度實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。

註 2：經理人之適用範圍，依據財政部證經會九十二年三月二十七日台財證三字第○九二○○○一三○一號函令規定，其範圍如下：

- | | |
|---------------|----------------------|
| (1)總經理及相當等級者 | (4)財務部門主管 |
| (2)副總經理及相當等級者 | (5)會計部門主管 |
| (3)協理及相當等級者 | (6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人 |

註 3：會計主管紅立勝先生於 113 年 11 月 8 日經董事會任命，接任曾炫章先生之會計主管職務。

4.分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付董事、總經理及副總經理酬金總額佔個體財務報告稅後純益比例之分析，並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性

職 稱	113 年度酬金總額 佔稅後純益之比例		112 年度酬金總額 佔稅後純益之比例	
	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司	本 公 司	財 務 報 告 內 所 有 公 司
董事(含獨立董事)	1.50%	1.94%	1.48%	1.95%
總經理及副總經理	1.70%	1.71%	1.81%	1.82%

- (1) 本公司支付董事之酬金係依本公司章程所訂定之比例分配之。自當年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利，提撥不高於 1.5%為董事酬勞。獨立董事則為按月支領報酬，不參與董事酬勞之分配。
- (2) 薪酬委員會每年定期依據市場薪酬趨勢、公司經營績效、經理人個人管理績效及未來風險之關聯性，檢視董事及經理人酬金競爭力及合理性，並提報董事會核議。
- (3) 本公司及財務報告內所有公司預估發放113年度之董事酬金佔當年度稅後純益之比例與112年度相當。113年度之經理人之酬金佔當年度稅後純益之比例較112年度減少，主要係因113年度經理人異動影響配發之經理人酬金所致。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

本公司第十屆董事會於 113 年度共開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列) 席次數(B)	委託出席 席次數	實際出席(列)席率 (%)B/A	備註
董事長	蔡篤恭	5	0	100%	無
董事	呂肇祥	5	0	100%	無
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男 Shigeo Koguchi	5	0	100%	無
董事	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：吳麗卿	5	0	100%	無
董事	超豐電子(股)公司 代表人：謝永達	5	0	100%	無
董事	台灣鎰俠先進半導體(股)公司 代表人：原健二郎 Kenjiro Hara (註 1)	4	0	100%	無
	台灣鎰俠先進半導體(股)公司 代表人：淺田順一 Junichi Asada (註 1)	1	0		
獨立董事	李培瑛	5	0	100%	無
獨立董事	張光瑤	5	0	100%	無
獨立董事	陳瑞聰	5	0	100%	無
獨立董事	童兆勤	5	0	100%	無
全體董事之合計出席情形		50	0	100%	無

註 1：台灣鎰俠先進半導體(股)公司改派淺田順一先生擔任法人董事代表人，自 113 年 10 月 1 日生效。

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：

本公司業已設立審計委員會，證券交易法第 14 條之 3 所列事項皆經審計委員會全體成員同意後，提董事會決議。相關說明請詳第 23 頁審計委員會運作情形之其他應記載事項 1。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

(1) 113 年 3 月 8 日第十屆第 5 次董事會

討論事項第四案：擬分配 112 年度董事酬勞及員工酬勞案

本案經理人董事蔡篤恭、謝永達及呂肇祥因利害關係迴避並離席未參與討論，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

討論事項第五案：經理人薪資調整案

本案經理人董事蔡篤恭、謝永達及呂肇祥因利害關係迴避並離席未參與討論，經主席徵詢全體出席董事無異議通過。

3.董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊之評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年執行一次	113.01.01 ~ 113.12.31	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估	董事會內部自評、董事成員自評、功能性委員會內部自評或其他適當方式進行績效評估	1.董事會績效評估： 包括對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制等。 2.個別董事成員績效評估： 包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。 3.功能性委員會績效評估： 對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等。

評估結果如下：

各項問卷總達成率為 90%(含)以上時，則該項績效評估結果為「超越標準」；總達成率為 80%(含)未滿 90%時，則該項績效評估結果為「符合標準」；總達成率未滿 80%時，則該項績效評估結果為「仍可加強」。

整 體 董 事 會				
衡量指標	指標數	總分	平均得分	達成率
一、對公司營運之參與程度	7	21	21.00	100.00%
二、提升董事會決策品質	11	33	31.80	96.36%
三、董事會組成與結構	6	18	18.00	100.00%
四、董事之選任及持續進修	6	18	16.80	93.33%
五、內部控制	5	10	9.60	96.00%
總計	35	100	97.20	97.20 %
綜合評語		經評估問卷後，總達成率為97.20%，評估結果為超越標準。		

董 事 成 員				
衡量指標	指標數	總分	平均得分	達成率
一、公司目標與任務之掌握	3	15	14.40	96.00%
二、董事職責認知	3	15	14.10	94.00%
三、對公司營運之參與程度	8	40	36.40	91.00%
四、內部關係經營與溝通	3	15	13.80	92.00%
五、董事之專業及持續進修	3	15	13.50	90.00%
六、內部控制	3	15	13.80	92.00%
總計	23	115	106.00	92.17%
綜合評語		經評估問卷後，總達成率為92.17%，評估結果為超越標準。		

審 計 委 員 會				
衡量指標	指標數	總分	平均得分	達成率
一、對公司營運之參與程度	4	20	19.75	98.75%
二、審計委員會職責認知	5	25	24.50	98.00%
三、提升審計委員會決策品質	7	35	34.50	98.57%
四、審計委員會組成及成員選任	3	15	15.00	100.00%
五、內部控制	3	15	15.00	100.00%
總計	22	110	108.75	98.86%
綜合評語	經評估問卷後，總達成率為98.86%，評估結果為超越標準。			

薪 資 報 酬 委 員 會				
衡量指標	指標數	總分	平均得分	達成率
一、對公司營運之參與程度	4	20	19.33	96.67%
二、薪酬委員會職責認知	4	20	19.33	96.67%
三、提升薪酬委員會決策品質	9	45	44.00	97.78%
四、薪酬委員會組成及成員選任	4	20	20.00	100.00%
五、內部控制	1	5	5.00	100.00%
總計	22	110	107.67	97.88%
綜合評語	經評估問卷後，總達成率為97.88%，評估結果為超越標準。			

風 險 管 理 委 員 會				
衡量指標	指標數	總分	平均得分	達成率
一、對公司營運之參與程度	4	20	19.33	96.67%
二、風管委員會職責認知	5	25	24.33	97.33%
三、提升風管委員會決策品質	9	45	44.67	99.26%
四、風管委員會組成及成員選任	3	15	15.00	100.00%
五、內部控制	2	10	10.00	100.00%
總計	23	115	113.33	98.55%
綜合評語	經評估問卷後，總達成率為98.55%，評估結果為超越標準。			

改善建議：

(一) 針對董事提出之意見及視董事會議案需要，安排董事會以外之多元溝通管道，以利董事瞭解相關意見及議案之辦理情形，以提升董事對公司營運之參與程度。

(二) 董事會成員於會議前所提意見，均適時轉知相關單位辦理並作為未來相關決策評估參考。

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

本公司於113年度召開5次董事會，於各次董事會議後，持續秉持提昇資訊透明之原則，當日即以中英文重大訊息之方式將重要決議事項之摘要公告於公開資訊觀測站。若依法令規定或實際需要，亦會依規定舉行重大訊息說明會或記者會，向投資人及記者詳細說明及回答疑問。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，於 109 年 3 月 10 日第八屆第十六次董事會通過訂定之「董事會績效評估辦法」，每年應依據該辦法之規定執行內部董事會績效評估，並於次一年度第一季結束前完成。

5.董事長(或董事會成員)及重要管理階層之接班規劃，包含相關培育情形、接任職務預定時程等運作情形：

公司在規劃接班計劃中，接班人除了必須具備卓越的擬定企業策略能力、邏輯分析能力及管理能力外，接班人的價值觀更要與以人為本、誠信正直的企業文化相符，以「技術、品質及服務世界第一」為目標，以達公司永續經營，相關的接班規劃以下列幾個面向進行：

1.組織規劃調整與職務輪調

(1)經營團隊的傳承：

藉由組織職務的調整及營運長接班以完善接班人計劃，將董事長的經營理念及管理策略做傳承，以利於總經理更順暢的承接與掌舵公司未來管理與發展方向。

(2)高階主管的職務輪調：

由高階主管擔任各子公司的董事長及加入董事會，藉由此職務輪調來提昇高階主管人員的企業策略能力及累積企業經營管理的實務經驗。

(3)廠長的設置：

製造營運單位設置廠長之職務，以培養人員全方位製造營運的管理能力與實務經驗，藉此來養成製造營運單位高階主管的接班人。

2.理念與經驗的傳承

(1)經營理念與管理經驗的制度化

由現有高階主管人員將經營理念與管理經驗制度化並文件化，同時透由建構公司的核心職能、管理職能及職務體系的重整建構，使其得以傳承及延續。

(2)公司重要會議的設立與參與：

透由中高階主管參與業務會議、產銷會議及研發單位的分享會議…等，以進一步接觸管理核心，承接公司經營管理的理念及了解產業局勢與公司發展的佈局。

3.各層級主管接班人才提報與培訓

(1)各層級主管接班人才提報：

透由年度績效管理做適切的評估後，由各層級主管提報出可培育具潛力的接班人才。

(2)具潛力接班人才的培育

從公司教育訓練體系出發，透過提供一系列內、外部教育訓練資源，更導入線上學習平台，提供各階層主管根據職務所需與時俱進學習；此外，為了傳承內部好的知識與公司文化，每季辦理高階主管講座，分享其寶貴的管理心法與職涯歷程，讓各階層主管都能了解公司的企業文化及經營理念，進而讓其未來能承接各層級主管職務。

(二)審計委員會運作情形：本公司第四屆審計委員會於 113 年度開會 4 次(A)，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	張光瑤	4	0	100%	無
獨立董事	李培瑛	4	0	100%	無
獨立董事	陳瑞聰	4	0	100%	無
獨立董事	童兆勤	4	0	100%	無

其他應記載事項：

1.審計委員會年度工作重點彙整

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會於 113 年度審議之事項主要包括：

- (1) 財務報告及會計政策與程序
- (2) 內部稽核計畫及內部控制制度有效性之考核
- (3) 修訂內部控制制度
- (4) 評估簽證會計師之獨立性、適任性及公費
- (5) 盈餘分配案
- (6) 衍生性金融商品交易情形
- (7) 私募有價證券
- (8) 公司風險管控情形
- (9) 財務、會計或內部稽核主管之任免
- (10) 關係人交易情形

▲審議財務報告

董事會造具本公司民國 113 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配議案等，其中財務報告業經委託勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經審計委員會查核，認為尚無不合。

▲評估內部控制制度之有效性

審計委員會審查公司稽核部門、簽證會計師和管理階層的定期報告，藉以評估公司內部控制制度政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、法令遵循等控制措施)之有效性，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的，公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

▲委任及評估簽證會計師之獨立性及適任性

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責，以合理確信財務報表的可靠性。除稅務相關服務或特別核准的項目外，簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。

為確保簽證會計師事務所的獨立性，審計委員會係參照會計師法第 47 條及會計師職業道德規範公報第 10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表，自 112 年起，並參考審計品質指標(AQIs)，就會計師之獨立性、專業性及適任性予以評估。於 113 年 3 月 8 日經第四屆第五次審計委員會及 113 年 3 月 8 日第十屆第五董事會審議通過，認為勤業眾信聯合會計師事務所林政治會計師及方蘇立會計師均符合獨立性評估標準，並足以擔任本公司之簽證會計師。

2.審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(1)證交法第 14 條之 5 所列事項：

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	審計委員會 決議結果	董事會對審計委 員會意見之處理
第四屆第 5 次(113.3.8)審計委員會			
1.審查本公司 112 度營業報告書及財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2.審查本公司 112 年度盈餘分配案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
3.本公司 112 年度內部控制制度有效性考核暨出具 112 年度內控聲明書案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
4.評估本公司聘僱會計師之獨立性及適任性案暨審計公費案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
5.擬訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
6.擬不繼續辦理本公司 112 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
7.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
第四屆第 6 次(113.5.10)審計委員會			
1.審查本公司 113 年度第一季合併財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2.為規避匯率波動之風險，擬申請銀行買賣遠期外匯額度案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
第四屆第 7 次(113.8.9)審計委員會			
1.審查本公司 113 年度第二季合併財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2.為規避匯率波動之風險，擬申請銀行買賣遠期外匯額度案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
第四屆第 8 次(113.11.8)審計委員會			
1.審查本公司 113 年度第三季合併財務報告。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
2.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
3.訂定本公司 114 年度內部稽核計劃。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。
4.擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。	無此情形	全體出席委員無異議通過。	全體出席董事同意通過。

議案內容	反對意見/ 保留意見/ 重大建議	審計委員會 決議結果	董事會對審計委 員會意見之處理
5.經理人退休案。	無此情形	全體出席委員無異 議通過。	全體出席董事 同意通過。
6.經理人委任案。	無此情形	全體出席委員無異 議通過。	全體出席董事 同意通過。
7.擬終止海外存託憑證上市案。	無此情形	全體出席委員無異 議通過。	全體出席董事 同意通過。
8.為規避匯率波動之風險，擬申請銀行買賣遠 期外匯額度案。	無此情形	全體出席委員無異 議通過。	全體出席董事 同意通過。

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之
議決事項：無此情形。

3.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應
利益迴避原因以及參與表決情形：無此情形。

4.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進
行溝通之事項、方式及結果等）：

(1)內部稽核部門除每月將稽核報告以電子郵件方式送交各獨立董事審核外，稽核
主管亦會針對稽核發現及建議事項，於每季之審計委員會會議上向各獨立董事
提出報告及說明，並回應獨立董事之疑問及建議。

(2)會計師依據審計準則公報第 39 號「與受查者治理單位之溝通」及證券期貨局
93 年 3 月 11 日發布之台財證六字第 0930105373 號函規定，於規劃階段及完成
階段，每季就本公司合併財務報告(年度另包含個體財務報告)查核或核閱之治
理事項，彙整資訊於審計委員會會議向各獨立董事進行報告及溝通。

(3)本公司每季至少召開一次審計委員會，113 年度於審計委員會之歷次會議中，
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形良好，溝通事項摘要如下：

日 期	溝 通 重 點	溝 通 結 果
113.3.8	第四屆第 5 次審計委員會議之溝通事項如下： 1.112 年第 4 季內部稽核執行結果報告。 2.討論 112 年度內部控制制度有效性考核及自行 評估結果報告，並出具設計及執行均有效之聲 明書。 3.評估本公司聘雇會計師之獨立性及適任性案暨 審計公費案。 4.訂定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先 核准之審核辦法」。 5.通過不繼續辦理本公司 112 年股東常會通過之 「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外 存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或 現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉 換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債 案」。 6.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存 託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現 金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司	除左列溝通外，無其 他建議事項。 112 年第 4 季內部稽 核執行結果提董事 會報告；112 年度內 部控制制度有效性 考核並出具設計及 執行均有效之聲明 書及 112 年度個體及 合併財務報告，提請 董事會通過後如期 公告及申報主管機 關。

日 期	溝 通 重 點	溝通結果
	債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。 7.會計師報告 112 年度個體及合併財務報告之查核內容及結果(包括會計師查核報告中關鍵查核事項段之說明)；並針對重大會計估計問題進行討論與溝通。另外，會計師亦報告 113 年度之核閱/查核規劃，並針對本公司已辨認之重大審計風險項目進行陳述與溝通。 溝通及獨立董事建議：無。	
113.5.10	第四屆第 6 次審計委員會議之溝通事項如下： 1.113 年第 1 季內部稽核執行結果報告。 2.會計師報告 113 年第 1 季合併財務報告之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及法令更新進行討論與溝通。 溝通及獨立董事建議： 獨立董事詢問會計師出具保留式結論的原因、內容、及子公司是否須經會計師核閱，其標準為何？會計師回覆並說明相關情況。	除左列溝通外，無其他建議事項。 113 年第 1 季內部稽核執行結果及 113 年第 1 季合併財務報告提董事會報告後，合併財務報告如期公告及申報主管機關。
113.8.9	第四屆第 7 次審計委員會議之溝通事項如下： 1.113 年第 2 季內部稽核執行結果報告。 2.會計師報告 113 年第 2 季合併財務報告之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題及法令更新進行討論與溝通。 溝通及獨立董事建議： 獨立董事詢問會計師可否出具無保留意見的季報。會計師回覆並說明相關情況。	除左列溝通外，無其他建議事項。 113 年第 2 季內部稽核執行結果及 113 年第 2 季合併財務報告提董事會報告後，合併財務報告如期公告及申報主管機關。
113.11.8	第四屆第 8 次審計委員會議之溝通事項如下： 1.113 年第 3 季內部稽核執行結果報告。 2.會計師報告 113 年第 3 季合併財務報告之核閱內容及結果；並針對重大會計估計問題、近期稅務、證管相關更新之法令進行討論與溝通。另外，會計師亦針對本公司之關鍵查核事項進行陳述與討論。 3.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 4.訂定本公司 114 年度內部稽核計劃。 5.各出席委員、會計師及稽核主管並就財務報告及財務業務狀況等，進行單獨溝通會議。 溝通及獨立董事建議： 1.獨立董事詢問本公司是否有參與外部資安相關組織及釣魚郵件案件之頻率？內部稽核主管回覆並簡要說明相關情況。 2.獨立董事詢問目前碳費徵收議題對本公司的影響為何？內部稽核主管回覆並說明此議題對本公司財務面之影響尚不具重大性。	除左列溝通外，無其他建議事項。 113 年第 3 季內部稽核執行結果及 113 年第 3 季合併財務報告提董事會報告後，合併財務報告如期公告及申報主管機關。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		本公司依「上市上櫃治理實務守則」訂定公司治理守則，於103年11月5日經第七屆第三次董事會通過，期間經過董事會通過多次增修，並揭露於本公司網站及公開資訊觀測站。	符合上市上櫃公司治理實務守則
二、公司股權結構及股東權益 (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		(一)本公司設有發言人、財務部門亦設股務人員處理股東建議及相關問題，並於公司網站開放股東或投資人聯絡窗口蒐集相關建議。若涉及法律問題時，再委請法務部門同仁或法律顧問處理。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		(二)本公司股務代理機構定期提供股東名簿及相關報表，本公司亦依規定揭露相關資訊，並已設置投資關係人部門，與主要股東維繫良好的溝通管道。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		(三)本公司與關係企業間之財務業務往來，已依據相關規定制定書面辦法並遵循之。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		(四)本公司訂有「防範內線交易管理作業」，規範本公司董事、經理人、員工及其他因身分、職業或控制關係而知悉本公司內部重大資訊之人，禁止任何可能涉及內線交易之行為。 本公司於每年第三季期間，以E-Learning的方式向內部員工進行教育訓練及宣導。	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	✓		(一)本公司董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形請詳本表下方說明一。	符合上市上櫃公司治理實務守則
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		(二)本公司除依法於董事會轄下設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另自願設置風險管理委員會；本公司亦有設置直屬於總經理之「資訊安全委員會」、「工安環保委員會」、「全面品質管理委員會」、「永續發展委員會」及「教育訓練委員會」，並定期向管理階層報告執行狀況。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		(三)本公司於109年3月10日第八屆第16次董事會通過訂定董事會績效評估辦法，每年將定期進行績效評估，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。目前董事會成員皆忠實執行業務及恪盡善良管理人之注意義務，並以高度自律及審慎的態度行使職權，以維護公司及股東權益。 113年度之董事會(含功能性委員會)之績效評估已於114年2月完成，並於114年2月21日將績效評估之結果提報第十屆第10次董事會，請參閱本年報「董事會運作情形」。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		(四)本公司於104年初開始，每年定期評估簽證會計師之獨立性。113年評估及呈報之程序及內容如下： 1.取具並檢視勤業眾信聯合會計師事務所林政治及方蘇立會計師簡歷資料。 2.取具會計師出具之獨立性聲明書。內容需聲明審計小組成員及其配偶與受撫養親屬未有違反獨立性或未解決利益衝突之情形。 3.上網搜尋簽證會計師以往是否有違反獨立性行為之紀錄。 4.參照會計師法第47條規範之獨立性及職業道德規範公報第十號「查核與核閱之獨立性」之內容制定「會計師獨立性及適任性評估表」，請詳本表下方說明二，逐項評估其是否有影響會計師獨立性之行為。 5.本公司於112年經董事會決議通過修訂「公司治理實務守則」，並規範應定期(至少一年一次)參考審計品質指標(AQIs)，評估所聘任會計師之獨立性、專業性及適任性，並將結果提報審計委員會及董事會審議後通過。113年度經參考及評估AQI指標資訊，確認會計師及事務所查核投入時數優於同業平均水準，並具備優於同業的品質控管能力，事務所近3年並導入審計創新工具，以提升審計品質，足堪擔任本公司簽證會計師。 6.會計師獨立性及適任性之評估結果，於114年2月21日經第四屆第9次審計委員會及第十屆第10次董事會討論通過。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		本公司目前負責公司治理相關事務之單位係由財務部門兼任，負責之相關事務如下。而公司治理主管已於109年11月6日第九屆第3次董事會通過設置，由財務長兼任之。 1.研擬並規劃年度董事會及股東會之時程及初步議案內容。 2.於各次董事會議前，規劃並擬定各議案之細部內容，於董事會前與公司內部董事確認識議案內容，並於會議日七日前通知所有董事出席並提供所有議程相關資料，以利董事有足夠時間瞭解議案內容；若有董事對利害關係議案需迴避之情形，將於事前及會議前提醒。 3.不定期更新證管法令供董事參考。於每次發出董事會開會通知時，亦會提醒董事善盡保密義務，避免違反證券交易法之相關規定。 4.各次董事會議後製作議事錄，依法詳實記載議決之事項，由會議主席及記錄人員蓋章，於會後二十日內分送各董事，並於公司存續期間妥善保存於檔案室。 5.每年依主管機關規定事先登記股東會日期，於公司治理評鑑規定之期限內完成製作及申報開會通知、議事手冊、年報及議事錄等會議相關資料，會議決議內容若涉及公司變更登記事項，將於會議結束後15日內向經濟部商業司申請辦理。 6.負責董事會及股東會重要決議之重大訊息發布事宜，確保內容之適法性、正確性及即時性等符合資訊對等之精神，以保障投資人權益。 7.提供董事進修之課程資訊，並協助安排課程及報名。 8.定期向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		本公司尊重利害關係人權益，透過適當溝通方式及利害關係人之參與，瞭解其合理期望及需求，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 1.股東／投資人 ◆ 關注議題：營運績效、誠信經營、技術與服務、法規遵循、風險管理、客戶服務。 ◆ 溝通管道：召開股東會（每年）、公开发佈財務報告（每季）、召開法人說明會（每季）、發言人及投資人關係部門（不定期）及公司網站（不定期）。	符合上市上櫃公司 治理實務守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			2.員工 ◆ 關注議題：薪資福利、勞工人權、職場健康與安全、人才招募與留任、勞資溝通。 ◆ 溝通管道：員工電子信箱(常設)、職工福利委員會(每季)、勞資會議(每季)、職業安全衛生委員會(每季)、力成園地季刊(每季)、員工滿意度(每月抽樣)、座談會／意見交流會(每月)、電子平台及公司公告(不定期)、提案改善制度(不定期)、及員工心理諮商與輔導(不定期)。 3.客戶 ◆ 關注議題：生物多樣性、客戶服務、職場健康與安全、勞工人權、薪資福利、員工發產、社會參與。 ◆ 溝通管道：客戶滿意度調查(每年)、業務會議(不定期)、客訴管理制度(不定期)及客戶稽核(不定期)。 4.供應商／承攬商 ◆ 關注議題：誠信經營、勞工人權、職場健康與安全、法規遵循、勞資溝通。 ◆ 溝通管道：供應商／承攬商稽核(每年)、供應商／承攬商宣導會(每年)、供應商評比(每季)、及供應商／承攬商業務會議(不定期)。 5.政府機關 ◆ 關注議題：水資源管理、污染防治、職場健康與安全、溫室氣體管理、氣候變遷、綠色產品、勞工人權。 ◆ 溝通管道：公文／電子郵件及會議(不定期)、宣導會／公聽會(不定期)及發佈函令(不定期)。 6.社區團體 ◆ 關注議題：社區參與、勞工人權、法規遵循、污染防治、員工發展、多元與包容。 ◆ 溝通管道：公司網站(不定期)、廠務部門對外窗口及課程與參訪(不定期)。 除了上述利害關係人溝通管道外，本公司網站另有設置永續發展及利害關係人專區，方便利害關係人及社會大眾閱覽，並設有利害關係人之聯絡管道，有利本公司瞭解利害關係人所關切的議題並能適時回應。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		本公司委任康和綜合證券股務代理部辦理股東會事務。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		(一)本公司已架設公司網站，定期或不定期揭露公司財務業務及公司治理相關資訊。	符合上市上櫃公司 治理實務守則
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？	✓		(二)本公司設有專責人員負責公司資訊之揭露，除依主管機關規定於公開資訊觀測站公告申報公司概況及各項財務業務資訊外，亦於公司網站於投資人關係專頁中揭露中英文資訊。另設有發言人及代理發言人以落實發言人制度。 本公司按季自行召開法人說明會，定期說明公司財務業務狀況，並提供會議過程網路直播和會後置於本公司網站供投資人觀看，相關訊息亦公告於公開資訊觀測站。	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		(三)本公司113年度於規定期限內公告並申報各季財務報告及於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，本公司亦於規定期限內公告並申報各月份營運情形。相關資訊請至公開資訊觀測站查詢。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？	✓		1. 員工權益及僱員關懷：請詳(五)推動永續發展執行之推動項目四、(一)~(四)之內容。 2. 本公司每年提醒董事及經理人依規定持續進修。113年進修情形請參考本表下方之說明三。 3. 本公司業已設置「風險管理委員會」及「營運持續管理推行小組」，依循重大性原則識別與公司營運相關之環境、社會與公司治理議題之風險，並審視可能面臨的各種緊急狀況或影響維運之衝擊，以強化風險管理與應變能力。風險管理委員會之成員、職權及運作情形請參考本表下方之說明四。 4. 本公司自97年起每年皆為董事(含獨立董事)及經理人購買責任保險。最近一期責任險於113年8月26日到期。本次投保以堆疊方式向美商安達產物保	符合上市上櫃公司 治理實務守則

評估項目	運作情形			與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	摘要說明	
			險(股)公司(基層保險部分)及富邦產物保險(股)公司(超額保險部分)辦理續保，保險期間113年8月26日至114年8月26日止，保險金額為US\$30,000,000，相關保險範圍及內容已於113年11月8日第十屆第9次之董事會中報告。 5. 本公司制定「永續發展委員會組織章程」並成立「永續發展委員會」，每季召開一次會議，針對企業永續發展執行狀況及議題進行改善及討論。 6. 每年度定期發行年報、財務資訊及永續報告書等，揭露公司治理相關資訊。 7. 本公司為有效保護公司及客戶之智慧財產和資產，積極建構穩固的資訊安全管理系統，已於105年10月取得ISO27001資訊安全管理系統之認證，並於111年10月21日通過重新驗證，證書有效期至114年10月2日，以維持ISO27001標準認證之有效性。	
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 本公司於第十屆公司治理評鑑(評鑑112年度)之未得分項目，於第十一屆公司治理評鑑(評鑑113年度)時之改善情形說明如下：				
指標類別	指標內容		是否改善	尚未改善及加強措施說明
維護股東權益及平等對待股東	1.1	公司是否於股東常會報告董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容及數額？	否	因涉及董事個人隱私，尚未取得全體董事同意前暫不揭露。
	1.2	公司是否訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，內容應包含進銷貨、取得或處分資產等交易之管理程序，及相關重大交易應提董事會決議通過，並提股東會同意或報告？	否	本公司已訂定與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，未來將視狀況提股東會同意或報告。
	1.3	公司是否有過半數董事及審計委員會召集人親自出席股東常會，並於議事錄揭露出席名單？	是	
	1.7	公司是否於股東常會開會 30 日前上傳股東會議事手冊及會議補充資料？	是	
	1.15	公司是否訂定並於公司網站揭露禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，與說明執行情形？	否	未來加強宣導及提醒。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
強化董事會結構與運作	1.19 公司之股東會是否採線上直播或於股東會後上傳全程不間斷錄音錄影？	是		
	2.21 公司之公司治理主管是否為專任，並於公司網站及年報說明職權範圍及進修情形？	否	本公司依人員配置設置公司治理主管。	
	2.23 公司訂定之董事會績效評估辦法是否經董事會通過，明定至少每三年執行外部評估一次，並已於受評年度或過去兩年度執行評估、將執行情形及評估結果揭露於公司網站或年報？	否	本公司訂定之董事會績效評估辦法尚未明訂至少每三年執行外部評估一次，未來將視狀況加以修訂。	
	2.30 公司內部稽核人員是否至少一人具有國際內部稽核師、國際電腦稽核師或會計師考試及格證書等證照？	是		
提升資訊透明度	3.4 公司是否在會計年度結束後兩個月內公布經會計師查核簽證之年度財務報告？	是		
	3.9 公司是否於每月 10 日(含)前將內部人上月份持股變動之情形上傳至公開資訊觀測站？	是		
	3.13 公司年報是否自願揭露董事之個別酬金？	否	因涉及董事個人隱私，尚未取得全體董事同意前暫不揭露。	
	3.21 公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？	否	因涉及總經理及副總經理個人隱私，尚未取得全體經理人同意前暫不揭露。	
落實企業社會責任	4.22 公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書？	否	本公司成立教育基金會，將資源投入偏鄉教育，以落實企業社會責任。	

說明一：本公司董事會成員多元化政策、具體管理目標及落實情形：

(一)董事會成員多元化政策

本公司「公司治理實務守則」第20條第3項規定：

董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- | | |
|--------------|----------|
| 一、營運判斷能力。 | 五、產業知識。 |
| 二、會計及財務分析能力。 | 六、國際市場觀。 |
| 三、經營管理能力。 | 七、領導能力。 |
| 四、危機處理能力。 | 八、決策能力。 |

(二)具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事人數至少四人	達成
獨立董事席次不少於董事席次三分之一	達成
董事會成員至少包含一位女性董事	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成

(三)落實情形

多元化核心項目 董事姓名	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡			獨立董事任期年資		營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導決策
				51至60	61至70	71至80	未逾三屆	逾三屆							
蔡篤恭	中華民國	男	√			√			√		√	√	√	√	√
呂肇祥	中華民國	男	√		√				√		√	√	√	√	√
古口榮男	日本	男				√			√		√	√	√	√	√
吳麗卿	中華民國	女		√					√	√	√	√	√	√	√
謝永達	中華民國	男	√		√				√		√	√	√	√	√
淺田順一	日本	男			√				√		√	√	√	√	√
張光瑤	中華民國	男				√	√		√		√	√	√	√	√
李培瑛	中華民國	男			√		√		√		√	√	√	√	√
陳瑞聰	中華民國	男				√	√		√		√	√	√	√	√
童兆勤	中華民國	男				√	√		√	√	√	√	√	√	√

註：上述不包含卸任之董事資料。

說明二：本公司 113 年度會計師獨立性及適任性評估表如下：

評估項目	是	否
1. 簽證會計師任期未逾七年。	√	
2. 簽證會計師與本公司無直接或重大間接財務利益關係。	√	
3. 簽證會計師與本公司無融資或保證行為。	√	
4. 簽證會計師與本公司無重大密切之商業關係。	√	
5. 簽證會計師與本公司無潛在之僱傭關係。	√	
6. 簽證會計師無收取與查核案件有關之或有公費。	√	
7. 簽證會計師及審計服務小組成員目前或最近兩年內無擔任本公司之董事、經理人或對審計工作有直接且重大影響之職務。	√	
8. 簽證會計師及審計服務小組成員與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員無親屬關係。	√	
9. 簽證會計師及審計服務小組成員無收受本公司或董事、經理人價值重大之餽贈或禮物。	√	
10. 簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目。	√	
11. 簽證會計師無宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券。	√	

說明三：113 年度本公司董事及經理人進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	蔡篤恭	113.6.5	社團法人中華公司治理協會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析	3
		113.7.3	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	呂肇祥	113.6.5	社團法人中華公司治理協會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析	3
		113.7.3	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
董事	謝永達	113.6.5	社團法人中華公司治理協會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析	3
		113.7.3	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113.9.30	臺灣證券交易所	壯大臺灣資本市場高峰會	3
董事	淺田順一	113.11.15	社團法人台灣投資人關係協會	日本企業投資台灣應注意的法律及稅務問題	3
獨立董事	張光瑤	113.7.3	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113.9.20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
獨立董事	李培瑛	113.11.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	AI 時代，企業成長創新思維	3
		113.11.14	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業 ESG 永續治理認知與內涵-全球淨零碳排趨勢與企業因應之道	3
獨立董事	陳瑞聰	113.3.16	台北市進出口商業同業公會	展望 2024 全球政治、經濟、金融趨勢與台灣企業因應之道	3
		113.3.16	中華獨立董事協會	淺談高科技製造業之兩大風險：地緣衝突下的出口貿易管制與供應鏈採購舞弊	3
獨立董事	童兆勤	113.8.14	社團法人中華公司治理協會	智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用	3
		113.12.17	財團法人海峽兩岸商務發展基金會	能源技術服務(ESCO)的現在與未來	3
前財務長暨會計主管暨公司治理主管	曾炫章(註 1)	113.6.5	財團法人中華公司治理協會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析	3
		113.7.19	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析	6
		113.8.20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導允當揭露三部曲	3
		113.8.23	財團法人中華民國會計研究發展基金會	發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班專業研習課程	12

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
經理人	林基正	113.06.05	社團法人中華公司治理協會	公司經營權之競爭行為規範與實務案例解析	3
		113.07.03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113.10.07	社團法人中華民國工商協進會	2024 台新淨零高峰論壇	3

註 1：前財務長暨會計主管暨公司治理主管曾炫章先生於 113 年 11 月 8 日退休，其進修情形揭露至退休日止；財務長暨公司治理主管職務由沈俊宏先生接任，會計主管職務由紅立勝先生接任，依法規應於就任起一年內完成進修時數。

說明四：本公司於 110 年 5 月 7 日經董事會通過設置「風險管理委員會」，旨在健全董事會之監督功能及強化管理機制，其職權包括：

1. 審查公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制。
2. 執行董事會風險管理決策。
3. 監督風險管理機制運作。
4. 審查並整合各風險管控報告，適時向董事會報告。

風險管理委員會成員及出席情形如下：

職稱	姓名	主要專長	113 年度出席率
董事	呂肇祥	註 1	100%
獨立董事	張光瑤	註 1	100%
獨立董事	童兆勤	註 1	100%

註 1：請參閱第 7~11 頁董事資料相關內容。

113 年度風險管理委員會之運作情形如下：

風險管理委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對風險管理委員會意見之處理
第二屆 第 1 次 (113.5.10)	1.報告本公司 112 年度風險管理業務執行情形。 2.報告本公司 113 年度風險管理業務預計執行計畫。	全體出席委員 無異議通過	提董事會由全體 出席董事同意通過

(四)公司如有設置薪酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

(1)薪資報酬委員會成員資料

114 年 3 月 31 日

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事 召集人	張光瑤	註 1	註 1	無
獨立董事	李培瑛	註 1	註 1	無
獨立董事	童兆勤	註 1	註 1	無

註 1：請參閱第 7~11 頁董事資料相關內容。

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

二、本屆委員任期：第五屆委員任期為 112 年 6 月 8 日至 115 年 5 月 31 日。

113 年度薪資報酬委員會開會 2 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B / A)	備註
召集人	張光瑤	2	0	100%	-
委員	李培瑛	2	0	100%	-
委員	童兆勤	2	0	100%	-

應記載事項：

- 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：

薪酬委員會	議案內容及後續處理	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第 5 屆 第 2 次 (113.3.8)	1. 審查本公司 112 年度董事酬勞及員工酬勞分配案。 2. 審查本公司 113 年經理人薪資調整方案。	全體出席 委員無異 議通過	全體出席董事 同意通過
第 5 屆 第 3 次 (113.11.8)	1. 本公司 112 年度董事酬勞分配執行說明 2. 本公司 112 年度董事酬金與業界比較說明。 3. 本公司 112 年度經理人員工酬勞分配執行說明 4. 本公司 112 年度經理人酬金與業界比較說明。 5. 審查新委任經理人薪酬案。	全體出席 委員無異 議通過	全體出席董事 同意通過

3. 定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構等資訊：

(1) 113 年度檢討與評估本公司薪資報酬資訊如上表所示。

(2) 薪酬委員會以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

A. 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

B. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

C. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

(3) 本公司薪酬委員會履行職權時，依下列原則為之：

A. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

B. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

C. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

D. 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

E. 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離。

F. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		1. 本公司為健全企業永續發展之管理，103年8月1日設置「企業社會責任室」為專職單位，並於104年2月9日經董事會通過，隸屬於董事會，該組織於111年3月更名為「永續發展管理室」，負責企業永續發展政策、制度、相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每季召開「永續發展委員會」向高階主管說明執行情況，以及每年定期向董事會提報，相關內容已於113年8月9日第十屆第8次之董事會中討論並通過。 2. 為確保企業永續發展，本公司董事會於110年5月通過於其轄下設置「風險管理委員會」，由獨立董事2人及董事1人所組成，每年至少召開一次會議，職責為協助審查風險管理政策、方針、風險承受度及督導各項風險管理制度之執行，落實企業永續發展。為順利運作相關業務，於風險管理委員會下另設立『風險管理推動小組』，採任務編組方式，由總經理擔任組長、指定一名副組長、公司治理主管擔任執行秘書、組員包括各部門一級主管若干名，每季召開會議討論風險議題，並每年定期將相關內容提報於風險管理委員會中討論，落實風險管理的有效性。	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		1. 本公司秉持嚴謹的風險管理來確保公司的正常運作，正視風險的存在，設置有「風險管理委員會」隸屬於董事會之下，執行風險監控並每年定期向董事會報告，以積極的態度轉化風險為機會，定期透過風險的監控、辨識、衝擊評估與擬訂因應對策來降低風險。 2. 113年依重大性原則及營運持續管理目標，鑑別出與公司營運相關之環境、社會與公司治理議題之風險有環境類：「公共服務中斷」、「環境及氣候變遷」；治理類風險：「區域衝突」、「IT資通訊」、「供應鏈管理」、「法規變動」等六項議題，彙報於董事會，並且針對各種不同風險項目規劃專人專責之管理方法與危機因應步驟，建立起預警、應變、危機管理、營運持續計畫，以及復原行動等營運永續防護網，為利害關係人創造永續價值而努力；相關風險內容亦會於董事會中報告與說明。	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		(一)為善盡環境保護及照顧員工安全健康之企業責任，本公司依所屬產業特性建立相關之環境管理制度，分別於92年通過ISO 14001環境管理系統、93年通過OHSAS 18001(現已改為ISO 45001)職業安全衛生管理系統；響應全球節能減碳及綠色環境，力成科技自2018年開始進行ISO50001能源管理系統的建置與導入，並據以實施環境暨安全衛生管理措施，訂定環境安全永續目標及定期檢討之。本公司於108年12月通過SGS台灣檢驗認證取得證書，最新有效期間為111年12月04日至114年12月04日。藉由國際標準管理系統的運作，有效落實廠內生產過程中所衍生之空污、水污及廢棄物等管控；除此之外，於97年通過IECQ QC 080000有害物質管理系統驗證，以確保公司的產品不含危害人體及環境重大衝擊之物質、無有害材料，符合國際法令規章及客戶要求，降低產品對環境之衝擊。	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		(二)請參考本表下方說明一。	
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		面對氣候變遷對營運可能產生的衝擊，本公司積極面對並承諾持續減少溫室氣體、廢棄物、廢水排放，積極投入能源效率最佳化之規劃與配置，研究低碳或節能之製程、服務開發，並根據氣候相關財務揭露建議書(TCFD)架構執行氣候相關風險與機會鑑別，跨組織評估氣候變遷風險與因應措施，鑑別之結果提供經營團隊於營運決策之考量，將危機轉化為轉機，並且同步將此正向影響力推動到供應商，建構因應氣候變遷的韌實力，113年力成科技TCFD鑑別結果如下： 1. 風險因子：再生能源使用要求上升、極端氣候影響(如颱風、水災)。 2. 機會效益：開發創新低碳產品或服務、使用低碳能源。 3. 因應作為：依據TCFD的框架，透過治理、策略、風險管理、指標和目標等四項核心要素，進行氣候風險與機會鑑別，並根據鑑別結果制定因應措施、營運持續計劃等，藉以降低氣候風險的衝擊，並掌握氣候機會帶來的效益，強化營運體質與韌性。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			有關本公司的氣候風險與機會分析與說明，登載於本公司永續報告書與年度「氣候相關財務與機會」主題報告，並揭露於公司官網。	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		(四)請參考本表下方說明二。	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)本公司依循「責任商業聯盟(RBA)行為準則」、「SA8000 社會責任國際標準」、「聯合國工商企業與人權指導原則(UNGPs)」及國際勞工組織各號公約(ILO Conventions)等國際準則與規範，落實人權的保障。 1. 制定人權政策，落實多元、平等、共融(DEI)的友善職場。 2. 「責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)」致力於保障全球行業供應鏈的從業人員及社區的權利與福祉，而「責任商業聯盟行為準則(RBA Code of Conduct)」則是符合「聯合國企業與人權指導原則」、「國際勞工組織之「工作基本原則與權利宣言」與「世界人權宣言」等關鍵性國際人權標準，是一套有關全球行業供應鏈在人權、健康與安全、環境與道德等範疇的行為規範。本公司於 98 年導入「責任商業聯盟行為準則」，並於 104 年 4 月 20 日正式加入「責任商業聯盟(RBA)」，成為其會員，遵循至今。 3. 社會責任國際標準(Social Accountability 8000 International standard, SA8000)，是一種基於國際勞工組織公約(ILO)、聯合國兒童權利公約、世界人權宣言而制定的準則，用以保護勞工人權、職場環境安全和勞動條件等為主要內容的管理標準，本公司亦積極導入 SA8000 社會責任管理系統，已於 105 年取得 SA8000 證書，並通過每半年度執行的追蹤稽核。 4. 本公司每年度執行人權風險評估及盡職調查作業，監控、減緩人權風險，出具「人權盡職調查報告(HRDD)」並揭露於公司官網。 5. 每年度執行全體員工之勞工人權及 RBA、SA8000 社會責任標準相關培訓課程，持續提升人員對人權保障的意識。	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			6. 本公司承諾提供員工安全健康及得以充分發揮才能的工作環境，為落實該項承諾，我們遵守當地法規，並根據上述國際勞工及人權標準，制定相關之管理政策與程序。	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		(二)請參考本表下方說明三。	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		(三)請參考本表下方說明四。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(四)本公司透過教育訓練體系的規劃，促進經營理念與訓練投入的一致性，展開各項訓練機制交互運作，提供員工全面性的訓練與職涯發展藍圖，針對不同職級、職務進行不同的訓練，確保人才培育與職能發展符合公司營運成長所需。 有關本公司人才發展相關說明，揭露於本公司永續報告書及公司官網。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		(五)依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，公司就研發、採購、生產、作業及服務流程制定相關政策，如：防範產品或服務損害利害關係人、禁止洩露機密資訊、禁止侵害智慧財產權、禁止從事不公平競爭之行為等政策。有關本公司智慧財產之管理，請參考本表下方說明五。 本公司已建立相關檢舉申訴程序，檢舉申訴管道除公司內部公告外，亦揭露於公司網頁，以確保內、外部利害關係人之權益。	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)本公司將供應商／承攬商視為合作夥伴，致力於共同建立穩定發展及永續經營的供應鏈管理。 1. 依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司與供應商建立商業關係前，須先行評估商業往來交易對象，採行適當查核程序，檢視商業往來對象，以瞭解過去有無影響環境與社會之紀錄。 2. 要求供應商遵循RBA行為準則，並制定有勞工人權、環境保護及商業道德等供應商行為準則；其中，商業道德包含誠信廉潔守則、誠信經營及從業道德、反競爭及反賄賂政策等。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			3. 持續性的針對品質、交期、成本、技術及社會責任合規度等，制定供應鏈管理目標與評比項目，並每年按年度計劃進行拜訪與營運系統的現場稽核，其稽核系統包括有： ◆ 品質管理系統 ◆ 原物料有害物質禁用的綠色產品管理系統 ◆ 勞工人權、環境、道德等之RBA行為準則管理系統 ◆ 環境安全衛生風險管理 ◆ 營運持續管理 有關本公司供應鏈管理之具體作法，請參考本表下方說明六。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司每年度定期發行永續報告書，113年永續報告書依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI)所出版的GRI準則、氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構、永續會計準則委員會(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)之SASB準則(半導體業)、自然相關財務揭露(Task Force on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)架構等進行編製、撰寫，並通過獨立第三方公正單位英國標準協會(BSI)依據GRI準則、AA1000 AS Type II高度保證、SASB 準則Type I中度保證等級進行查證。針對「非擔任主管職務之全時員工薪資」資訊，則委由勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte)查核確認，取得查證及薪資查核等證明。	與上市上櫃公司永續發展實務守則相符。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司參酌『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』及相關法令制定「企業社會責任實務守則」，於102年11月8日經董事會決議通過實施，因應臺灣證券交易所於110年12月7日公告將『上市上櫃公司企業社會責任實務守則』修訂為『上市上櫃公司企業永續發展實務守則』，本公司於111年3月10日經董事會決議通過第三次修訂，並更名為「企業永續發展實務守則」，以提升履行企業永續發展成效，落實推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊之揭露，其運作與所訂守則並無差異情形。本守則適用於本公司及其轄下各子公司之整體營運活動。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 請參考本表下方說明七。				

說明：一、本公司為提升各項資源、能源之使用效率並降低生產活動對於環境所造成之衝擊，制定相關管理措施。

1. 建立能源、資源績效管理目標

針對可回收之能源、資源建立績效管理目標，並定期檢視執行成果；此外，在不影響產品品質之前提下，評估並提倡使用對環境負荷衝擊低之再生物料。為了落實環境保護及因應現今氣候變遷與水資源枯竭的狀況，我們持續關注能源、資源使用密集度，並增加廢棄物回收成果、節電成果及提高製程回收水比例來取代自來水使用需求。

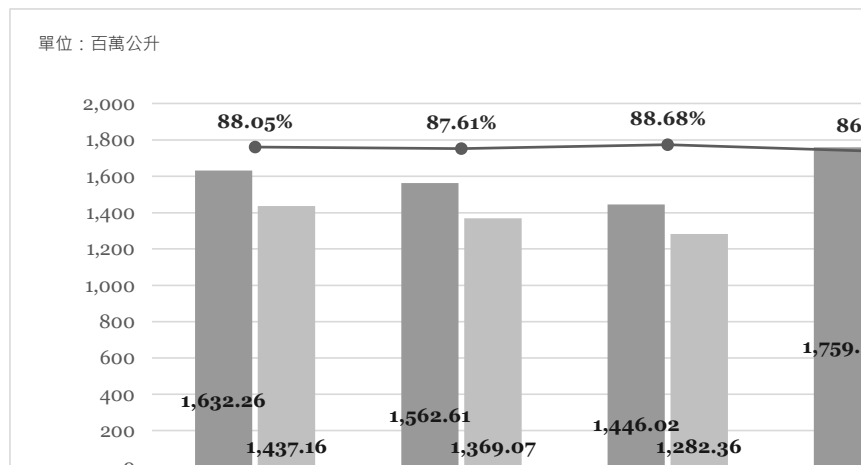
(1) 最近二年能源、資源密集度及使用情況

項目	2023年	2024年	上升/下降比例
電力密集度 用電量(kWh)／個體營收(新台幣仟元)	15.84	15.05	下降 4.99%
用水密集度 用水量(公噸)／個體營收(新台幣佰萬元)	65.77	63.78	下降 3.03%
廢棄物密集度 廢棄物量(公噸)／個體營收(新台幣佰萬元)	0.15	0.15	-

項目	2022年	2023年	2024年
廢棄物回收總重量(公噸)	1,051.53	4,728.26	5,707.24
節省電力消耗量(kWh)	11,435,224	17,240,951	14,459,016
廢水回收處理量(公噸)	1,369,070	1,282,359	1,528,497

註：廢棄物回收項目擴大，包含資源回收、循環再利用、能源回收等。

(2) 2024 年力成科技之切割研磨製程回收水使用比例為 86.89%。



- 註：1. 具有切割／研磨製程回收水系統廠區為湖口廠（2 廠）、大同廠（3A 廠）、大同廠（3C 廠）、竹科一廠（8 廠）、竹科三廠（11 廠 B）
 2. 比例（%）=[回收水量（m3）／回收設備進水量（m3）]*100%
 3. 2024 年切割研磨製程回收水系統回收率目標值為 85%

2.再生能源使用目標

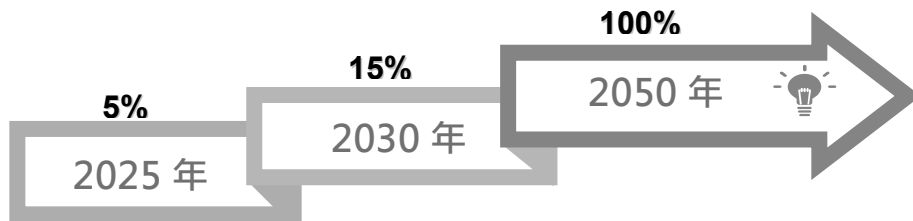
力成科技支持氣候變遷倡議，積極落實減碳措施，2021 年啟動再生能源設置專案，擬訂施行計畫：

(1) 啟動再生能源建置專案

- ◆ 2022 年於廠區屋頂架設太陽能發電設備，2023 年初完成掛錶作業，2024 年總發電量為 3,520,460 kWh。
- ◆ 向再生能源發電業者購置綠電，並於 2023 年起進行綠電轉供。
2023 年可提供 854 萬度的再生能源使用(比例超過 1%)，可減少因電力使用而產生之碳排放量；並提前兩年達成政府針對用電大戶須於 2025 年前使用 10% 契約容量再生能源的要求。

(2) 中、長期規劃之目標：接軌國際，落實淨零

- ◆ 2025 年再生能源比例達 5%；2030 年再生能源比例達 15%
- ◆ 接軌 RE100 倡議，2050 年達 100% 再生能源



二、本公司善盡企業社會責任，透過內部管理系統運作及多項污染防制設施，推動節能減碳、溫室氣體盤查與減量、減少用水及廢棄物等管理措施，以維護永續環境之目的。近兩年統計內容說明如下：

1.溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量

(1)溫室氣體排放量

自2007年起，即每年自發性的實施溫室氣體盤查，並將盤查結果作為減量依據。本公司2024年之溫室氣體排放量統計為各主要生產據點依據實際盤查並經第三方公正單位(SGS)查證通過之數據(註)，直接溫室氣體排放(範疇一)約佔總排放量之3.77%；間接溫室氣體排放(範疇二)主要為電力耗用，約佔總排放量之96.23%，故本公司具體的溫室氣體減量策略著重於用電管理及以減少用電量為核心之方針執行。近兩年溫室氣體排放量如下表所示：

(範疇一、二、三資訊涵蓋力成科技所有廠區)

溫室氣體排放量 (單位: ton CO ₂ e/year)		
項目	2023年	2024年
範疇一	14,381.30	7,407.29
範疇二	328,260.29	339,416.98
範疇三	314,328.84	263,504.04
總排放量	656,970.43	610,328.31

註1：2024年溫室氣體盤查數據為自盤結果，預計於2025年4月底前完成第三方驗證。

註2：範疇三詳細內容請見2024年永續報告書「7.1.3碳管理」章節。

(2)用水量

(資訊涵蓋力成科技所有廠區，預計於2025年7月底前完成第三方驗證)

鑒於近年來氣候變遷造成水環境急遽變化，旱澇發生交替愈趨頻繁，且利害關係人對於水資源議題日益關切，為及早因應複雜之水資源問題，力成依據減量、再利用與回收三項策略進行水資源管理，提高使用效能，並持續推動各廠區節水措施。近兩年用水量如下表所示：

項目	112年	113年	比例
總自來水用量(公噸)	2,734,971	2,982,264	上升9.0%
地下水用量(公噸)	45,573	35,262	下降22.6%

(3)廢棄物總重量

113年力成產出7,032.20公噸廢棄物，均委由合格清理廠商進行妥善之處理，其中有害廢棄物產出量2,265.16公噸，主要為清洗晶圓過程產生的廢液；非有害廢棄物產出量4,767.04公噸，主要為廢水處理過程中產生的污泥。力成透過回收再利用等措施，非有害廢棄物回收量(含能源回收)計4,562.25公噸，使113年非有害廢棄物回收率(含能源回收)達95.7%，並且透過廠內落實資源分類與循環經濟，將資源循環再利用，降低對環境之衝擊。

2.制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策

為了落實發展環境永續，本公司亦於「企業永續發展實務守則」中明白制定公司節能減碳及溫室氣體減量之策略，以及將綠電、再生能源憑證等取得納入公司之減碳措施規畫中，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。為因應氣候變遷影響，本公司擬定年度目標，用具體數據管理環境保護之成效，包括有：

(1) 113年度環境永續管理成效

- A. 非有害廢棄物回收率(含能源回收)達95.7%。
- B. 切割研磨製程回收水系統效益達86.89%。
- C. 節電14,182,415 kWh，減少7,006.11公噸二氧化碳當量的排放，且達成目標1%的節電量。
- D. 達成減碳1%的目標；溫室氣體減量目標從109年起至119年，減量達15%。
- E. 積極針對廠務、製程等二大類設施執行共159項節能減碳措施。
- F. CDP氣候變遷成績：獲評113年CDP氣候變遷成績獲評B，為管理等級。
- G. 水揭露(Water Questionnaire, WQ)成績：113年水揭露(Water Questionnaire, WQ)成績獲評B，為管理(Management)等級。
- H. 為因應氣候變遷對於企業營運的衝擊與具體呈現氣候變遷的資訊揭露，113年本公司依據TCFD管理機制，針對氣候變遷進行業務盤點和風險辨識，包含因極端氣候造成直接或間接之衝擊、因法規、技術或市場需求的轉型影響，以及其他人文、社會面向對公司營運活動造成之風險與機會進行分析，並出具TCFD主題報告及揭露於公司官網。
- I. 減廢和回收再利用：
 - a. 廢液純化回收
113年黃光製程產出之廢液共計681.44公噸，於廠內分流收集後委由合作廠商以蒸餾方式將主要回收物質純化，再製成工業用次級品，可作為油漆或表面塗料稀釋劑使用。
 - b. 廢液貴金屬回收
113年電鍍及蝕刻製程產出之貴金屬廢液共計168.56公噸，於廠內分流收集後委由合作廠商以萃取、氧化還原等方式，將廢液中之貴金屬析出成貴金屬錠或貴金屬片，提供金屬冶煉及製品製造使用；也可再製成工業用藥劑次級品(硫酸銅晶體、氫氧化錫或氫氧化鎳等)提供化學工業及基本金屬製造業使用。
 - c. 化學空桶循環使用
112年起化學品供應商實施空桶循環使用，化學品原物料使用後之空桶由原供應商回收重新填裝原物料送回力成重複使用。113年新增至7間化學品供應商採用容器循環使用模式，共計供應力成科技769.6公噸化學藥液，回收約3,848個200L Drum桶，容器回收率100%，減少產出44.3公噸廢棄空桶，可減少5,443.00公斤二氧化碳當量排放。

d. 廢靜電袋再利用

漸進式調整廢靜電袋處理流向，從 111 年焚化處理為唯一流向，於 112 年簽訂物理處理機構，當年度委託量占產出量之比例 30%，113 年新增再利用流向，並降低焚化、物理處理委託量，產出量約 84% 係委託再利用機構，經再利用產出鋁條及複合材質塑膠粒之再利用產品。除了創造廢靜電袋的循環經濟價值外，亦具廢棄物處理範疇的減碳效益，113 年較 112 年減碳約 9,790.1 公斤二氧化碳當量。

J. 清潔生產評估系統評定：

力成科技致力於營運過程中持續降低對環境之衝擊，耕耘綠色製造技術多年，包含原料減量/循環利用、環境友善的製程設計、去碳化/去毒化的創新作為，於 113 年以大同廠為代表，向經濟部產業發展署申請清潔生產評估系統符合性判定，成果順利通過並取得合格證書。將陸續推動全廠區取得通過清潔生產系統評定。

(2) 環境管理計劃

為善盡企業社會責任，透過污染防制設施妥善操作，以維護永續環境，長期執行下列環境管理計劃與措施：

- A. 廢氣處理：設置空氣污染防制設備處理 VOCs，每年依法規之要求定期檢測，並配合環保局委託之檢測公司，對空氣污染防制設備排放管道之處理效率進行抽測，其檢測結果皆符合法規要求。
- B. 製程用水回收：運用廢水回收設備，減少水資源消耗，用製程回收水來取代自來水之使用需求，以達節約用水及保護水資源之目的。
- C. 廢棄物清理：生產過程產生之廢棄物清理，皆依法妥善處理，並在產生廢棄物源頭確實做好分類收集以提高廢棄物之可回收性。對於製程廢棄物之處理模式為收集、分類、減量及回收，主要管理策略是以「資源回收」來取代「掩埋處置」，讓廢棄物變為可用資源，降低對環境的衝擊，並有效管理以提高資源再利用的價值。
- D. 協力廠商稽核與輔導：定期稽核具環境污染風險之供應商與外包商，輔導協力廠商落實環境保護工作，共同履行企業社會責任及達成永續供應鏈之目標。
- E. 節能減碳：啟動再生能源建置專案，使用再生能源；成立跨部門節能組織，執行節能專案，降低能源消耗與溫室氣體排放量；並揭露碳排放資訊，以符合國際環保趨勢，為防止氣候暖化善盡企業責任。
- F. 自主環境監測：規劃涵蓋廢水水質、噪音音量、空氣品質、廢棄物性質等各類環境自主監測計劃，以有效掌控企業活動對環境品質造成之影響與衝擊。
- G. 環境許可變更：配合企業活動變化，適時提出各項環境許可之變更，使企業活動與污染排放均能符合環境法令之規範。

(3) 設置環境保護專責單位

本公司設有工安環保部門，專職負責工安環保事務之管理與推行，以及監督各項污染防制設施之正常運作。此外，亦設有「工安環保委員會」，由高階主管、各廠廠長及勞工代表們參與會議，透過定期召開會議並研議公司安全衛生與環境保護之議案，讓環境永續議題融入經營管理中。

(4) 制定「環境安全衛生政策」

為厚植人員安全及環境保護觀念於企業營運及每一位人員的意識中，制定有「環境安全衛生政策」，將環境與安全衛生政策落實於員工、客戶、承攬商及相關利害團體上，具體政策有：

- A. 將環境與安全衛生政策傳達予員工、客戶及相關團體。
- B. 符合環境保護、安全衛生相關法令規章及客戶之要求。
- C. 工作者及其代表諮商及參與防止傷害、疾病、事故預防及損失控制。
- D. 順應國際環境保護趨勢及組織處境，積極推動節能減廢活動。
- E. 持續檢討與改進，提高安全衛生、環境管理目標及整體績效。

三、為符合公司的長期營運發展，同時兼顧員工生活水準，每年透過市場薪資調查，檢視公司薪酬條件與市場薪酬水準，並參考總體經濟指標、物價指數，針對員工薪資作出適切的調整，優化薪酬競爭力吸引優秀人才加入，以達互惠雙贏的效果。且遵守相關的勞動法令，以優於當地基本工資之薪資待遇聘僱員工。我們亦以全面性及優於法令之角度設計完善的福利制度回饋給每位同仁。

1. 力成科技的獎酬與福利項目如下，113 年福利補助達到新台幣 297,991,589 元。

類別	內 容
獎金	• 年終獎金：共兩次，分別於國曆七月與國曆一月發放 • 季獎金：依據獲利狀況、是否達成公司設定之目標 • 員工酬勞/激勵獎金：依據獲利狀況、參考個人工作職責/貢獻度與績效評核 • 調薪制度：每年更新調薪數據
福利	• 年節賀禮（新年、勞動節、端午及中秋） • 免費團保（眷屬享壽險、意外險、醫療險及癌症險等） • 定期免費健檢 • 福利補助（結婚、生育、住院及喪儀禮金等） • 旅遊補助 • 餐費補助 • 生日賀禮 • 電影欣賞 • 社團活動 • 公司活動（視年度規劃舉辦線上/線下活動） • 特約商店（超過 800 家特約商店提供的折扣） • 托兒措施（與員工居住區域之優良幼兒園、托兒機構簽訂特約優惠合約做為托兒措施，提供員工於安排子女學前教育或安親的照料時，有多元的機構可選擇）

2. 113 年啟動「員工持股信託」並納入員工福利計畫，旨在藉此強化員工與公司之間的關係，進而激勵員工與公司共同努力，持續創造更好績效。員工每月可自願提存一部分薪資，公司將相對提撥具有獎勵性質的公提金，透過信託機制，委託專業受託銀行協助管理和運用信託資金，鼓勵同仁進行長期、定期定額投資並持有公司股票。

3. 職場多元化與平等

- ◆ 本公司保障女性與男性皆擁有相同的工作權。統計至 113 年底，男性員工佔員工總數的 49.93%，女性員工佔員工總數的 50.07%，男、女性員工比例幾乎相當，顯示了女性工作者在力成科技具有公平、客觀的工作保障與成長空間。
- ◆ 薪酬設計及核定依據員工之學經歷背景、專業知識技術、年資經驗、職務類別及個人績效表現，採用公平公正之作業程序，同工同酬對待全體同仁，依職務類別而非以性別敘薪，錄用後則視其工作表現逐年調薪及晉升，給予相對應之薪酬，不因其性別、種族、宗教、政治立場、婚姻狀況或工會社團等而有所不同，公司薪酬制度均符合勞動相關法規的規定。本公司積極實現多元職場，支持女性員工的成長與職涯發展。於 113 年 4 月 1 日年度晉升中，女性員工晉升佔比 39.9%。

四、本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，致力於提供一個安全 and 健康之工作場所。工作環境與員工人身安全保護措施如下：

1. 訂定「環境安全衛生政策」

為達預防職傷事故並維護安全 and 健康之工作場所目標，訂定「環境安全衛生政策」。

2. 依循安全衛生管理系統管控
以 ISO 14001 及 ISO 45001 之管理系統展開與管控。
3. 作業環境測定
本公司每半年實施一次作業環境測定來瞭解工作環境危害暴露的實際情況，經由採取之規劃、採樣、監測與分析之過程，若測量結果顯示有異常的測定值，將針對異常區域實施監測並著手進行改善。
4. 個人防護管理
為維護員工的安全和健康，減少於操作過程中接觸有害因子，本公司建立了個人防護具管理作業規範，並要求員工在進行危害性作業操作時穿戴適當的個人防護具。
5. 健康關懷與照顧
本公司提供完善的員工照顧與健康關懷機制，照顧每位同仁的身心健康，包含全方位的溝通管道、設置心理諮商機制、與專業醫療機構合作進行定期健康檢查、提供醫療諮詢服務、職場不法侵害/暴力防制、重視母性同仁健康保護及對於同仁因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，並適時對員工宣導疾病預防等，用以照護員工之身心健康。
6. 實施教育訓練
為提高員工對環境與安全衛生之意識，除了新進人員的教育訓練外，本公司每年規劃各種教育訓練課程，如廢棄物儲存分類規定、溫室氣體排放盤查、危害鑑別、風險評估暨環境考量面、個人防護具管理實務、自動檢查方式、緊急應變及健康講座等，持續強化員工意識與技能。
7. 健康促進與管理
113 年辦理了多場的健康促進活動包括：流感疫苗施打、捐血、視力保健活動等，臨場醫師服務次數達 262 次。
8. 職業傷害管理
113 年本公司同仁無發生職業病之災害，受傷失能件數共 20 件。分析其傷害類型主要為「跌倒」居多，佔傷害類型 35%，為減少這類型傷害，避免重覆發生類似職業傷害，持續透過主管巡視或例行巡檢發現所屬部門中人員作業通道暢通性，此外人員於工程作業進行時應將現場進行圍籬管制，避免非相關人員進入作業區。透過宣導行走或搬運物品時注意步伐穩定及路面狀況，且避免穿著的鞋子有明顯磨耗或破損等措施，以減少因滑倒、絆倒而發生職業傷害發生情形。
9. 工安巡檢
為使安全衛生人員對於廠區及周遭之作業環境，能以管理系統中矯正預防做法，及早發現問題點預防事故發生，並配合由現場作業主管自主巡檢或聯合巡檢，故建立完善之巡檢制度。將巡檢缺失結果及改善率進行部門與類型統計分析，提報於每月工安月會及每季職業安全衛生委員會進行檢討審視。

項次	巡檢人員/內容	頻率
1	工安人員作業場所巡視	每日至少一次
2	工安人員作業環境安全巡檢	每週一次以上
3	工安人員作業環境專案巡檢	每月一次以上
4	工安人員主題式巡檢 (因應法規變更、事故、內外部稽核等)	不定期
5	工安績效管理交叉稽核	每季一次
6	生產製造工安現場巡檢	每週至少一次
7	現場主管走動管理	不定期
8	現場廠/處長級主管自主聯合巡檢	每月一次

10. 本公司 113 年度無發生火災之情形。

五、本公司智慧財產管理之專責單位為智財管理部，相關之計劃及管理內容如下，已於 113 年第四季之董事會中報告計畫及執行狀況。

1、智慧財產策略

確保公司營運自由及擴大競爭優勢，強化智慧財產布局，持續提升智財品質並將技術、產品與智財結合，創造產業價值及提升營收；制訂與營運目標及研發策略連結之智慧財產管理計畫，深化關鍵技術，保護研發成果，並提升同仁智慧財產保護意識；同時，持續優化智財管理系統與智財權管理，確保技術領先地位並降低營運風險，落實公司治理法規遵循，實現永續經營。

2、智慧財產管理制度。

制定智慧財產的取得、保護、評估、維護等相關規範，並由智財部門負責專利及商標管理事務；訂定專利商標申請管理規範與獎勵措施，鼓勵研發同仁積極將研發成果轉成專利提案，經由內部審查機制及專利提案審查系統，提升研發同仁的提案審查效率；專利委員對於提案技術、實務應用及市場發展趨勢，全方位地審核提案價值，彈性調整專利佈局，發揮專利保護之最大效用。從初期的前案檢索、界定保護範圍、確認申請方向，乃至到後期的分析審查意見、擬定答辯策略、維護權利等，智財部門均高度掌握進度及確保執行品質，爭取較大的權利範圍。此外，建立智慧財產權管理清單，定期盤點及維護。

力成自 109 年導入台灣智慧財產管理制度(TIPS)並通過首次驗證，於 110 年通過 TIPS 再驗證，於 111 年通過 TIPS 抽驗程序，並於 112 年持續提出 TIPS 再驗證申請並通過獲證，建立系統化的智慧財產管理制度並持續優化。證書有效期間至 114 年 12 月 31 日。

3、可能遭遇之智慧財產風險及因應措施

(1) 落實法規遵循：

參照公司治理評鑑指標之智財項目，建立智慧財產管理制度，將智財管理連結營運策略；透過觀察內外部風險與機會採取因應措施，制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫，並於董事會報告計畫及執行狀況。積極落實法規遵循，致力於提升公司治理評鑑排名，獲取股東與客戶的信任。

(2) 落實智慧財產管理：

建立專利與商標管理清單並定期盤點，制定營業秘密保護相關規範及對應的資訊安全設備與環境，依職責範圍不同，分層分級設定權限管控與門禁管理；強化資訊安全及機密資訊之保護，導入手機鏡頭監控軟體，搭配定位系統並結合識別證門禁卡管理之整合方案，同仁於入廠後，手機鏡頭及相機功能均無法開啟。避免智慧財產相關之整體權益管控不足之風險，執行智財稽核、落實智慧財產文件化及標準化之管理，確保公司及客戶權益不受損害。此外，新進同仁於入職後，立即安排營業秘密保護及資訊安全保護相關教育訓練，且每年辦理全體同仁智財相關訓練課程，並將實際案例納入教材中，建立與深化智財保護意識。

(3) 保護運用研發成果：

為持續保持技術優勢，因應未來封測產業多元化及高技術化趨勢，已研發出先進技術及建立穩定客戶來源，但仍有競爭者發展類似產品之風險，將持續進行智財布局，避免智財爭議並增加防禦，以完善的智財管理制度來保護及運用研發成果。

4、未來規劃

將 ESG 元素注入產品研發與製造過程，讓先進封裝技術與製程兼具環境保護效益，邁向智慧製造與綠色生產。持續強化智慧財產管理制度與系統，建置更完善的智財管理，確保研發成果轉為智慧財產權，並獲得有效保護；持續落實研發管理、人員管理及機密資訊管理等措施，同步與產業趨勢及公司營運目標接軌，累積專利、商標、營業秘密等智慧資產權，提升公司競爭優勢並增強防禦與應變力。

5、截至 113 年 12 月 31 日止，本公司取得智慧財產之成果如下：

智慧財產	■ 發明專利	國內	申請：28 件	核准：282 件	國外	申請：54 件	核准：195 件
	■ 新型專利	國內	申請：0 件	核准：5 件	國外	申請：0 件	核准：3 件
	■ 商標	國內	申請：0 件	核准：18 件	國外	申請：0 件	核准：21 件
	■ 著作權	國外：2 件		■ 營業秘密	如營業秘密清單		

六、本公司供應鏈管理具體作法如下：

本公司建構全面的供應商篩選及監控管理準則，以落實供應鏈發展，並促進雙贏的永續績效。

1. 供應鏈管理目標

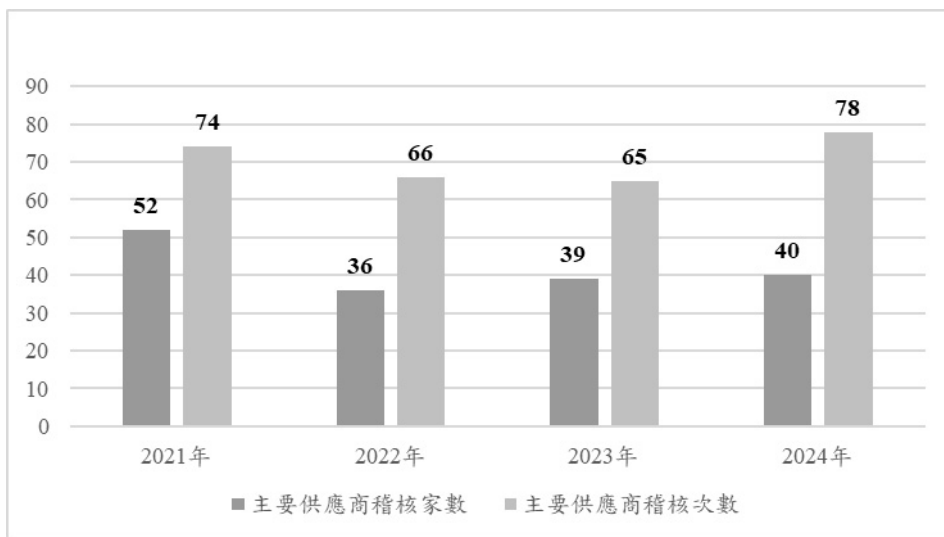
No.	內容	目標	113 年達成狀況
1	新供應商完成賄賂風險暨盡職調查評鑑	100% 完成	達成
2	供應商社會責任風險	無違反人權之重大風險 供應商	達成
3	衝突礦產調查作業供應商合格率	100% 非衝突礦產廠商	達成
4	舉辦「供應商社會責任宣導會」 供應商參加率	>85%	達成

2. 供應商篩選與監控

篩選與 監控措施	內容說明
新供應商評鑑	- 針對新供應商執行評鑑，包括書面評鑑、工廠評鑑、樣品評鑑 - 候選供應商須簽署「誠信從事商業行為承諾書」、遵守 RBA 行為準則 - 完成供應商賄賂風險暨盡職調查程序，落實社會責任及反賄賂、反貪腐 - 符合力成科技評鑑要求者，方可成為合格供應商
供應商評比	- 針對主要原物料供應商進行每季／每半年評比，評比項目包括品質、交期、成本及技術等面向 - 供應商評比分數未達標準，要求限期改善，並附上相關佐證資料或安排現場稽核 113 年原物料供應商評比結果，皆達合格供應商分數之標準
供應商稽核	- 針對主要原物料供應商依計畫進行年度稽核，項目包括品質系統、綠色產品系統、環境安全衛生系統、RBA 社會責任管理（含人權、道德）等四大面向 - 發現缺失，即要求供應商提出合適的改善方案，給予明確的目標和改善時間，未改善者則影響採購下單或取消供應商資格
供應商輔導與訓練	- 定期辦理現場輔導與 RBA 行為準則、人權等相關訓練，協助供應商共同成長 - 每年舉辦「供應商社會責任宣導會」，宣導品質政策、無有害物質、環境保護、誠信道德及社會責任管理理念 - 直接材料供應商須取得國際驗證，例如 ISO 9001 等品質管理系統，未取得者需提供導入計畫

3. 供應商稽核與發展

本公司篩選出主要原物料供應商，依據品質狀況或製程要求納入評估，並以評估的結果排定稽核計畫。113 年供應商稽核家數共 40 家，包含主要原物料供應商以及勞務供應商，我們從中針對年度稽核排定或高風險的供應商，執行責任商業聯盟行為準則系統與營運持續管理系統的稽核，以便透過稽核管控，避免或降低負面的社會衝擊，總稽核達 78 次，稽核結果皆無高風險廠商。113 年供應商現場稽核發現的不符合事項主要集中於製程管制、職業安全衛生管理、消防安全、作業規範執行落實及產線 6S 管理等類別，我們要求供應商限期改善，經持續追蹤確認，不符合事項已全數完成改善，並未有供應商因稽核列為不合格供應商。根據供應商稽核結果，本公司供應鏈並無具強迫、強制勞動事件以及使用童工之重大風險供應商。



4. 舉辦「供應商社會責任宣導」

為建立永續供應鏈及有效傳達 ESG 永續意識，本公司每年舉辦供應商宣導，以中英文內容提供給國內外供應商，協助供應商共同成長並藉此與供應商維持良好互動關係，亦分享與交流彼此在 ESG 運作的成果。

113 年「供應商社會責任宣導」主要議題有從業道德、供應鏈碳管理、RBA 行為準則及供應鏈盡職調查等等，共有 148 家廠商、181 人數來自化學品、直接材料及人力仲介等供應商代表完成參與，透過供應鏈的溝通與合作，建立綠色永續供應鏈與創造雙贏的共享價值。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

《社會面》

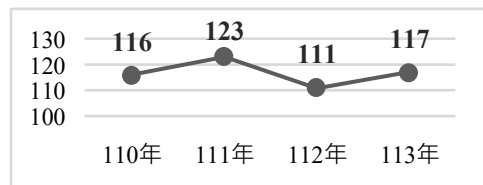
1.提供就業機會

本公司持續提供就業機會，113 年共聘用 1,664 位新進員工，在積極聘用各類人才的同時，亦提供了適合的工作機會給弱勢族群，協助他們找到合適的工作，以減緩經濟壓力，落實回饋社會與創造社會共融之精神，113 年共聘用 61 名弱勢族群，開創 DEI 多元友善職場。

2.身心障礙就業

本公司為秉持照顧弱勢族群，持續改善工作環境，使更多弱勢朋友能加入我們的大家庭，113 年新聘用 30 名身心障礙員工，身心障礙員額數為 117 名，超過法令要求。

年度	110	111	112	113
身心障礙 聘員額	116	123	111	117



3.「力成科技教育基金會」公益活動

本公司於 106 年成立「力成科技教育基金會」，以「偏鄉教育」、「教育扶助」、「運動培育」、「青年培力」四大發展面向，致力推廣科普、環境保護與品德教育，以及關注環境生態與地球保護等議題，用具體的行動積極參與社會公益，與社會共生共榮。113 年度社會投資總金額達新台幣 3,907,987 元，員工志工服務時數達 1,348 小時，受益人次達 4,746 人。有關本公司社會參與相關說明，揭露於本公司永續報告書及公司官網。

《員工面》

1.工作生活平衡計畫

本公司創造多元活潑的職場紓壓環境，並提供優於法令的健康檢查、健檢異常追蹤與管理，以及擁有心理諮商與員工協助方案等措施，讓力成員工在工作與生活間達到身心健康。

2.育嬰留職停薪政策

本公司配合國家政策，提供完善的育嬰留職停薪方案，鼓勵員工生育。113 年力成寶寶誕生數為 320 人，近 4 年力成寶寶誕生數共 1,346 人。

◆ 育嬰留停：

113 年度共有 186 名員工申請過育嬰留停，且申請人不侷限於女性同仁，其中更有 36 名男性員工申請育嬰留停，比率達 19.35%。而生育後選擇回到本公司持續服務的員工高達 84%，更有高達 86% 的復職同仁一年後仍持續在職。

◆ 設置集乳室：

為了照顧身為母親的女性員工，各廠區均設置安全舒適且具隱密的集乳環境，讓哺乳的媽咪們可於需要時安心、放心的使用。

◆ 孕婦專用車位

我們於各廠區均設置孕婦專用車位，讓孕婦及產後媽媽享有便利及較佳的工作環境，保障孕婦優先停車之權益。

◆ 托兒優惠措施

福委會透過簽訂特約的方式，與員工居住區域之優良幼兒園、托兒機構協定優惠方案，共計 17 家，提供員工安排子女學前教育或安親的照料時，除了有多元的機構可選擇外，亦能有實質上的折扣優惠，減輕員工經濟負擔。

氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形																
1 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	(1) 董事會 力成重視股東權益，董事會為經營運作的核心。在推動氣候變遷與永續管理策略上，董事會亦扮演督導與指揮角色，其下設立的風險管理委員會、薪資報酬委員會與審計委員會，協助監督企業永續及氣候變遷相關管理作為，並由各委員會定期向董事會彙報。 <table border="1" data-bbox="635 504 1412 750"> <thead> <tr> <th>組織</th><th>權責</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風險管理委員會</td><td>協助審查風險管理政策、進行氣候變遷風險之辨識與調適、風險承受度及督導各項風險管理制度之執行。</td></tr> <tr> <td>薪資報酬委員會</td><td>評估與確保個人薪資發放與公司營運績效、ESG 績效結合。</td></tr> <tr> <td>審計委員會</td><td>督導公司整體營運風險。</td></tr> </tbody> </table> (2) 管理階層 - 在推行減碳、環境永續等議題，除了高階主管的支持外，亦需要各單位的加入與合作，力成以永續目標為經度、各跨功能組織為緯度，擘劃出環境永續各面向關注的內容，並提供高階主管、管理階層可一窺全貌，提供有效的支援與協力。 - 建置氣候風險辨識與應對程序，「由上而下指揮督導、由下而上應變與回報」，經由 TCFD 推行小組、節能小組的執行，彙報於工安環保委員會、ESG 委員會及風險管理推動小組，並進行氣候變遷之衝擊分析與風險辨識，再彙總於風險管理委員會。 <table border="1" data-bbox="635 1198 1412 1982"> <thead> <tr> <th>組織</th><th>權責</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>風險管理推動小組</td><td>為順利運作氣候治理，於風險管理委員會下另設立「風險管理推動小組」，採任務編組方式運行，由總經理擔任組長、指定一名副組長、公司治理主管擔任執行秘書，每季召開會議討論風險議題，包含有極端氣候對公司運行的影響及危害，並每年定期將相關內容提報於風險管理委員會中討論，落實風險管理有效性。</td></tr> <tr> <td>永續發展委員會</td><td>討論企業永續發展管理事務，由總經理擔任召集人，永續發展管理室擔任執行秘書，協助永續發展政策目標相關業務推動，並針對利害關係人所關切之議題溝通並討論。 ◆ TCFD 推行小組：由永續發展管理室擔任召集人，每年進行 TCFD 氣候相關風險與機會辨識，並彙整年度 TCFD 氣候相關風險與機會辨識結果於「永續發展委員會」報告、討論，供經營團隊決策參考。</td></tr> <tr> <td>工安環保委員會</td><td>由總經理擔任召集人，負責工安及環保相關事務之研議，以防制職業災害與污染事件之發生、改善作業環境安全與衛生，強化環安衛管理。每季召開一次，討論包含氣候變遷與環境保護議題，如：制定環境、節能績效指標、溫室氣體盤查結果追蹤與改善。 ◆ 節能小組：由廠務部擔任召集人，每年進行各廠區節能議題、能源管理之討論與研議，並彙整提供年度節能統計於工安環保委員會報告。</td></tr> </tbody> </table>	組織	權責	風險管理委員會	協助審查風險管理政策、進行氣候變遷風險之辨識與調適、風險承受度及督導各項風險管理制度之執行。	薪資報酬委員會	評估與確保個人薪資發放與公司營運績效、ESG 績效結合。	審計委員會	督導公司整體營運風險。	組織	權責	風險管理推動小組	為順利運作氣候治理，於風險管理委員會下另設立「風險管理推動小組」，採任務編組方式運行，由總經理擔任組長、指定一名副組長、公司治理主管擔任執行秘書，每季召開會議討論風險議題，包含有極端氣候對公司運行的影響及危害，並每年定期將相關內容提報於風險管理委員會中討論，落實風險管理有效性。	永續發展委員會	討論企業永續發展管理事務，由總經理擔任召集人，永續發展管理室擔任執行秘書，協助永續發展政策目標相關業務推動，並針對利害關係人所關切之議題溝通並討論。 ◆ TCFD 推行小組：由永續發展管理室擔任召集人，每年進行 TCFD 氣候相關風險與機會辨識，並彙整年度 TCFD 氣候相關風險與機會辨識結果於「永續發展委員會」報告、討論，供經營團隊決策參考。	工安環保委員會	由總經理擔任召集人，負責工安及環保相關事務之研議，以防制職業災害與污染事件之發生、改善作業環境安全與衛生，強化環安衛管理。每季召開一次，討論包含氣候變遷與環境保護議題，如：制定環境、節能績效指標、溫室氣體盤查結果追蹤與改善。 ◆ 節能小組：由廠務部擔任召集人，每年進行各廠區節能議題、能源管理之討論與研議，並彙整提供年度節能統計於工安環保委員會報告。
組織	權責																
風險管理委員會	協助審查風險管理政策、進行氣候變遷風險之辨識與調適、風險承受度及督導各項風險管理制度之執行。																
薪資報酬委員會	評估與確保個人薪資發放與公司營運績效、ESG 績效結合。																
審計委員會	督導公司整體營運風險。																
組織	權責																
風險管理推動小組	為順利運作氣候治理，於風險管理委員會下另設立「風險管理推動小組」，採任務編組方式運行，由總經理擔任組長、指定一名副組長、公司治理主管擔任執行秘書，每季召開會議討論風險議題，包含有極端氣候對公司運行的影響及危害，並每年定期將相關內容提報於風險管理委員會中討論，落實風險管理有效性。																
永續發展委員會	討論企業永續發展管理事務，由總經理擔任召集人，永續發展管理室擔任執行秘書，協助永續發展政策目標相關業務推動，並針對利害關係人所關切之議題溝通並討論。 ◆ TCFD 推行小組：由永續發展管理室擔任召集人，每年進行 TCFD 氣候相關風險與機會辨識，並彙整年度 TCFD 氣候相關風險與機會辨識結果於「永續發展委員會」報告、討論，供經營團隊決策參考。																
工安環保委員會	由總經理擔任召集人，負責工安及環保相關事務之研議，以防制職業災害與污染事件之發生、改善作業環境安全與衛生，強化環安衛管理。每季召開一次，討論包含氣候變遷與環境保護議題，如：制定環境、節能績效指標、溫室氣體盤查結果追蹤與改善。 ◆ 節能小組：由廠務部擔任召集人，每年進行各廠區節能議題、能源管理之討論與研議，並彙整提供年度節能統計於工安環保委員會報告。																

項目		執行情形
2	敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	氣候變遷風險與機會分析請見 113 年永續報告書「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
3	敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	氣候變遷財務影響分析請見 113 年永續報告書「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
4	敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	風險監控與識別請見 113 年永續報告書「2.3 風險管理」、「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
5	若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	氣候相關風險和機會影響力成科技的策略和財務規劃，我們使用定量與定性之氣候相關情境分析以便採取對應策略。力成科技參考 2°C 情境(2DS)、1.5°C 情境及代表濃度途徑情境(RCP) 等於專案會議中進行討論，並依據此情境中對於實體風險、轉型風險、機會來源等，進行氣候變遷風險與機會等議題評估。
6	若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	力成科技制定因應氣候變遷衝擊之相關管理指標，包含提升節能效率，節約用電達 1%、設置再生能源使用專案，完成廠區屋頂架設太陽能發電設備及購置再生能源憑證，再生能源使用達 3.43%、執行 ISO 14064 溫室氣體盤查、ISO 14067 產品碳足跡等查證，了解排碳熱點並落實減少碳排放，積極實踐減碳路徑，朝 2050 淨零目標前行。 力成科技除了依循客戶及產品特性來制定減碳措施，亦全方位施行環境管理方案，包括規劃各廠區陸續取得「清潔生產評估系統」合格證書、提升資源使用效益與目標，擴大水資源及廢棄物循環再利用，以及投入低碳、環保產品或製程之開發、攜手供應鏈合作低碳轉型專案等等，以實踐 ESG 具體行動與責任生產，為美好的社會與永續環境而努力。
7	若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	評估國際趨勢及法規要求等因素，力成科技內部尚在研議「內部碳定價」管理措施。
8	若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	各項目標及施行進度請見 113 年永續報告書「1.5 永續發展目標實踐」、「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。
9	溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫。	溫室氣體盤查數據請見 113 年永續報告書「7.1 氣候變遷與能源管理」章節。

(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一)本公司為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，並基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及相關施行細則訂定本公司「誠信經營及從業道德守則」，經董事會於中華民國102年4月30日決議通過後實施，於104年2月9日經董事會決議通過第一次修訂，於107年11月2日經董事會決議通過第二次修訂、109年3月10日經董事會決議通過第三次修訂、111年3月10日經董事會決議通過第四次修訂，並於111年11月4日經董事會決議通過第五次修訂。	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
(二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二)本公司「誠信經營及從業道德守則」中建立定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，並針對下列各類型行為制定行為指南、檢舉制度、不誠信之行為處置、獎懲及申訴制度，且落實執行： 1.禁止提供或收受不當利益 2.禁止與處理疏通費之程序 3.利益衝突迴避 4.政治獻金、慈善捐贈或贊助辦理程序 5.建立商業關係程序 6.揭露公司誠信經營政策 7.禁止從事內線交易 8.禁止洩露機密資訊 9.禁止侵害智慧財產權 10.禁止從事不公平競爭之行為 11.防範產品或服務損害利害關係人 12.檢舉制度、不誠信之行為處置、獎懲及申訴制度	
(三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三)請參考本表下方說明一。	
二、落實誠信經營				
(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	✓		(一)請參考本表下方說明二。	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二)本公司為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，於103年8月1日設置「企業社會責任室」為專職單位，於104年2月9日經董事會通過，隸屬於董事會，該組織於111年3月10日經董事會通過，更名為「永續發展管理室」，負責本公司誠信經營政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並每年定期(至少一年一次)向董事會報告。(113年11月8日召開第十屆第9次董事會，議案：本公司113年度推動誠信經營、反賄賂管理計畫及其執行情形報告)	
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		(三)本公司依據「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司新進人員皆會簽署《聘僱合約書》，合約書內容表明員工應遵守利益規避，且自104年起，每位員工每年須簽署《利益衝突迴避同意書》；本公司自105年起，亦將遵循誠信經營制度的線上課程與年度績效考核連結，以徹底落實執行本公司誠信經營及從業道德政策。	
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	✓		(四)本公司業已建立完備之會計制度及內控機制，並由內部稽核單位依年度稽核計畫執行相關查核，並作成稽核報告提報審計委員會及董事會，必要時亦得委任會計師執行查核。	
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		(五)請參考本表下方說明三。	
三、公司檢舉制度之運作情形				與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		(一)本公司提供暢通溝通管道與多元化申訴機制，除於同仁手冊之服務準則中宣達遵循誠信原則之規範讓同仁遵守，亦設置「員工溝通管道作業規範」，以實踐多元暢通的雙向溝通環境，以及「獎懲管理辦法」可供施行及運作，並有專責人員負責受理檢舉案件，確保檢舉者身份的機密性和匿名性及防止報復，且指派適當人員處理及回覆檢舉案件。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		(二)請參考本表下方說明四。	
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三)本公司對於檢舉人之身分均嚴格保密保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當之處置，確保檢舉者身份的機密性和匿名性及防止報復。	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一)本公司「誠信經營及從業道德守則」內容及推動成效，皆揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相符
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 符合「上市上櫃公司誠信經營守則」。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司定期檢討並改進公司所建置之誠信經營政策，於111年3月10日經董事會決議通過「誠信經營及從業道德守則」第四次修訂，以提升履行成效；並決議通過本公司「永續發展管理室」為專責單位，隸屬於董事會，負責誠信經營政策與防範方案之修定及監督執行，每年定期向董事會報告。				

說明：一、本公司對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款具較高不誠信行為風險之營業活動（行賄及收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益），採行下列防範措施：

- 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 2.定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 3.規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 4.舉辦公司誠信政策教育訓練與宣導，使員工充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。
- 5.規劃檢舉制度及訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程序及確保執行之有效性。
- 6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 7.建立推動誠信經營之量化數據，持續分析評估誠信政策推動成效，於公司網站、年報及公開說明書揭露其誠信經營採行措施、履行情形及前揭量化數據與推動成效，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則之內容。
- 8.110年導入「ISO 37001 反賄賂管理系統」並通過驗證稽核取得證書，且每年定期執行「ISO 37001 反賄賂管理系統」之內、外部稽核，持續提升人員之誠信經營意識與強化公司治理。

二、依據本公司「誠信經營及從業道德守則」規定，本公司與供應商建立商業關係前，須先行評估商業往來交易對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，避免與涉有不誠信行為者進行交易。本公司於評估商業往來交易對象時，須採行適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- 1.該供應商之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- 2.該供應商是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
- 3.該供應商營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- 4.該供應商所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- 5.該供應商長期經營狀況及商譽。
- 6.諮詢其供應商夥伴對該供應商之意見。
- 7.該供應商是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

本公司人員於從事商業行為過程中，須向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

本公司與他人簽訂契約時，須充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守誠信經營納入契約條款，於契約中得明訂下列事項：

- (1)任何一方知悉有人員違反禁止佣金、回扣或其他利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查。一方如因此而受有損害時，得向他方請求損害賠償。
- (2)任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方得隨時無條件終止或解除契約。
- (3)訂定明確且合理之付款內容，包括付款地點、方式、需符合之相關稅務法規等。

三、本公司除指派相關人員參加外部誠信經營相關訓練之外，公司內部每年定期舉辦誠信經營相關教育訓練課程。113 年誠信經營教育訓練成果如下：

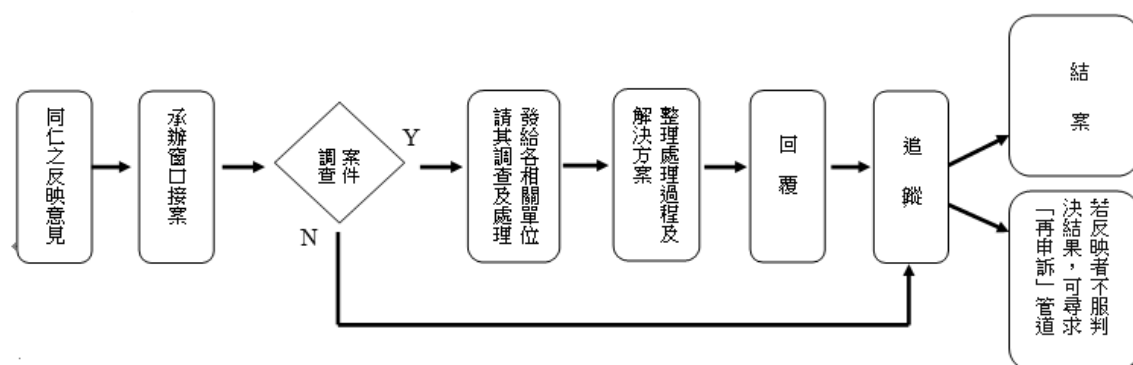
1.113 年度內部訓練

113 年法令課程				
No.	課程名稱	時數	人次	總時數
1	TIPS 智財管理制度教育訓練	1	3,839	3,839
2	個人資料保護及管理	1	11,172	11,172
3	能源管理及節約能源認知訓練	1	11,172	11,172
4	新進員工一般教育訓練(公司資訊保密規定)	0.45	1,380	621
5	誠信經營與從業道德	1	11,172	11,172
6	資安訓練-釣魚郵件加強訓練	1	98	98
7	資訊安全教育訓練	1	21,595	21,595
8	營業秘密保護及管理	1	11,172	11,172
9	職場性騷擾防治	1	11,172	11,172
10	一般安全衛生在職訓練	1	10,123	10,123
11	危害性化學品通識訓練	1	11,172	11,172
合 計		-	104,067	103,308

2.113 年度供應商與承攬商訓練

- ◆ 執行 113 年「供應商社會責任宣導」，共有 148 家廠商、181 人次參與；議程內容涵蓋誠信經營與反賄賂。
- ◆ 所有承攬商、駐廠廠商等入廠前都會完成入廠須知相關訓練，包含誠信經營與反賄賂。

四、本公司訂定受理檢舉事項之調查標準及作業程序如下：



(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(八)內部控制制度執行狀況

1.內部控制制度聲明書：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告

2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.股東會重要決議事項及執行情形

日期	股東會	重要決議事項
113.5.30	股東常會	1.通過承認 112 年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認 112 年度盈餘分配案。 執行情形：訂定 113 年 8 月 7 日為分配基準日，113 年 9 月 5 日為發放日(每股配發現金股利 7.0 元)，已如期發放完畢。 3.核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案。 執行情形：該私募案即將屆滿一年，且尚未找到適合之策略性投資人，經本公司 114 年 2 月 21 日第十屆第 10 次董事會決議，不繼續辦理該私募案，並將提 114 年股東會報告。

2.董事會重要決議事項

日期	董事會	重要決議事項
113.3.8	第十屆第 5 次	1. 通過 113 年營業計畫案。 2. 通過 112 年度營業報告書及財務報告。 3. 通過 112 年度盈餘分配案。 4. 通過分配 112 年度董事酬勞及員工酬勞案。 5. 通過經理人薪資調整案。 6. 通過經理人退休案。 7. 通過本公司 112 年度內部控制制度有效性考核暨出具 112 年度內部控制制度聲明書案。

日 期	董事會	重 要 決 議 事 項
		8. 通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 9. 通過評估聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。 10. 通過向金融機構申請授信額度案。 11. 通過不繼續辦理本公司 112 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。 12. 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。 13. 通過 113 年度股東常會召集案。
113.5.10	第十屆第 6 次	1. 通過 113 年第 1 季財務報告。 2. 通過向金融機構申請授信額度案。 3. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
113.6.28	第十屆第 7 次	1. 通過訂定本公司 112 年度盈餘分配之配息基準日案。
113.8.9	第十屆第 8 次	1. 通過 113 年第 2 季財務報告。 2. 通過本公司 112 年度企業永續報告書編制內容。 3. 通過向金融機構申請授信額度案。 4. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。 5. 通過修訂力成科技股份有限公司「員工持股會章程」及「員工持股信託實施辦法」
113.11.8	第十屆第 9 次	1. 通過 113 年第 3 季財務報告。 2. 通過本公司「永續資訊之管理作業辦法」。 3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 4. 通過訂定本公司 114 年度內部稽核計劃案。 5. 通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 6. 通過經理人退休案。 7. 通過經理人委任案。 8. 通過終止海外存託憑證上市案。 9. 通過向金融機構申請授信額度案。 10. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。
114.2.21	第十屆第 10 次	1. 通過 114 年營業計畫案。 2. 通過 113 年度營業報告書及財務報告。 3. 通過 113 年度盈餘分配案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案、暨增訂「員工酬勞分派原則管理辦法」。 5. 通過分配 113 年度董事酬勞及員工酬勞案。 6. 通過經理人薪資調整案。 7. 通過經理人職務晉升案。 8. 通過本公司 113 年度內部控制制度有效性考核暨出具 113 年度內部控制制度聲明書案。

日 期	董 事 會	重 要 決 議 事 項
114.2.21	第十屆第 10 次	9. 通過內部稽核主管任命案。 10. 修訂「內部控制制度」及「內部稽核制度」。 11. 修訂「員工持股會章程」。 12. 通過評估聘雇會計師之獨立性及適任性暨審計公費案。 13. 通過向金融機構申請授信額度案。 14. 通過為規避匯率波動之風險，申請買賣遠期外匯額度案。 15. 通過不繼續辦理本公司 113 年股東常會通過之「核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發行海外或國內轉換公司債案」。 16. 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)，及/或發行海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債)案。 17. 通過 114 年度股東常會召集案。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

(一)給付簽證會計師與其所屬事務所及關係企業之審計公費與非審計之金額及非審計服務內容：

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備 註
勤業眾信聯合會計師事務所	林政治 方蘇立	113.01.01~ 113.12.31	12,200	1,080	13,280	非審計公費內容： 1.移轉訂價報告 350 仟元 2.審計及稅簽相關代墊費 260 仟元 3.營業稅直扣法申報 170 仟元 4.未分配盈餘實質投資查核公費 200 仟元 5.XRBL 申報檔 60 仟元 6.人力資源 40 仟元

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

伍、更換會計師資訊：

(一)關於前任會計師

更 換 日 期	民國一一年三月十日		
更 換 原 因 及 說 明	事務所內部業務調動		
說明係委任人或會計師 終止或不接受委任	情 況 \ 當 事 人	會 計 師	委 任 人
	主 動 終 止 委 任	不適用	不適用
	不再接受（繼續）委任	不適用	不適用
最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	無		
與 發 行 人 有 無 不 同 意 見	有	—	會 計 原 則 或 實 務
		—	財 務 報 告 之 揭 露
		—	查 核 範 圍 或 步 驟
		—	其 他
	無	√	
	說明	—	
其他揭露事項 （本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者）	無		

(二)關於繼任會計師

事 務 所 名 稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會 計 師 姓 名	林政治會計師、方蘇立會計師(註)
委 任 之 日 期	民國一一一年三月十日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

註：本公司簽證會計師原為勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及林政治會計師，因事務所內部業務調度，變更為林政治及方蘇立會計師。

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：無此情形。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之資訊：無此情形。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	113 年度		截至當年度 3 月 31 日止	
		持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數	持 有 股 數 增（減）數	質 押 股 數 增（減）數
董事長	蔡篤恭	(640,000)	—	0	—
董 事	美商金士頓科技股份有限公司 投資專戶 (KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION) 代表人：古口榮男、吳麗卿	0	—	0	—
董 事	超豐電子(股)公司 代表人：謝永達	1,200,000	—	5,895,000	—
董 事	台灣鎧俠先進半導體(股)公司 代表人：淺田順一	0	—	0	—
獨立董事	張光瑤	0	—	0	—
獨立董事	李培瑛	0	—	0	—
獨立董事	陳瑞聰	0	—	0	—
獨立董事	童兆勤	0	—	0	—
執行長	謝永達	0	—	0	—
董事暨總經理	呂肇祥	0	—	0	—
經理人	陳玉欽	0	—	0	—
經理人	巫勤達	0	—	0	—
經理人	吳文維	0	—	0	—
經理人	喬廣文	0	—	0	—
經理人	林賢鳳	(9,000)	—	0	—
經理人	林宥翰	(30,000)	—	0	—
經理人	陳世恭	(87,000)	—	0	—
經理人	董定鑫	(3,000)	—	0	—
經理人	徐宏欣	0	—	0	—
經理人	林基正	0	—	0	—
財務主管暨 公司治理主管	沈俊宏(註 1)	0	—	0	—
會計主管	紅立勝(註 1)	0	—	0	—
前財務會計主管 暨公司治理主管	曾炫章(註 2)	0	—	—	—
前經理人	王文忠(註 3)	0	—	—	—
前經理人	朱肇信(註 4)	0	—	—	—

註 1：財務主管暨公司治理主管沈俊宏先生及會計主管紅立勝先生於 113 年 11 月 8 日就任，其持有股數揭露自就任日起。

註 2：前財務長暨資深副總經理曾炫章先生於 113 年 11 月 8 日退休，其持有股數揭露至退休日止。

註 3：前經理人王文忠先生於 113 年 2 月 29 日退休，其持有股數揭露至退休日止。

註 4：前經理人朱肇信先生於 113 年 2 月 29 日退休，其持有股數揭露至退休日止。

(二)股權移轉之相對人為關係人者：無。

(三)股權質押之相對人為關係人者：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

114 年 3 月 29 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係	
群益台灣精選高息 E T F 基金專戶	71,509,000	9.42%	—	—	—	—	無	—	
元大台灣高股息基金專戶	36,351,138	4.79%	—	—	—	—	無	—	
美商金士頓科技(股)公司投資專戶	29,875,000	3.94%	—	—	—	—	美商 KTC-SUN 公司	該公司之代表人與該股東之副總裁為同一人	
國泰人壽保險股份有限公司 代表人：熊明河	29,448,000 0	3.88% 0.00%	—	—	—	—	無	—	
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶	27,693,000	3.65%	—	—	—	—	無	—	
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶	22,429,000	2.95%	—	—	—	—	無	—	
南山人壽保險股份有限公司 代表人：尹崇堯	18,507,000 0	2.44% 0.00%	—	—	—	—	無	—	
中華郵政股份有限公司 代表人：王國材	15,469,900 0	2.04% 0.00%	—	—	—	—	無	—	
超豐電子股份有限公司 代表人：謝永達	14,748,000 18,000	1.94% 0.00%	— 2,000	— 0.00%	—	—	無	—	
美商 KTC-SUN 公司 代表人：孫大衛 (David Sun)	13,765,362 0	1.81% 0.00%	—	—	—	—	美商金士頓科技股份有限公司投資專戶	該公司之副總裁與該股東之代表人為同一人	

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業(註1)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
晶兆成科技(股)公司	73,385,830	49%	76,381,170	51%	149,767,000	100.00%
Powertech Holding (BVI) Inc.	50,000	100%	0	0%	50,000	100.00%
超豐電子(股)公司	244,064,379	42.91%	0	0%	244,064,379	42.91%
Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.	69,000,000	100%	0	0%	69,000,000	100.00%
PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.	102,995	100%	0	0%	102,995	100%
力成科技日本合同會社	註2	100%	0	0%	註2	100.00%
得群科技(股)公司	—	—	7,796,498	97.46%	7,796,498	97.46%

註1：係公司採權益法之投資。

註2：非屬股份有限公司，無持股數。

參、募資情形

一、資本及股份

(一)股本來源

1.股本形成經過

年 月	發行 價格 (元)	核 定 股 本		實 收 股 本		備 註		
		股數 (仟股)	金額 (仟元)	股數 (仟股)	金額 (仟元)	股本來源	以現金以外 之財產抵充 股款者	其他
86/5	10	200,000	2,000,000	60,000.0	600,000	創立、現金增資 600,000 仟元	無	無
87/4	12	200,000	2,000,000	120,000.0	1,200,000	現金增資 600,000 仟元	無	註 1
88/5	11	200,000	2,000,000	200,000.0	2,000,000	現金增資 800,000 仟元	無	註 2
90/8	10	280,000	2,800,000	221,800.0	2,218,000	盈餘、資本公積轉增資 218,000 仟元	無	註 3
91/9	10	280,000	2,800,000	235,222.9	2,352,229	盈餘轉增資 134,229 仟元	無	註 4
91/9	11.5	280,000	2,800,000	246,312.9	2,463,129	現金增資 110,900 仟元	無	註 5
92/9	10	280,000	2,800,000	261,250.0	2,612,500	盈餘轉增資 149,371 仟元	無	註 6
93/9	10	440,000	4,400,000	308,000.0	3,080,000	盈餘轉增資 467,500 仟元	無	註 7
93/9	43	440,000	4,400,000	338,000.0	3,380,000	現金增資 300,000 仟元	無	註 8
94/6	10	580,000	5,800,000	400,500.0	4,005,000	盈餘轉增資 625,000 仟元	無	註 9
95/6	10	580,000	5,800,000	471,000.0	4,710,000	盈餘轉增資 705,000 仟元	無	註 10
96/6	10	580,000	5,800,000	556,300.0	5,563,000	盈餘轉增資 853,000 仟元	無	註 11
97/6	10	750,000	7,500,000	630,800.0	6,308,000	盈餘轉增資 745,000 仟元	無	註 12
98/7	10	750,000	7,500,000	669,385.2	6,693,852	盈餘轉增資 385,852 仟元	無	註 13
99/5	60.6	750,000	7,500,000	704,236.7	7,042,367	私募可轉換公司債轉換為普通股 348,515 仟元	無	註 14
99/9	58.4	750,000	7,500,000	715,366.8	7,153,668	私募可轉換公司債轉換為普通股 111,301 仟元	無	註 15
99/12	58.4	750,000	7,500,000	726,496.9	7,264,969	私募可轉換公司債轉換為普通股 111,301 仟元	無	註 16
100/8	10	1,000,000	10,000,000	799,146.6	7,991,466	盈餘轉增資 726,497 仟元	無	註 17
101/8	10	1,000,000	10,000,000	779,146.6	7,791,466	註銷庫藏股減資 200,000 仟元	無	註 18
111/4	10	1,000,000	10,000,000	759,146.6	7,591,466	註銷庫藏股減資 200,000 仟元	無	註 19

註 1：87.02.17(87)台財證(一)第 18910 號函

註 2：88.03.02(88)台財證(一)第 22357 號函

註 3：90.06.21(90)台財證(一)第 139798 號函

註 4：91.07.10(91)台財證(一)第 0910137911 號函

註 5：91.07.10(91)台財證(一)第 0910137913 號函

註 6：92.07.08(92)台財證(一)第 0920130303 號函

註 7：93.06.25(93)台財證(一)第 0930128233 號函

註 8：93.07.06(93)證期一字第 0930128234 號函

註 9：94.06.24 金管證一字第 0940125391 號函

註 10：95.06.27 金管證一字第 0950126720 號函

註 11：96.06.28 金管證一字第 0960032903 號函

註 12：97.06.25 金管證一字第 0970031487 號函

註 13：98.07.02 金管證一字第 0980032960 號函

註 14：99.05.05 經授商字第 09901091340 號函

註 15：99.09.21 經授商字第 09901214270 號函

註 16：99.12.31 經授商字第 09901291530 號函

註 17：100.8.11 經授商字第 10001183300 號函

註 18：101.8.27 經授商字第 10101177670 號函

註 19：111.4.15 經授商字第 11101050150 號函

2.股份種類

單位：股

股 份 種 類	核 定 股 本			備 註
	流通在外股份	未發行股份	合 計	
記名普通股	759,146,634	240,853,366	1,000,000,000	上市公司股票

3.總括申報制度相關資訊：不適用。

(二)主要股東名單

114 年 3 月 29 日

主要股東名稱	股 份	持有股數	持股比例
群益台灣精選高息 E T F 基金專戶		71,509,000	9.42%
元大台灣高股息基金專戶		36,351,138	4.79%
美商金士頓科技股份有限公司投資專戶		29,875,000	3.94%
國泰人壽保險股份有限公司		29,448,000	3.88%
台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 E T F 證券投資信託基金專戶		27,693,000	3.65%
華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 E T F 證券投資信託基金專戶		22,429,000	2.95%
南山人壽保險股份有限公司		18,507,000	2.44%
中華郵政股份有限公司		15,469,900	2.04%
超豐電子股份有限公司		14,748,000	1.94%
美商 K T C - S U N 公司		13,765,362	1.81%

(三)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司章程第 21 條之 1 第 3 項規定，本公司屬資本密集之產業，股利政策須考量公司目前及未來之投資環境、資金需求、市場競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東利益、平衡股利及公司長期財務規劃等，本公司股東紅利之發放分為現金股利及股票股利，其中現金股利以不低於股利總額之 20%。

本公司為維持穩定且可持續性的股利政策，係依據近年度實際營運狀況、考量投資機會及資金需求規劃而擬定股東股利。

2.股利政策之執行狀況說明如下：

(1)本公司於民國 92 年至 99 年間處於營運成長期，此期間各年度皆由前一年度所產生之保留盈餘中提撥約 50% 分派股東股利，而分派之股利中，現金股利約佔 80%，股票股利則約佔 20%。

(2)自民國 100 年起，本公司開始進入獲利穩定期，此期間各年度皆由前一年度所產生之保留盈餘中提撥約 60% 分派股東股利，而分派之股利中，100% 以現金股利發放。期間雖然於 102 年度因權利金和解賠償而導致虧損外，本公司仍以資本公積配發的方式，每股發放現金 2 元。

(3)本公司為延續民國 100 年後之股利政策，於 114 年 2 月 21 日經第十屆第 10 次董事會決議擬每股發放現金股利 7.0 元，預計發放金額合計約佔 113 年度所產生保留盈餘之 78%，尚符合現階段本公司之股利政策。倘若未來本公司之營運狀況未發生重大變化時，亦將延續目前之股利政策。

3.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司 114 年度擬自 113 年度盈餘中分派現金股利計新台幣 5,314,026,438 元，依目前流通在外股數每股發放現金股利 7.0 元，實際股利分配情形將待 114 年股東會決議後執行之。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

本次股東會擬議分派 113 年度之盈餘，未有無償配股之情形。

(五)員工及董事酬勞：

1.公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司之公司章程中，有關員工及董事酬勞之分派原則規定如下：

本公司年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，應提撥 5%~7.5% 為員工酬勞及不高於 1.5% 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損（包括調整未分配盈餘金額）時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。董事酬勞僅得以現金為之。本公司獨立董事按月支領報酬，不參與年度董事酬勞分配。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

113 年度員工及董事酬勞金額之估列基礎，係依上述公司章程之規定予以估列，若實際分派金額與估列數有差異時，則視為會計估計變動，列入實際分派年度之損益。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司於民國 114 年 2 月 21 日經第十屆第 10 次董事會決議，通過分派 113 年度之員工及董事酬勞如下：

- (1) 員工酬勞新台幣 458,230,949 元及董事酬勞新台幣 91,646,190 元，分別佔年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利的 5.44% 及 1.09%，均以現金方式發放。上述金額與 113 年財報帳列數比較並無差異。
- (2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：本期並無以股票分派員工酬勞之情形，故不適用。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形：

本公司於 113 年 5 月 30 日股東常會通過 112 年度盈餘分配案中，有關員工及董事酬勞之分派情形如下：

	金額(元)
員工酬勞—以現金方式發放	\$ 540,574,520
董事酬勞—以現金方式發放	108,114,904
合 計	\$ 648,689,424

上述實際分派情形與原董事會決議相較並無差異。

(六) 公司買回本公司股份情形：無此情形。

二、公司債辦理情形：無此情形。

三、特別股辦理情形：無此情形。

四、海外存託憑證辦理情形：

自 95 年起，本公司部分已發行之股票以存託憑證(每單位存託憑證表彰母公司普通股 2 股)方式於盧森堡交易所上市，上述海外存託憑證持有人享有與本公司普通股股東相同之權利義務。為降低相關管理成本，本公司於 113 年 11 月 8 日經董事會決議，終止本公司於盧森堡交易所掛牌發行之海外存託憑證，並已於 113 年 12 月 16 日完成下市流程，截止下市日 113 年 12 月 16 日，流通在外海外存託憑證為 22 單位，前述海外存託憑證持有人於 114 年 6 月 15 日前，仍可向存託機構請求兌回。

五、員工認股權憑證及限制員工權利新股辦理情形：無此情形。

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無此情形。

七、資金運用計畫執行情形：

本公司截至 114 年 3 月 31 日止，尚無前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現之情形。

肆、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容：

- (1) CC01080 電子零組件製造業。
- (2) CC01101 電信管制射頻器材製造業。
- (3) CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
- (4) CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
- (5) CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。
- (6) F119010 電子材料批發業。
- (7) F219010 電子材料零售業。
- (8) H201010 一般投資業。
- (9) I301010 資訊軟體服務業。
- (10) I501010 產品設計業。
- (11) JE01010 租賃業。

2.營業比重：

本公司成立於民國 86 年 5 月，以積體電路 IC 封裝測試業務為主，113 年度合併營業比重如下：

單位：新台幣仟元

項 目	113 年度營收淨額	營業比重
IC 封裝服務	46,202,311	63.02%
IC 測試服務	10,161,225	13.86%
模組加工服務	7,418,546	10.12%
晶圓級封裝服務	3,443,938	4.70%
晶圓級測試服務	6,063,678	8.27%
其他	25,344	0.03%
合 計	73,315,042	100%

3.目前之商品(服務)項目：

- (1) 高腳數超薄小型晶粒承載積體電路(TSOP)封裝及測試服務。
- (2) 四邊扁平無腳封裝(QFN)封裝服務。
- (3) 多晶片(堆疊)封裝(MCP、S-MCP)封裝及測試服務。
- (4) 球型陣列承載積體電路(wBGA、FBGA)封裝及測試服務。
- (5) 記憶卡(SD、microSD)、USB 封裝及測試服務。
- (6) 固態硬碟(SSD)、內嵌式記憶體(eMMC、eMCP、UFS) 封裝及測試服務。
- (7) DRAM 晶片堆疊封裝及測試服務。
- (8) 行動記憶體封裝及測試服務。
- (9) 晶圓級晶片測試服務。
- (10) 晶圓凸塊(Bumping)服務。
- (11) 系統級封裝(SiP)服務。
- (12) 重佈線(RDL)服務。
- (13) 晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務。

- (14) 封裝體堆疊(PoP、PiP)封裝及測試服務。
- (15) CIS 影像感測器封裝及測試服務。
- (16) 覆晶封裝(Flipchip)服務。
- (17) 大尺寸(>100mm x100mm) FCBGA。
- (18) 客製化 CPO (SiPh chip + SoC) on FCBGA 封裝。
- (19) 高散熱金屬導電膠應用於大尺寸 FCBGA 與 FCLGA。
- (20) 覆晶封裝結合超細線寬與間距重佈線製程(RDL)的 FOPLP 技術，提供高密度異質晶片封裝產品於高速網路與伺服器等應用領域。
- (21) 銅柱凸塊覆晶(Cu Pillar Bump Flip Chip)封裝服務。
- (22) EMI shield package 封裝服務。
- (23) 面板級扇出型 (Panel level Fan-Out)封裝及測試服務。
- (24) 模組(Module)與系統(System)封裝服務。
- (25) 高速 SCM (Storage Class Memory) 測試服務與硬體開發。
- (26) 車用電源模組測試服務。
- (27) 電源模組預燒服務。
- (28) PCIe 介面測試服務。

4. 計劃開發之新商品(服務)：

- (1) 大尺寸(>70mm x 70mm) MCM FCBGA (logic + memory)，用於汽車應用。
- (2) 封裝體堆疊(Package on Package)應用銅核心錫球等新製程與材料。
- (3) 先進節點晶圓應用於車用 Package 封裝。
- (4) BT+ABF 基板，應用於AI，HP與汽車等的 FCBGA。
- (5) Fan-out on Substrate 封裝。
- (6) Fan-out 嵌入小晶片，以整合邏輯晶片或系統單晶片(SoC)與高頻寬記憶體，滿足雲端人工智能(Cloud AI)與邊緣運算(Edge Computing)之應用。
- (7) Fan-out 整合邏輯晶片或系統單晶片(SoC)與記憶體晶片垂直堆疊整合，滿足穿戴裝置輕薄短小之需求。
- (8) 覆晶封裝結合重佈線路技術之 Chip Last Fan-out 結構。
- (9) 晶片嵌入式製程技術(Pillars in Fan-Out, PiFO®)，提供智慧型手機、穿戴式裝置應用需求。
- (10) 應用矽穿孔(TSV)技術於高頻大容量記憶體封裝，運用在人工智慧元件(AI)等產品。
- (11) 8顆 NAND 記憶體晶片+Controller 搭配 FOPLP 扇出型面板級封裝堆疊技術，提供超薄型、高密度與高速之行動通訊應用需求。
- (12) NAND記憶體晶片搭配微控制晶片的高散熱記憶體晶片模組技術，提供超薄型、大容量、高散熱與高速之雲端儲存應用需求。
- (13) 整合矽穿孔及微凸塊之高頻寬記憶體堆疊晶片及嵌埋橋接晶片扇出型堆疊封裝，提供高頻寬、高記憶體密度、高效能運算及高速網路連結之應用。
- (14) 8顆NAND快閃記憶體晶片，搭配8顆LPDRAM內存記憶體晶片，微控制器，與6顆矽中介層之封裝堆疊技術，提供高記憶體密度、高效能、薄型封裝於行動通訊上之應用。
- (15) 高度整合之 FO-PoPoP結構，藉由結合主動晶片與球面被動元件，提供更好的電氣特性。
- (16) 3D-FOPoP結構，提供高密度、高電氣特性，及尺寸微縮之封裝解決方案。
- (17) 超小晶片尺寸，與超大晶片尺寸 CIS CSP 封裝，以滿足不同應用領域的需求。
- (18) PiFO(Pillars in FO) with embedded bridge 封裝。
- (19) Via middle TSV HBM 封裝。
- (20) 高速 3D-NAND 測試服務與硬體開發 (>3.2Gbps)。

- (21) Tester IO board 硬體開發。
- (22) HBM 測試開發。
- (23) CoWoS測試開發。
- (24) CIS測試開發。

(二)產業概況

1.產業之現況與發展

2024 年全球經濟成長面臨諸多挑戰，包含地緣政治衝擊產業發展，區域性戰爭衝突不斷，兼以高通膨，高利率，中國疫後經濟表現不如預期等。依據國際貨幣基金(IMF)資料顯示，2024 年全球經濟成長率約只有 3.2%。

展望 2025 年，全球經濟可能呈現溫和復甦的態勢，但仍面臨通膨、地緣政治風險及美國關稅增加等不確定因素。依 IMF 提出的報告預測顯示，預期 2025 年全球經濟成長率將和 2024 年相仿，維持 3.2%。

就半導體產業而言，隨著庫存去化、新興應用需求增加，半導體市場預計將重回成長軌道。依據世界半導體貿易統計協會(WSTS)公布的 2024 年市場規模達到 6,270 億美元。相較 2023 年成長 19%。2025 年，市場預計將延續成長趨勢，WSTS 預計市場規模將達到 6,970 億美元，年增率為 11.2%。

台灣半導體產業的表現，在全球平均值之上。工研院產科國際所預估 2024 年臺灣 IC 產業產值達新臺幣 5 兆 3,151 億元，較 2023 年成長 22.4%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 1 兆 2,721 億元，較 2023 年成長 16.0%；IC 製造業為新臺幣 3 兆 4,195 億元，較 2023 年成長 28.4%，其中晶圓代工為新臺幣 3 兆 2,438 億元，較 2023 年成長 30.1%，記憶體與其他製造為新臺幣 1,757 億元，較 2023 年成長 3.3%；IC 封裝業為新臺幣 4,233 億元，較 2023 年成長 7.7%；IC 測試業為新臺幣 2,002 億元，較 2023 年成長 5.0%。新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。

長期來看，半導體產業依然將持續成長。半導體的廣大應用，人工智慧、雲端伺服器、邊緣運算、智慧型手機、電腦、AR/VR、5G、電動車與自駕車、IoT 及電子醫療等應用推陳出新，呈現百花齊放的蓬勃面貌。

2021年～2025年台灣IC產業產值

億新臺幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025 (e)	2025 (e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	19.1%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：工研院產科國際所

說明：

(e)表示預估值(estimate)

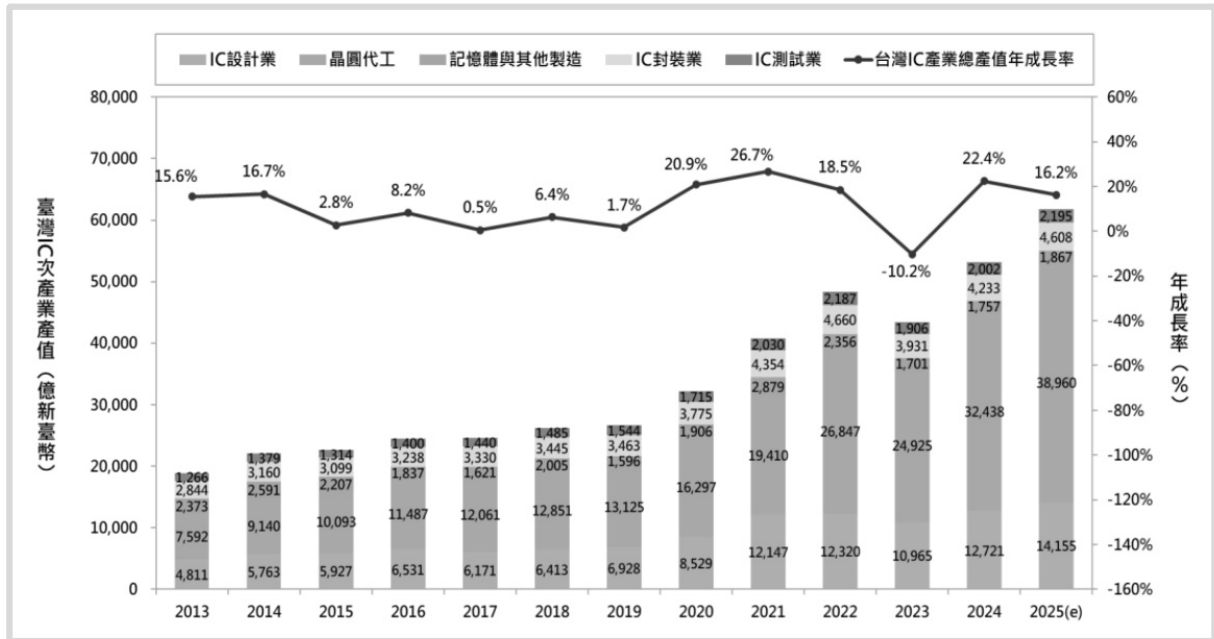
IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業

IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造

IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造

上述產值計算是以總部設立在臺灣的公司為基準

台灣半導體各次產業產值



資料來源：工研院產科國際所

2. 產業上、中、下游之關聯性

半導體產業，可區分為上游的晶片設計，中游的晶圓製造，及下游的晶片封裝及測試。

(1) 晶片設計：

晶片設計屬於知識密集產業，此行業具有高進入障礙的特色，隨著高效能，多功能的電子產品需求，以及 5G、AI、IoT、汽車電子、工業與消費性產品的應用多元化，晶片設計產業百花齊放，是半導體供應鏈內重要的一環。晶片設計公司概分為自行設計產品銷售，或接受客戶委託設計兩大類。

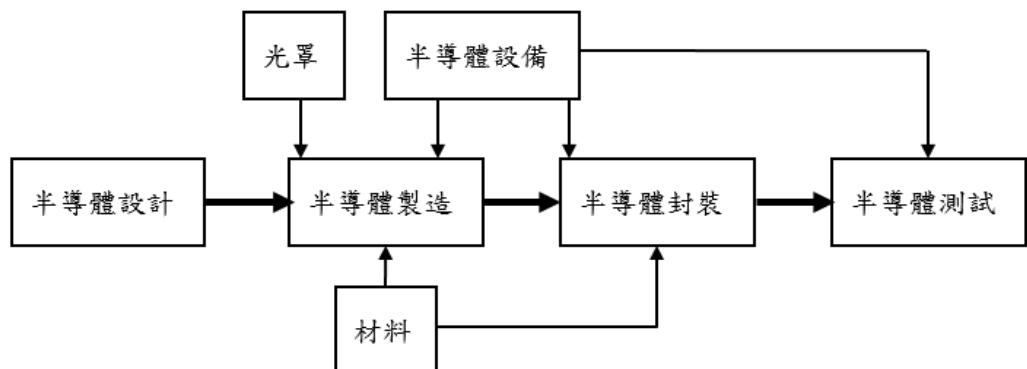
(2) 晶圓製造：

晶片製造屬於高資本、高技術、與高知識性的產業，負責將晶片設計，製作出半導體晶圓。隨著晶片效能的提升需求，細線路化，高集積化，晶圓製造的門檻愈來愈高，能夠投資在先進製程的廠商愈來愈集中化。晶圓製造概分為 IDM 公司(廠內自行製造)，與專業晶圓製造代工兩種。

(3) 晶片封裝及測試：

封測產業將製造出的晶圓，進一步作測試與封裝，以便進一步應用在主機板與系統層級上。隨著摩爾定律的進展受限，封裝的角色日益吃重，必須藉由先進封裝的作法，將不同功能的晶片進行異質整合，是封測業被半導體產業界賦予的重要責任與期待。

行業上、中、下游之關聯性，如圖所示：



3.產品之各種發展趨勢及競爭情形

(1)產品之發展趨勢

半導體產品朝向多功能，效能強化、省電、散熱，與高整合度的發展趨勢，帶動先進封裝朝向系統級封裝(SiP)及異質整合封裝(Heterogeneous Integration)的產品需求。新型態的先進封裝技術，諸如面板級扇出型封裝(Panel Fan-Out)、矽穿孔(TSV)、內埋式封裝(Embedded Package)、晶片薄化(Thin Wafer)、晶片堆疊(Chip Stacking)、細間距覆晶(Fine Pitch Flipchip)、高密度模封(High Density Encapsulation)、天線整合封裝(AiP)、高密度表面焊接(High Density SMT)、系統組裝(System assembly)及測試(Testing)等技術的整合，將是後摩爾時代來臨之際，半導體產業的重中之重。

未來的產品趨勢，將需要整合各種先進的封裝測試技術。本公司多年以來，強調持續不斷的技術研發，因應新型態產品的需求，對產品發展的趨勢，能精準掌握，並能夠在最正確的時間點，推出適合市場的必要技術。

面對半導體在未來數年的持續成長態勢，力成科技一如以往，持續半導體與系統級的封裝測試技術的創新，維持在全球 OSAT 的技術領導地位。同時重視品質，生產良率，期能充分提供市場與產業界在各個領域需求的不同技術，讓客戶享受最有競爭力的服務，與客戶一同成長。

(2)競爭情形：

力成科技擁有完整的半導體後段封測能力，足以提供客戶從晶圓凸塊(Bumping)、晶圓測試(Wafer Sort)、晶圓級封裝(WLCSP)、鉅線封裝(Wire bond Package)、覆晶封裝(Flip chip Package)、系統級封裝(System in Package)、面板級扇出型封裝(Fanout)、3 維矽穿孔(3DIC TSV)、模組與系統級組裝(System Assembly)、封裝與系統級測試(Final Test)等服務。

當晶圓從半導體製造廠產出之後，力成科技提供客戶一次滿足半導體後段所需的所有服務，客戶將無需費心逐一安排後段各個站點的生產基地與產能；本公司能夠提供完整的半導體後段服務，涵蓋傳統產品封測，以及最先進技術的量產能力與產能，這是力成科技得以持續在半導體後段競爭的的最大利基之一。

除此之外，力成科技的優勢在於，技術能力強、生產天數短、生產良率高及生產成本低。本公司願意將自身的優勢，與客戶共享，在過去超過二十年的公司歷史中，始終以客為尊，與客戶分享優勢，共同成長。

展望未來，隨著先進封測技術的需求日殷，力成科技除了持續維持記憶體封測的領導地位外，在邏輯 IC 與系統級整合封裝 SiP 的業務將持續大幅度成長，本公司已然是全球領先的全方位半導體封裝測試大廠。

2024年全球前十大封測廠之台灣廠商排名及2019年~2024年成長態勢

單位：新台幣百萬元

公司 名稱	2019年 營收	19/20 成長率	2020年 營收	20/21 成長率	2021年 營收	21/22 成長率	2022年 營收	22/23 成長率	2023年 營收	23/24 成長率	2024年 營收
日月光	413,182	15.44%	476,979	19.50%	569,997	17.70%	670,872	-13.26%	581,914	2.32%	595,410
力成	66,525	14.51%	76,181	9.99%	83,794	0.16%	83,927	-16.07%	70,441	4.08%	73,315
京元電	25,539	13.39%	28,959	16.58%	33,759	8.95%	36,782	-10.21%	33,025	-18.68%	26,856
頤邦	20,419	9.09%	22,275	21.58%	27,082	-11.34%	24,010	-16.47%	20,056	1.40%	20,337
南茂	20,338	13.14%	23,011	19.07%	27,400	-14.17%	23,517	-9.19%	21,356	6.27%	22,696

資料來源：公開資訊觀測站/各公司財報，力成公司整理

(三)技術及研發概況

1.研發費用

本公司最近年度研發費用支出情形詳如下表：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	2024 年度
研發費用	2,808,879

2.開發成功之技術或產品：

(1) 封裝產品方面的成果：

- A. 持續量產深具成本競爭優勢的無凸塊扇出型(Bump-Free Fan-Out, BF²O®)面板級封裝，應用於行動裝置、穿戴式裝置及其他消費性產品等多樣化的終端產品。
- B. 利用覆晶封裝結合重佈線路技術(Chip Last Integration Package, CLIP®)整合系統晶片(SoC)與動態隨機存取記憶體(DRAM)，加上層數簡化的封裝基板(Substrate)形成 Fan-out on Substrate 封裝技術。
- C. 利用(Chips Integration Embedded Fan-out Solution, CHIEFS®)重佈線路之細線寬能力，使BT基板(Substrate)尺寸與層數得以減小，形成具尺寸與成本競爭優勢的 Chip First Fan-out on Substrate 封裝架構。
- D. 以扇出型面板級封裝(Fan-Out Panel Level Package, FOPLP)之晶片嵌入式製程技術(Pillars in Fan-Out, PiFO®)整合光源晶片與其控制晶片，以應用於娛樂、醫療、教育等領域的AR/VR裝置。
- E. 以晶片嵌入式製程技術(Pillars in Fan-Out, PiFO®)提供智慧型手機應用處理器(Application Processor, AP)高效能且更輕薄短小的PoP (Package on Package)封裝需求。
- F. 結合扇出型封裝與矽穿孔晶圓級封裝(TSV-WLCSP) 之Chip Middle FOPoP結構，提供穿戴裝置應用需求。
- G. 實現超細線寬與間距重佈線製程(RDL)之FOPLP技術開發與驗證，運用在高速運算處理晶片。
- H. 晶圓重組技術之開發，將兩種或以上不同功能之晶片整合在一晶圓上與矽穿孔晶圓級封裝(TSV-WLCSP)達到小尺寸多晶片模組的優勢，符合消費性電子產品之輕薄短小與高傳輸速率低功耗的需求。
- I. 以矽穿孔(TSV)與高精度的晶片堆疊製程所製做的高密度的高頻記憶體(High Bandwidth Memory, HBM)。
- J. 成功開發應用於行動裝置、醫療、監控及車用領域等應用市場的矽穿孔影像感測器晶片尺寸封裝 (TSV CIS CSP) 技術。
- K. 成功開發大尺寸 (75mm x 75mm) 多晶片模組封裝 FCBGA (SoC + chiplets)，應用於 AI 伺服器。
- L. 成功開發嵌入式 H/S FCCSP, 用於微控制器與電視晶片封裝。
- M. 成功開發 FCLGA，用於電源晶片在 AI, HPC, 汽車的應用。
- N. 成功開發 5G AP、Modem、RF相關應用之FCCSP產品。
- O. 成功開發 TV Chip及RF相關FBGA、HS-FBGA產品。
- P. 成功開發 WiFi相關Hybrid (DB, WB+FC)產品。
- Q. 成功開發 H/S FCBGA，應用於汽車上的 SOC 與 MCU。
- R. 成功開發 CIS於基板上的系統級封裝。
- S. 成功開發車用相關晶片FCBGA產品。
- T. 成功開發高速傳輸控制晶片(PCIE) FCCSP產品。

- U. 成功開發光傳輸網路控制晶片(OTN) FCBGA產品。
- V. 成功開發高散熱金屬導電膠應用於大尺寸 FCBGA 與FCLGA。
- W. 成功開發封裝體堆疊(Package on Package)應用銅核心錫球等新製程與材料。
- X. 成功開發生產16顆NAND晶片堆疊+2顆Interface Chip 可滿足高容量SSD產品。
- Y. 成功開發 8xDRAM+8xNAND+Controller uMCP Hybrid (WB+FC)產品，可滿足高速大容量行動通訊產品。
- Z. 成功開發天線封裝 (Antenna in Package, AiP) 技術及射頻 (Radio Frequency, RF) 實驗室的建置，可協助客戶加速在5G高頻封裝產品上的開發與驗證。

(2) 測試產品方面的成果：

- A. UFS3.0 Automotive Product 測試服務與硬體開發。
- B. 高速 3D-NAND (1.6Gbps) 測試服務與硬體開發。
- C. Micro Shield Storage Memory 測試服務與硬體開發。
- D. uLED 測試服務。
- E. uLED 晶圓 BI 測試服務
- F. T2000 EPP tester 量產導入。
- G. 系統級 IC BI 測試解決方案與硬體開發。
- H. 防沾黏記憶體測試治具開發
- I. 大尺寸封裝之測試服務與硬體開發。
- J. 大尺寸封裝之測試機台開發。
- K. UFS 4.0 汽車產品應用測試服務與硬體開發。
- L. AR / VR 相關應用之測試服務與硬體開發。

(四)長、短期業務發展計劃

茲就本公司有關經營、生產、行銷、研發等策略領域之短期及長期發展計劃之內容說明如下：

1.短期發展計劃

(1) 積極開發新製程及技術

技術領先為本公司著重的經營方向之一。因應半導體應用產品的多樣化，與所需的封裝技術的差異，力成科技將持續開發新製程及技術能力，以期滿足客戶所需。舉例來說，應用 TSV 製程，於 HBM 產品，將可達成高速高頻寬的記憶體模組；應用面板級扇外型封裝 (Panel Level Fan Out)於 HPC/AR / AI / IoT/智慧駕駛等領域，將可實現異質整合封裝 (Heterogeneous Integration)，有助於半導體晶片高速，高頻寬的需求達成。

(2) 持續縮短製程週期，以提供客戶更迅捷之服務

本公司之生產利基為彈性且快速的產能調整，提供客戶具有競爭力的生產週期。

(3) 持續提供整合性服務(Turn-Key Service)

由於上游晶圓廠基於成本考量，逐漸將 IC 之封裝及測試業務外移至專業封測廠。本公司積極進行產品組合的優化，以及先進封裝測試技術的研發和量產，成為國內少數能同時提供先進技術的封裝及測試一元化服務的領導廠商。未來將持續提供高技術的整合性服務，強化本公司在客戶供應鏈內的價值與競爭力。

(4) 擴展國內外市場，擴大市場佔有率

本公司具有提供整合性服務之優勢，除與現有國內外客戶維持良好關係外，將積極爭取國內外新客戶，擴大市場佔有率。

2. 中長期發展計劃

(1) 注重與客戶之間的長期合作關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司已是客戶信賴與倚賴的封裝測試夥伴，提供客戶需要的品質與服務，與客戶共同成長。

(2) 注重與供應商之間的長期合作關係

供應商是力成科技生產能力的延伸，而半導體設備、材料等供應商，是力成多年來得以成長茁壯的關鍵。力成科技本於與供應商互信、互利的基礎以建立雙贏及共同成長的期許，持續強化完整的供應商合作關係。

(3) 推動數位化、數位優化

在既有的 AI/Big Data 基礎上持續推動 E 化，導入 RPA(流程機器人)來處理大量重複執行的任務，以節省人力、提高效率。BI(商業智慧)提供的營運報表可回饋日常業務流程改善。EDA(工程資料分析)除提供日常的項目監控，更因科技疊加效果，增加數位自動化能力進而提高產品良率、增進生產效率。

(4) 持續開發下世代所需的封裝測試技術

力成科技於封裝測試模組領域除穩定擴產，經營及研發團隊兼顧技術發展及客戶需求，在新技術專利及創新能力居業界領先地位；工廠製造團隊除提升既有生產效率外，亦致力於品質提升、成本下降等活動。

自 2006 年成立封測研發中心後，一路創造 Stacked Die、Thin wafer 等技術門檻，近年更在面板級封裝(Panel-level packaging, PLP)，矽穿孔(Through Si Via, TSV)，高階伺服器電源模組等新領域與客戶合作開發次世代新產品，持續開花結果。

(5) 持續增加邏輯產品、系統及模組封裝測試營收

藉由增加邏輯產品封測，以及擴大客戶規模及營收，以期提升產業領導地位，並分散產業風險。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析

1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司主要產品為提供 IC 封裝及測試服務，銷售地區包含國內外市場，2024 年度內銷比重約 19.19%；外銷比重為 80.81%，以日本、新加坡及美洲地區為主。

單位：新台幣仟元

銷售地	年度	2023 年度	%	2024 年度	%
內銷		18,117,103	25.72%	14,072,499	19.19%
外銷		52,323,842	74.28%	59,242,543	80.81%
	日本	21,514,180		22,691,850	
	新加坡	15,689,481		18,360,461	
	美洲	9,446,028		13,269,647	
	歐洲	1,689,438		1,718,756	
	中國大陸及港澳	2,038,684		1,571,006	
	其他	1,946,031		1,630,823	
合計		70,440,945	100.00	73,315,042	100.00

2.市場占有率

半導體封測產業在 2023 年下半年出現需求反轉，訂單縮減的情形，但在 2024 年，隨著庫存去化、新興應用需求增加，半導體市場預計將重回成長軌道，封測產業也將受惠於此趨勢。持續精進各項產品技術與生產製造能力，以期景氣持續好轉時能加速成長提升市場佔有率，是公司穩健經營的策略方針。期望 2025 年，力成科技在全球專業封測代工大廠中的市場佔有率能持續上升，公司一本穩健經營，持續成長的策略，踏著穩健的步伐成長。

3.市場未來之供需狀況與成長性

展望 2025 年，依據國際數據資訊公司(IDC)預測，2025 年全球半導體市場整體市場預計成長超過 15%，而封裝測試產業預計成長 9%。就長期而言，半導體產業的持續成長方向依然不變。

4.競爭利基

力成科技長年以來，以優異的生產良率與品質、用心的服務及創新的技術，與世界一級客戶建立了既深且長的密切合作關係，本公司具備之競爭利基如下：

(1)堅強的策略聯盟/走向全球化：

IC 封裝及測試業與上游晶圓製造廠之互動程度高，因此封裝及測試之獲利因素在於穩定之客戶訂單來源，而 IC 製造廠，鑑於其產品技術、產品品質及生產程序之保密性，亦會選擇與 IC 封裝及測試業之長期合作，因而形成策略聯盟，並與之有長期穩定之合作關係，有利於未來公司之長期發展。

(2)整合性的全面服務：

本公司同時提供 IC 封裝及 IC 測試之一元化服務，以降低產品來回運送之成本與風險，以符合客戶需求，提高公司競爭利基。

(3)領先業界的研發與製程能力：

本公司致力於創新技術研發，並對生產製程改善不遺餘力，至今已取得國內外數百件專利，奠定厚實的技術研發基礎與能量。

(4)自動化及高精密度機台引進：

因應積體電路 IC 產品朝車用及 AI 晶片發展，為提昇為客戶服務品質，持續與廠商合作開發先進自動化及高精密度設備，並且導入自動化光學檢驗及量測設備，以符合客戶及市場需求。

(5)網路自動化客戶服務系統：

本公司利用網際網路系統資訊傳遞及系統持續的改善，客戶可以隨時掌握產品問題及目前進度，瞭解產品狀況，有助於產品之改善及快速解決問題，提高對客戶之附加價值。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1)有利因素：

【產業環境】

①台灣半導體產業的競爭優勢

台灣半導體產業擁有完整的半導體產業結構，從上游的 IC 設計、晶圓製造至下游的封裝測試，垂直整合的產業鏈符合產業趨勢需求，造就台灣半導體產業在國際市場之競爭地位。IC 產業的榮景隨著全球電子、資訊、通信、消費性電子、光電工業、人工智慧以及物聯網蓬勃發展，將使 IC 封裝、測試業持續穩定發展。

②IDM 大廠委外趨勢有利於封測市場

因先進製程須高額資本支出，使得全球 IDM 廠陸續擴大晶圓代工與封測委外業務於生產成本較低的亞洲地區，因此，具有 IC 產業完整與動態的垂直分工體系的台灣，成為國際 IDM 與 IC 設計公司委外代工的首選，台灣封測廠亦獲益於 IDM 委外訂單。

【公司利基】

①穩健的策略聯盟及經營團隊—

力成科技的主要股東與經營團隊，長年來穩定用心經營，形塑公司穩健踏實的企業文化，此有助於公司知名度之建立及訂單來源之穩定。另外，本公司之經營團隊皆具備半導體領域之完整資歷，能洞悉市場趨勢，帶領公司力抗不景氣，調整作法，擬定與時俱進的公司策略。

②持續的研發及創新—

因應市場的快速變遷，力成建構了完整的封裝、測試與模組產品的研發團隊，全面致力技術深耕，並透過技術合作引進先進技術。

③整合性的全面服務—

力成科技可完整提供半導體後段封測所需的各式生產技術，從傳統的導線架封裝，到最先進的矽穿孔或面板級扇出型封裝。全面性的技術服務，讓力成得以在世界的封測產業，持續成長。

(2)不利因素及因應措施：

①IC 產業隨景氣波動

因應對策：

A.產品多角化佈局

除了持續維持並強化在記憶體 IC 封裝測試技術的領導地位外，也積極打入邏輯 IC 的封測市場，藉由銅柱凸塊(Copper Pillar Bump, CPB)，金屬線路鐳墊重分配製程(Re-distribution, RDL)，晶圓級封裝(Wafer Level CSP)，覆晶封裝，面板級扇出型封裝，系統級組裝等新製程技術，得以快速進軍邏輯 IC 領域。公司藉由多角化的產品降低景氣循環的風險，提供客戶更多元化之封測服務。

B.強化與客戶的合作模式

與現有客戶建立長期策略聯盟夥伴關係，並積極開發新客戶，使產能得到充分而穩定的利用。

C.擴大市場服務範圍

積極進軍日本與歐美市場，並切入 AI、自駕車、電動車、5G、工業、等應用，擴大客戶群與產品應用的領域。

②原物料庫存增加

因應對策：

A.去化庫存

對應終端市場需求持續低迷及高庫存，持續與客戶溝通並加速過期原物料之處置、積極與供應商協調針對原物料在外訂單之處置以達到庫存有效管控，並加速庫存去化。

B.降低生產成本

持續進行原物料之詢、議、比價以及改變產品結構、改善良率、提出可替代材料之解決方案，並持續改良製程能力，降低成本上漲之影響。

C.強調附加價值

持續站在客戶立場，提供品質好、交期短、快速應變客戶需求的服務。致力研發新的封裝測試技術，使客戶在市場上推出具有時效性及競爭優勢之產品。

D.與供應商建立長期合作

本公司積極與設備及材料供應商建立長期穩固的合作關係，進而達到雙贏的目標。

③基層勞工短缺

因應對策：

A.提高員工薪酬與福利以吸引人才加入本公司，持續強化員工關懷與人才適性發展措施，讓同仁的工作與生活得到平衡，達到留才之目的以穩定人力。

B.引進與開發自動化機器設備與系統，提升員工生產力，降低對人力需求。

C.積極走入校園，擴大產學合作，建立學用接軌，培養新生代人才。

D.呼應勞動部所提出移工中階技術人才方案，培訓藍領移工技術升級，晉升為中階技術人才，以穩定生產人力，因應就業人口老化及半導體人才不足困境。

④半導體後段競爭加劇

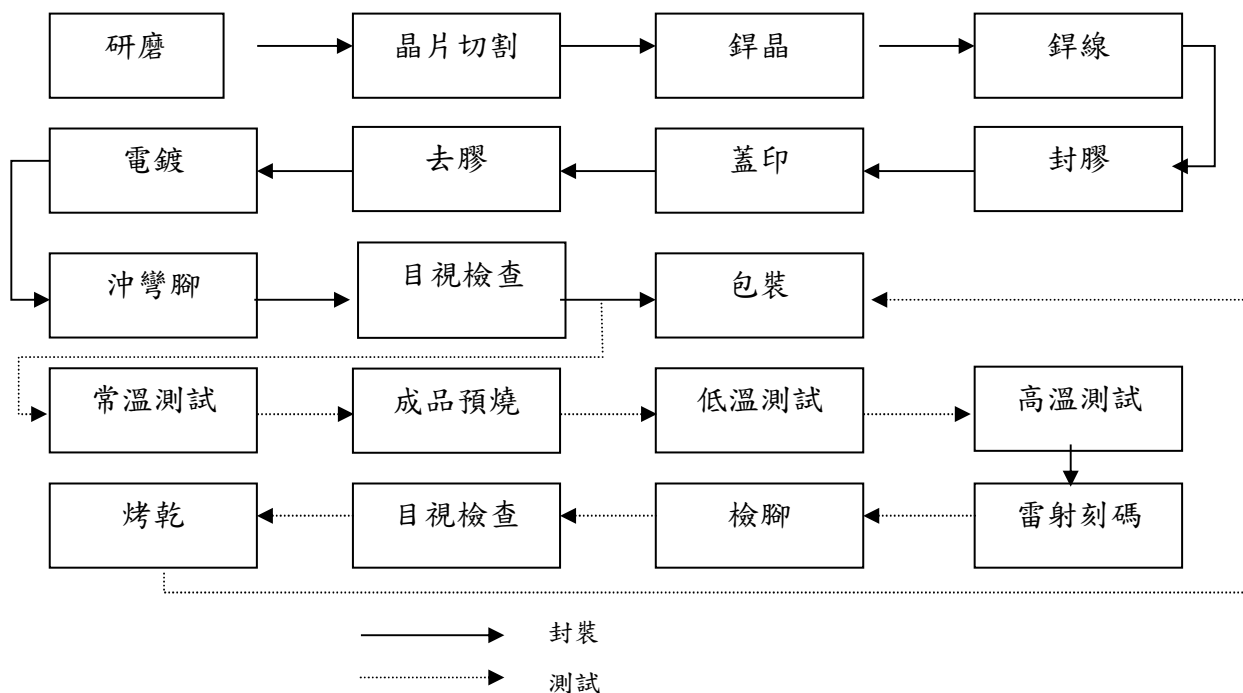
在日新月異的先進科技發展中，半導體技術擔任了非常重要的角色。在半導體供應鏈中，過去大家的注意力，比較集中在晶圓製造的領域。在後摩爾時代來臨下，以先進製程所生產的半導體晶圓的效能，需要先進的後段封裝技術配合，方能達成。面臨半導體晶圓廠與基板廠紛紛進軍先進封裝領域，本公司將繼續強化技術研發，審慎進行新技術與新產能的投資，與客戶和供應商建構穩固的合作關係，並強化由晶圓測試到成品出貨的一元化服務，將繼續在半導體後段領域，建構雄厚的競爭力。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.產品用途：

主要產品或服務項目	重要用途或功能
積體電路(IC)封裝(Assembly)	將積體電路(IC)由晶圓產品經由切割、黏合、接線、封膠、切腳、成型等製程完成單顆成品。
環境分類測試 (Final Test)	依客戶所指定之測試條件，將產品 (IC) 置於不同的環境如常溫、高溫或低溫中測試並分類，確保客戶所提供的產品符合其所要求的品質及穩定性。
成品預燒 (Burn-In)	運用預燒 (Burn-In) 製程，讓產品 (IC) 處於極端的環境中運作，加速產品的老化並予以篩選，以確保產品的可靠性。
雷射刻碼 (Laser Mark)	於產品 (IC) 封裝上刻印廠商名稱及產品類別。

2.產製過程：



(三)主要原料之供應狀況

本公司主要是為客戶提供之 IC 加工，其中封裝作業須使用主要原料之供應狀況如下：

主要原料	主要供應商
導線架(LEAD FRAME)	Shinko Electric、長華電材、NICHIDEN SEIMITU KOGYO.
基板(Substrate)	景碩、Shinko Electric、SIMMTECH、Samsung Electro-Mechanics Co、禮鼎、恆勁、GTS
黏晶膠(Die attach Film)	台灣力森諾科、台灣日東、琳得科先進、Henkel Korea.
金線(GOLD WIRE)	Nippon、Tanaka
樹脂(COMPOUND)	晁揚、台灣力森諾科、新加坡京瓷亞太、長華電材

(四)最近二年度任一年度中曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.本公司主要供應商名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				當年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲	2,523,230	12.08	無	甲	2,525,578	11.24	無	甲	473,440	9.24	無
	其他	18,365,439	87.92		其他	19,935,465	88.76		其他	4,651,753	90.76	
	進貨淨額	20,888,669	100		進貨淨額	22,461,043	100		進貨淨額	5,125,193	100	

增減變動原因：無。

2. 本公司主要銷貨客戶名單：

單位：新台幣仟元

項目	112 年				113 年				當年度截至第一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	甲	17,978,222	25.52	無	甲	15,208,796	20.74	無	甲	3,191,747	20.6	無
2	乙	14,717,119	20.89	關係人	乙	16,111,879	21.98	關係人	乙	2,958,384	19.09	關係人
3	丙	6,039,665	8.58	無	丙	8,921,762	12.17	無	丁	1,204,546	7.77	無
	其他	31,705,939	45.01		其他	33,072,605	45.11		其他	8,139,259	52.54	
	銷貨淨額	70,440,945	100		銷貨淨額	73,315,042	100		銷貨淨額	15,493,936	100	

增減變動原因：無。

三、從業員工資訊

最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率一覽表

年 度		112 年度	113 年度	114 年度截至 3 月 31 日止
員 工 人 數	管理職人員	1,113	1,094	1,079
	技術職人員	2,400	2,427	2,398
	行政職人員	437	425	412
	作業人員	7,048	7,412	7,294
	合 計	10,998	11,358	11,183
平 均 年 歲		37.06	37.32	37.52
平 均 服 務 年 資		7.80	8.01	8.18
學 歷 分 布 比 率 %	博 士	0.05	0.04	0.06
	碩 士	8.18	8.19	8.26
	大 專	71.66	73.11	72.93
	高 中	19.39	18.08	18.17
	高 中 以 下	0.72	0.58	0.58

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因違反環境法規所受損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：

(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及相關處分內容：

1. 新竹縣環保局於113年10月11日來函(府授環空字第1138656981號)，公司廠車(車號：AAH-150)於113年3月1日行經新竹縣新竹科學園區空氣品質維護區，經查一年內未有排煙檢測合格紀錄，違反空氣污染防治法第40條第3項規定，新竹縣環保局依空氣污染防治法第76條第2項規定於113年10月11日發文裁處新台幣500元整。

矯正措施：113年3月1日通過環保署排廢氣檢驗，取得環保署空氣品質管制環保合格章。

預防措施：儲運單位建立系統管控，於車輛定期檢驗到期前可自動通報需檢驗，以預防逾期未檢驗之狀況。

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

1. 目前及未來可能發生之估計金額

擬購置之防治污染設備或支出內容如下：

單位：新台幣 仟元			
項 目	114 年度	115 年度	116 年度
空氣污染防治費	13,040	13,040	13,040
廢水處理	97,420	97,420	97,420
廢棄物管理	97,010	97,010	97,010
土壤及地下水整治費	460	460	460
溫室氣體盤查及碳管理	3,480	3,480	3,480
其他	140	140	140
支出金額合計	211,550	211,550	211,550

2. 環境維持因應措施，請參閱本年報第44~46頁說明二。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練及其實施情形

力成科技重視人員的待遇與福利，依據各類獎金發放規範，提供合乎適用法律的員工福利，於每年度結算後之盈餘，扣除相關稅捐、公積及股息後，以固定比例撥予員工酬勞。

人才是支持公司不斷成長的最重要資產，也是企業永續經營的核心關鍵，我們致力於提供員工優質的工作條件，包含具有優渥、競爭力的薪酬福利及落實女男同工同酬、機會平等之目標，來吸引及留任各方優秀人才，以回饋同仁與公司共同創造佳績的辛勞與貢獻。期望能創造讓員工快樂工作、享受生活的優質環境，使員工安心工作，發揮工作潛能，一同成長。

1. 保險方面：

除法定勞、健保外，本公司員工均享有免費的團體保險(包括壽險、意外險、醫療險、癌症險…等，員工無須支付任何費用)。秉持照顧同仁及其眷屬的原則，不僅員工本人受惠，其配偶與子女也同樣享有免費的團體保險。

2.健康與安全方面：

- (1)廠區內備有保健室、哺乳室及醫師駐廠，透過專業醫療人員及健康管理，進行健康促進與管理員工的健康，公司也設有新進員工體檢補助及優於法規的定期員工免費健康檢查，以追蹤員工健康狀況。
- (2)針對健康異常之高風險族群進行風險管控及復工評估，且不定期公佈健康資訊、進行職災防範宣導與安排健康講座。
- (3)對於員工因異常工作負荷促發疾病之預防進行管理，預防發生對象為自覺有異常工作負荷主動通報之同仁，實施健康風險評估、過勞風險評估及佛明罕心血管疾病等評估，駐廠醫師依據綜合評估結果，進行諮詢及紀錄以維護同仁健康。
- (4)力成科技於 93 年通過 OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統認證，為達預防職傷事故並維護安全和健康之工作場所目標，我們訂定「環境安全衛生政策」，以維護員工的安全和健康。

環境安全衛生政策

- 將環境與安全衛生政策傳達予員工、客戶及相關團體。
- 符合環境保護及安全衛生相關法令規章及客戶之要求。
- 工作者及其代表諮商及參與防止傷害、疾病、事故預防及損失控制。
- 順應國際環境保護趨勢及組織處境，積極推動節能減廢活動。
- 持續檢討與改進，提高安全衛生及環境管理目標及整體績效。

3.員工協助方面：

員工的健康是企業最大的財富！健康快樂的員工能為公司創造更高效益的績效。力成科技持續推動與提供多元的健康促進方案與關懷機制，並取得「健康職場認證健康促進標章」，實踐對每位員工身心健康的重視，營造優質的健康工作環境。力成科技致力於提供優於法令的健康檢查、健檢異常追蹤與管理，以及擁有心理諮商與員工協助方案等措施，讓力成員工在工作與生活間達到身心健康。

4.旅遊方面：

113 年福委會邀請同仁來一場「無痕旅遊」，本次以發放電子福利點數的方式，讓同仁可自行決定兌換店家與使用時機，只要手機在手，即可進行旅遊行程費用折扣、購買樂園門票或是享受一頓美食饗宴，讓大家在放鬆之餘也可以一起愛地球。

5.家庭日/大型活動/休閒活動方面：

福委會定期規劃家庭日及其他大型休閒活動，邀請同仁與眷屬一起前來同樂、放鬆身心靈。在家庭日活動方面，113 年上、下半年福委會合計舉辦 2 場次，每場次吸引近 5,000 名同仁及眷屬熱情參與，大家共度歡樂時光，創造了無數美好回憶；休閒活動方面，我們於廠內韻律教室定期舉辦健康紓壓課程，共開設 4 個梯次：瑜珈 8 堂課共 144 人參與，透過課程舒展身心，讓大家找到內心的平靜與和諧；有氧舞蹈 7 堂課共 113 人參與，隨著動感的音樂一起舞動，不僅燃燒了熱量，也釋放了工作壓力，邀請同仁一起為生活補充元氣！

6.社團方面：

社團是一個可以讓擁有相同志趣的同仁們透過興趣聯繫感情以及在工作之餘放鬆、休息的管道之一；我們持續支持同仁自主辦理及參與各式社團。力成台灣截至 113 年有 11 個由同仁自主創立的社團，共計 429 位社員。每年各社

團除了有例行性的社團活動，也會舉辦全公司性的活動，提供社員與非社員、同仁與非同仁交流與合作的機會。113 年社團嘉年華總共有 6 個社團為同仁精心規劃精采的實體活動：羽球社、慢跑社、親子探索社、禪學社、壘球社、保齡球社。從七至九月接連熱力登場，無論是動態還是靜態的活動都能看到力成人熱情參與的身影！本次社團嘉年華吸引近 520 位同仁及眷屬參加，不僅展現了力成人的團結與創意，也充分體現了公司對同仁及其眷屬的關懷與重視。

7. 休假方面：

本公司比照勞基法規定給予每月例假及年度休假，並定期提供統計報表供主管瞭解關懷同仁休假狀況，以協助同仁達成工作與生活之均衡。

8. 生日婚喪及其他福利項目：

(1) 每月發予壽星 520 元等值祝賀禮，並針對同仁婚喪喜慶及住院、重大災害等，提供 1,000 至 10,000 元不等的補助金。

(2) 每年勞動節、端午節各提供 1,000 元等值的現金/禮券/禮品。

(3) 每年中秋節提供各 1,000 元現金及年節禮品，發放金額與形式依年度公告為主。

(4) 每年針對年資滿 3、5、10、20、25 年之同仁，給予獎勵禮品一份。

9. 生育補助及相關服務：

針對員工本人或配偶生育，提供每胎 2,000 元的補助金，並提供勞保生育給付的相關申請服務。同時我們也關心員工與其家庭的互動，透過福委會與員工居住區域之優良幼兒園、托兒機構簽訂特約優惠合約做為托兒措施，提供員工於安排子女學前教育或安親的照料時，有多元的機構可選擇。

10. 食宿方面：

(1) 本公司設有餐廳，提供自助餐，用餐皆有公司補助，同仁僅須支付少許餐費即能享有豐盛之餐點。107 年成立「伙食管理委員會」，透過定期的會議召開討論公司膳食議題，更健全了餐廳及伙食的管控。

(2) 為使遠道員工就近解決住的問題，公司備有員工宿舍，提供舒適之生活環境。

11. 人才發展：

我們以「傾聽」、「訪談」及「線上調查」等方式來考量公司內部需求與外部新議題，致力滿足「同仁學習的需求」、「產品品質的需求」、「組織成長的需求」及「公司策略的需求」，架構「解決需求導向」的課程辦理模式與訓練體系，更積極培養各階層接班人才，確保企業的永續經營，並針對不同學習對象提供適切的培訓，來促使組織持續發展及創造企業競爭優勢。我們依據教育訓練辦法，於每年度進行年度教育訓練調查，整合單位培訓需求，建構出四大訓練藍圖：「力成稽核系統」、「人才職能發展」、「法令政策培訓」及「技能學習移轉」，從公司發展目標出發擴及至單位技能培訓，逐步展開具體培訓計畫，並輔以 E 化學習模式，讓培訓效益極大化，提供員工更完整的專業技能養成及自我成長啟發。

(二) 退休制度與其實施情形

1. 退休申請制度：

力成科技遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，退休申請適用規定如下：

退休類別	退休要件
A.自請退休	A、服務本公司十五年以上，年滿五十五歲者。 B、服務本公司二十五年以上者。 C、服務本公司十年以上，年滿六十歲者。
B.強制退休	A、年滿六十五歲者。 B、身心障礙不堪勝任工作者，所謂身心障礙係指經公立醫療機構認定心神喪失或身體殘廢不堪勝任工作者為標準。

2.退休金提撥與實施

設立勞工退休準備金監督委員會，依選擇舊制和選擇新制但保有舊制年資人員按每月薪資總額提撥 2% 提列退休準備金至法定帳戶，並於每年初透過專業的精算顧問進行退休準備金精算評估確保足額，截至 113 年底舊制退休準備金帳戶金額約為 3.53 億元，可滿足勞工符合退休條件時請領退休金。選擇退休新制人員，依法每月提撥薪資 6% 存入勞保局勞工個人帳戶。113 年度會計帳列合計提撥之新、舊制退休金費用及員工提撥合計總額為 421,761,226 元，以期同仁皆能於退休後享有安心的保障。

(三)勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

建置全方位溝通管道：

我們重視同仁的意見與聲音，設有多元暢通的溝通管道以促進勞資雙方之溝通協調，並適時的回應同仁意見，進而檢視相關規範是否須調整改善，以期望更貼近同仁福祉以便落實。此外，透過每季召開的勞資會議及全區福委會，員工代表能針對特定議題反映同仁的建議及看法，任何有關勞資權益的議題藉由議程中的討論，均經勞資雙方充份溝通協議並與公司達成共識，以促進團結，確保溝通管道暢通。

我們建構全方位的溝通管道（如圖所示），隨時關注並傾聽同仁的各種聲音，無論具名或匿名反映，以多元、雙向、開放的反映機制，藉此傳達同仁的心聲，得以有效被處理及回覆，另也建置「再反映管道」讓反映的事件可更客觀及更完善的處理，透過公正、保密、迅速的處理過程，解決同仁的疑惑，並且保護反應事件者的權益，以建構良好的勞資關係。



(四)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

六、資通安全管理

(一)資通安全風險管理架構



為確保資訊安全，本公司建置了完善的資訊安全管理制度，並採取多項措施以有效管理資訊安全風險，保護資訊資產的機密性、完整性及可用性。在組織架構方面，本公司設有直屬於總經理的「資訊安全委員會」，負責資訊安全管理系統的建置及維運。該委員會由各單位主管組成，除每年至少召開一次會議外，亦將視資安風險管理需要隨時召開會議，並定期向委員會報告資安治理概況。在管理制度方面，本公司已通過 ISO 27001 認證，建立一套依循目標管理的標準，並透過管理審查、內部稽核、風險評鑑、矯正及預防措施等資訊安全管理機制，強化資訊安全防護與提昇資訊安全水準。

(二)資通安全政策

本公司致力於保護公司業務與資訊系統相關之資訊資產，遵循相關法令，以確保公司和客戶的機密資訊免於遭受竄改、揭露、破壞或遺失等風險。

資訊安全風險管理與持續改善架構

為此，我們依據 ISO/IEC 27001：2013 指導規範之「規劃(Plan)－執行(Do)－檢查(Check)－行動(Act)」模式，建立了完善的資訊安全管理系統，有效落實資安管理。

此資訊安全管理系統包含以下重要內容：

- **管理組織職掌：**明確界定資安管理相關人員的職責與權限，確保資安管理工作得以有效推動和執行。
- **文件紀錄管理：**建立嚴謹的文件紀錄控管制度，確保所有資安相關資訊的完整性、機密性及可用性，以利追蹤與查核。
- **各項資安管制措施之原則：**針對資訊資產的機密性、完整性及可用性，制定一系列具體的資安管制措施，有效降低潛在的資安風險。

- **多方合作和降低風險：**我們積極參與資安情資分享組織，包括科學園區資安資訊分享與分析中心（S-ISAC）、臺灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）等，即時掌握最新的資安預警、威脅與弱點資訊。同時，我們也與外部資安廠商及專家緊密合作，持續追蹤最新的資安資訊、技術與趨勢，並將最新的防禦和管理方法應用於實務，提升快速反應和復原能力，有效抵禦新型態的資安威脅，確保資訊服務的韌性，將營運衝擊降至最低。

透過上述政策的實施，本公司能夠有效地管理資訊安全風險，全面保護資訊資產的機密性、完整性及可用性，最終目標是確保公司業務的正常運作與永續發展。

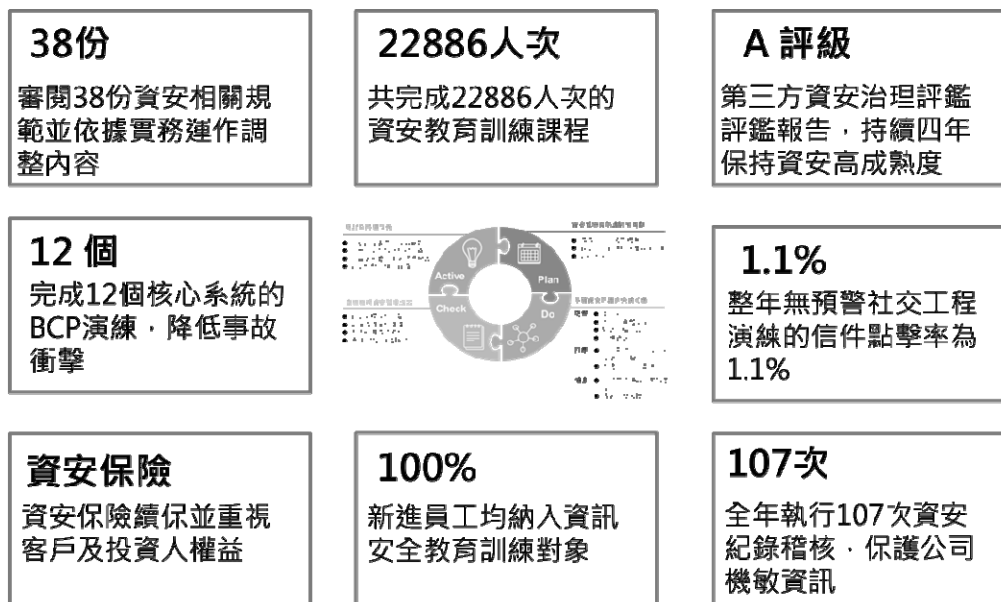
(三) 具體管理方案與投入資源

- I. 本公司致力於建立堅實的資訊安全防護網，以預防、偵測並降低資安攻擊帶來的潛在損害：
 1. 建立並維護資訊安全管理系統(ISMS)：我們遵循國際標準(例如 ISO 27001)，建立一套完整的 ISMS，涵蓋政策、程序、控制措施和風險管理框架，以系統化的方法管理資訊安全。
 2. 利害關係人溝通與需求分析：我們定期與內外部利害關係人(包括客戶、合作夥伴、員工等)進行溝通，了解他們對資訊安全的期望和需求，並將其納入 ISMS 的考量，以確保資訊安全管理制度符合各方需求。
 3. 風險評估與管理：我們定期執行全面的風險評估，識別潛在的資安威脅和漏洞，並根據風險等級採取適當的風險降低或移轉措施。
 4. 資訊安全意識培訓與社交工程演練：我們定期舉辦資安教育訓練和社交工程演練，提高員工的資安意識，使其能夠辨識並應對各種網路釣魚、惡意軟體和其他社交工程攻擊。
 5. 建立多層次縱深防禦體系：我們建構多層次的縱深防禦體系，包括網路安全設備(防火牆、入侵偵測/防禦系統等)、端點安全防護、資料加密、存取控制等多項措施，以全面保護資訊資產。
 6. 安全事件監控與應變：我們建立完善的安全事件監控機制，即時偵測任何異常活動，並制定詳細的應變計畫，以便在發生資安事件時能夠迅速有效地做出響應，降低事件的影響。
 7. 災難復原與業務持續運作計畫(BCP)：我們定期執行關鍵應用系統和資料的災難復原演練，並制定完善的 BCP，以確保在發生重大災害或中斷時，業務能夠迅速恢復運作。
 8. 漏洞管理與滲透測試：我們定期執行漏洞掃描和滲透測試，主動找出系統和應用程式中的潛在漏洞，並及時進行修補，以降低被攻擊的風險。
 9. 供應鏈安全管理：我們重視供應鏈的資訊安全，要求供應商遵守相關的資安標準和規範，並定期進行評估和稽核，以確保整個供應鏈的資訊安全。
 10. 持續改進與新興威脅追蹤：我們持續關注最新的資安資訊、技術和威脅情勢，並定期檢討和更新資訊安全管理制度，以有效應對不斷演變的資安威脅。

II. 投入資通安全管理的資源與成效

本公司持續投入資源於資訊安全相關領域，在資通安全推動的主要成效如下：

(1) 資訊安全保護與執行狀況



(2) 資訊安全通報與事件管理

1. 資安監控中心偕同外部資安專家資源迅速掌握資安警訊通報及情資事件，強化偵測與回應機制。
2. 生產機台因資安威脅連網中斷次數與系統入侵資安事件皆為 0 次，確保生產系統穩定運作，避免造成營運損失。
3. 與國家層級 TWCERT、SP-ISAC 等資安資訊分享與分析中心進行網路威脅情資共享。

(3) 災難復原演練

1. 為確保資訊系統永續運作，避免重要資訊系統因重大災難事件而導致服務無法持續的風險，本公司每年至少進行一次資安事故緊急應變計畫演練與 12 次重要生產系統資料還原演練，確保公司在關鍵時刻發揮災難應變能力以災害復原機制快速回復至企業正常或可接受的營運水準，以達到關鍵應用系統能持續運作並確保企業的營運不中斷。

(四)最近年度及截至 114 年 3 月 31 日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響(例如：營運或商譽的影響)及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情形。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
封測加工承攬合約	A 公司	108.06~	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	F 公司	108.12~114.12	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	I 公司	108.12~114.12	封測服務 權利義務規範	保密條款
封測加工承攬合約	S 公司	111.3~114.12	封測服務 權利義務規範	保密條款
銀行 借 款 合 約	中國信託商業銀行	113.08~116.08	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值
	兆豐國際商業銀行	113.09~116.09	中期信用貸款	無
		110.10~115.10	中期信用貸款	無
	元大銀行	111.11~115.11	中期信用貸款	承諾維持一定比例之資產與負債及淨值
	玉山銀行	110.07~117.07	機器設備貸款	無
		113.05~116.05	中期信用貸款	
	華南銀行	113.12~116.12	中期信用貸款	無
		110.09~117.08		
	第一銀行	113.11~118.11	中期信用貸款	無
		110.12~117.12	中期信用貸款	
	台灣銀行	110.08~120.08	建造廠辦大樓	無
		110.08~117.08	機器設備貸款	
	合作金庫	110.12~117.12	機器設備貸款	無
	彰化銀行	113.06~118.06	中期信用貸款	無
		110.12~117.12	機器設備貸款	無
	土地銀行	111.02~117.12	中期信用貸款	無
		112.06~115.06	中期信用貸款	無
	星展銀行	112.12~115.12	中期信用貸款	無

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	差 異	
			金 額	%
流動資產	\$ 46,986,384	\$ 48,194,283	\$ (1,207,899)	(2.51)
投 資	2,379,539	2,003,163	376,376	18.79
不動產、廠房及設備	56,588,276	56,923,703	(335,427)	(0.59)
無形資產	1,104,434	1,107,074	(2,640)	(0.24)
其他資產	2,132,258	2,926,342	(794,084)	(27.14)
資產總額	109,190,891	111,154,565	(1,963,674)	(1.77)
流動負債	18,356,037	16,508,127	1,847,910	11.19
非流動負債	19,142,303	25,539,955	(6,397,652)	(25.05)
負債總額	37,498,340	42,048,082	(4,549,742)	(10.82)
股 本	7,591,466	7,591,466	0	0
資本公積	319,869	237,071	82,798	34.93
保留盈餘	49,756,143	48,242,061	1,514,082	3.14
其他權益	(372,090)	(732,267)	360,177	49.19
庫藏股票	(533,313)	(468,802)	(64,511)	(13.76)
母公司業主之權益	56,762,075	54,869,529	1,892,546	3.45
非控制權益	14,930,476	14,236,954	693,522	4.87
股東權益總額	71,692,551	69,106,483	2,586,068	3.74
重大變動項目分析說明如下： 1. 其他資產減少：主要係預付土地及設備款減少所致。 2. 非流動負債減少：主要係長期借款減少所致。 3. 資本公積增加：主要係 113 年度發放予子公司股利調整資本公積所致。 4. 其他權益增加：主要係 113 年度國外營運機構財務報表換算之兌換利益增加所致。 影響重大者應說明未來因應計畫：無此情形。				

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

二、財務績效

(一)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因：

單位：新台幣仟元

項 目 \ 年 度	113 年度	112 年度	增（減）金額	變 動 比 例 （ % ）	變動 分析
營業收入淨額	\$ 73,315,042	\$ 70,440,945	\$ 2,874,097	4.08	
營業成本	59,323,602	57,831,970	1,491,632	2.58	
營業毛利	13,991,440	12,608,975	1,382,465	10.96	1
營業費用	4,609,174	4,455,409	153,765	3.45	
營業淨利	9,382,266	8,153,566	1,228,700	15.07	2
營業外收入及支出	1,295,020	3,889,550	(2,594,530)	(66.71)	3
稅前淨利(損)	10,677,286	12,043,116	(1,365,830)	(11.34)	4
所得稅費用	2,177,879	2,533,978	(356,099)	(14.05)	
本期淨利	8,499,407	9,509,138	(1,009,731)	(10.62)	4
增減變動分析：					
1. 營業毛利增加：主要是趕上 AI 浪潮致接單量增加。					
2. 營業淨利增加：主要係營業毛利增加幅度大於營業費用增加幅度所致。					
3. 營業外收入及支出減少：主要係 112 年度認列處分子公司利益所致。					
4. 稅前淨利及本期淨利減少：主要係營業外收入及支出減少所致。					

註：上列財務資料來源為經會計師查核簽證之合併財務報告。

(二)預期銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

請參照壹、致股東報告書。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額	全 年 來 自 營 業 活 動 淨現金流量	全 年 來 自 投 資 活 動 淨現金流量	全 年 來 自 籌 資 活 動 淨現金流量	匯率變動對 現金及約當 現金之影響	現 金 剩 餘 數 額
21,079,749	21,565,826	(9,864,644)	(11,351,315)	808,719	22,238,335
113 年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動：營業活動現金淨流入量主要係 113 年度獲利流入及折舊增加。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係 113 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)籌資活動：籌資活動現金淨流出量主要係 113 年度發放股東現金股利及償還銀行借款之現金流出。					

(二)流動性不足之改善計畫：

113 年度現金流量無流動性不足之情形，故不適用。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期 初 現 金 餘 額	預 計 全 年 來 自 營 業 活 動 淨 現 金 流 量	預 計 全 年 來 自 投 資 及 籌 資 活 動 淨 現 金 流 量	現 金 剩 餘 數 額	現 金 不 足 額 之 補 救 措 施	
				投 資 計 劃	理 財 計 劃
22,238,335	21,000,000	(22,000,000)	21,238,335	—	—
1. 114 年度現金流量變動情形分析					
(1)營業活動：營業活動現金流入量主要係 114 年度預計獲利加計折舊等。					
(2)投資活動：投資活動現金淨流出量主要係預計 114 年度取得不動產、廠房及設備之現金流出。					
(3)籌資活動：籌資活動現金流出量主要係預計 114 年度支付股東股利及償還銀行借款之現金流出。					
2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 113 年度重大資本支出主要為取得不動產、廠房及設備，資金來源係以自有資金及銀行借款支付。由於本公司所處半導體產業之產品及技術世代交替迅速，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能，以配合產品市場的變化及客戶的需求，以維持公司之競爭力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計畫

本公司轉投資政策主要係為配合公司深耕本業，並以強化與主要客戶間之策略聯盟關係及延伸相關產業之營業觸角為方向，期以投資收益增進股東權益。本公司 113 年度轉投資之營運概況請詳陸、特別記載事項之關係企業相關資料內容。

本公司於 98 年度在投審會核准對大陸投資美金 5,100 萬仟元額度內，透過 Powertech Holding (B.V.I.) Inc. 間接投資力成科技(蘇州)有限公司(以下簡稱力成蘇州)，正式跨足大陸地區的封測領域。當時力成蘇州在當地政府登記之投資總額為美金 2 億 1,600 萬元、註冊實收資本金為美金 7,200 萬元，並於 109 年 4 月第八屆第 17 次董事會通過增加對力成蘇州之投資美金 2,800 萬元，於 110 年其註冊實收資本金已由美金 7,200 萬元增加至美金 1 億元。歷經超過十年的經營，近年來美中貿易戰衝突加劇，為全球半導體產業帶來嚴重影響，本公司基於整體營運布局戰略考量，且為有效運用集團資源，於 112 年 6 月 27 日經第十屆第 2 次董事會決議通過處分本集團持有力成蘇州之 70% 股權。本次處分股權交易為本公司貢獻約 3.5 元每股盈餘，已於 112 年度全數認列。

本公司與主要客戶美光科技股份有限公司共同合作，於 103 年 12 月共同簽訂半導體封裝投資合約，透過第三地子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 於中國西安設立子公司力成半導體(西安)有限公司(以下簡稱力成西安)。本公司投資金額合計為美金 7,000 萬元，力成公司對力成西安之持股為 36%，Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. 對該子公司之持股則為 64%。力成西安與美光西安於 105 年 1 月 21 日共同簽訂半導體封裝服務合約，因合約期滿並收到美光通知行使其購買權，本公司於 112 年 6 月第十屆第 2 次董事會通過處分力成西安之資產，並於 113 年 6 月 28 日完成資產移轉，並轉型為控股公司。經力成西安之董事會於 113 年 7 月通過辦理現金減資案，並於 113 年 9 月完成變更登記，本公司已於 113 年 11 月收到其減資匯回股本金額美金 6,000 萬元。

日本子公司力成科技秋田株式會社(Powertech Technology Akita Inc.) 於 106 年 8 月購自美光日本，因其承諾及自行開發之當地客戶訂單之營收，已無法支持其營運，基於長期營運規劃考量，於 109 年 8 月第九屆第 2 次董事會決議通過停止其營運，授權董事長或其指定之人處理後續作業，已於 113 年 9 月完成合法清算程序。

新加坡子公司 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. (下稱 PTI-SG) 於 103 年 7 月購自 Nepes Corp. 主要從事 bumping 業務，因已開發客戶之營收，無法支持其營運，且於長期營運規劃考量，於 109 年 8 月第九屆第 2 次董事會決議通過停止其生產製造業務，並轉型為力成半導體(西安)有限公司及力成科技(蘇州)有限公司之控股公司。經 PTI-SG 之董事會於 111 年 7 月決議通過辦理現金減資案，並於 111 年 8 月完成變更登記，本公司已於 111 年 9 月收到其減資匯回股本金額美金 1,600 萬元。

未來一年投資計畫將視整體產業狀況與公司事業發展之需求，在鞏固策略聯盟合作關係與延伸相關產業營業觸角的方向下，經審慎評估後提報董事會核議。

六、最近年度及截至年報刊印日止，風險事項之分析評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率變動之影響及因應措施

本公司所處半導體封裝測試業屬資本密集產業，機器設備的投資金額較大，資金來源除自有資金外，以銀行借款為主，故本公司損益受到利率變動之影響。對此風險本公司除定期評估銀行借款利率與市場平均利率之水準外，並適時向往來銀行洽商取得較優惠之借款利率。

2.匯率變動之影響及因應措施

(1)匯率變動之影響

本公司 113 年度外銷比重約為 80.81%，此為外幣收入之主要來源，幣別則以美元為主。而本公司部分機器設備及原物料亦從國外進口，大部份以美元或日幣計價，因此，不論收入或支出均受匯率波動之影響。本公司 113 年度匯兌淨利為 911,167 仟元。

(2)因應匯率變動之具體措施：

- 進貨與收入產生相互沖抵之結果，使匯率之變動產生自然避險之效果。
- 財務人員蒐集有關匯率變化之訊息，參酌往來銀行銀根鬆緊狀況、匯率走勢分析及市場外匯需求狀況，以作為因應匯率變動之參考。
- 依據未來外幣需求情況下，適時買入外幣，以確定成本並降低匯率變動所造成之影響。
- 運用銀行額度適當時機將外幣貸款轉換為新臺幣之借款。
- 運用遠期外匯之衍生性商品交易，規避外幣計算之資產或負債及預期交易因匯率變動產生之風險。

3.通貨膨脹情形：

本公司 113 年度損益並無明顯受通貨膨脹之影響，未來將視變動情形因應調整。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1. 本公司及子公司並無從事高風險、高槓桿之投資交易。
2. 本公司及子公司已依據證期局相關法令及規定，訂定以健全財務及營運危機處

理的內部管理辦法及作業程序，包括「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」，所有交易均依相關規定辦理，未來仍將嚴格遵守程序規範執行。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發費用：

本公司自成立以來即致力於封裝測試人才的培訓，於87年即成立研發部門，持續進行封裝測試新製程、新技術之研發及引進；並於95年成立研發技術中心，未來將配合半導體記憶體主件朝多功能、高速化、高信賴度及高密度化方向發展及配合客戶新產品之開發情形，積極發展及引進新技術。未來研發計畫請詳肆、營運概況之一、(一)、4.計劃開發之新商品(服務)之說明。本公司預計114年度投入之研發費用為新台幣2,425,285仟元，由於本公司編列研發費用之預算較為保守，實際執行結果將與113年度相當。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策，而最近年度及截至年報刊印日止，本公司尚無受到國內外重要政策及法律變動而有影響財務及業務之情事。

(五)科技改變(包括資通安全風險)及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司所處半導體產業，產品及技術之世代交替迅速，為配合產品市場的變化及客戶的需求，需持續變更製程及研發新技術，並適時更新設備、擴充產能。為降低產能過度擴充之風險、有效運用資金掌握產品發展趨勢，本公司與主要客戶建立策略聯盟之合作關係，以共同提升先進技術之能力。另外，利用轉投資相關企業，佈建完整的產品線，藉以分散產業變化帶來的風險，並加強成本控制、現金管理來維持公司的競爭力，以控制對公司財務業務的影響。

本公司已建立網路與電腦相關之資安防護措施，亦針對資訊安全風險管理訂定相關規定與流程：

1. 不同之資產其面臨之風險也不盡相同，針對鑑別資產價值或計算方法調整適合單位特性之方式進行。
2. 基本資訊安全需求為資料之機密性、完整性與可用性，並透過持續檢視和評估，以確保相關規定與流程之適當性及有效性。
3. 考量資安保險仍是新興險種，涉及資安等級檢測機構、理賠鑑識機構及不理賠條件等相關配套，為了降低資安事件所可能造成之損失，本公司於113年持續購買資安保險，總保障額度為500萬美元。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。本公司企業形象良好，近年並無企業形象改變而造成企業危機之情事發生。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於113年及截至年報刊印日止，尚無進行併購之情形。

(八)擴充廠房之預期效益及可能風險及因應措施：

本公司 113 年及截至年報刊印日止，尚無重大擴充廠房之情形。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

由於所處之產業特性，上游記憶體 IC 之市場集中度高，使得下游封測產業出現銷貨及進貨較為集中之現象，為分散此風險，本公司積極開發新客戶，與原有客戶建立友好的策略聯盟合作關係，並持續積極跨足非記憶體 IC 之封裝測試業務，目前在 DRAM、NAND FLASH 之記憶體及邏輯 IC 之封測代工呈現約略各占 1/2 之態勢。進貨方面，則積極尋找替代料及新合格供應商，以期使公司穩健成長。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

1.本公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

2.董事、監察人、總經理、實質負責人、持股超過百分之十之大股東及從屬公司重大訴訟、非訟或行政爭訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：請參閱公開資訊觀測站。查閱路徑如下：

公開資訊觀測站＞單一公司＞電子文件下載＞關係企業三書表專區

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無此情形。

三、其他必要補充說明：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無此情形。

力成科技股份有限公司



董事長：蔡 篤 恭



